



+ + + + +

# Our Solutions Set Standards

Geschäftsbericht 2007



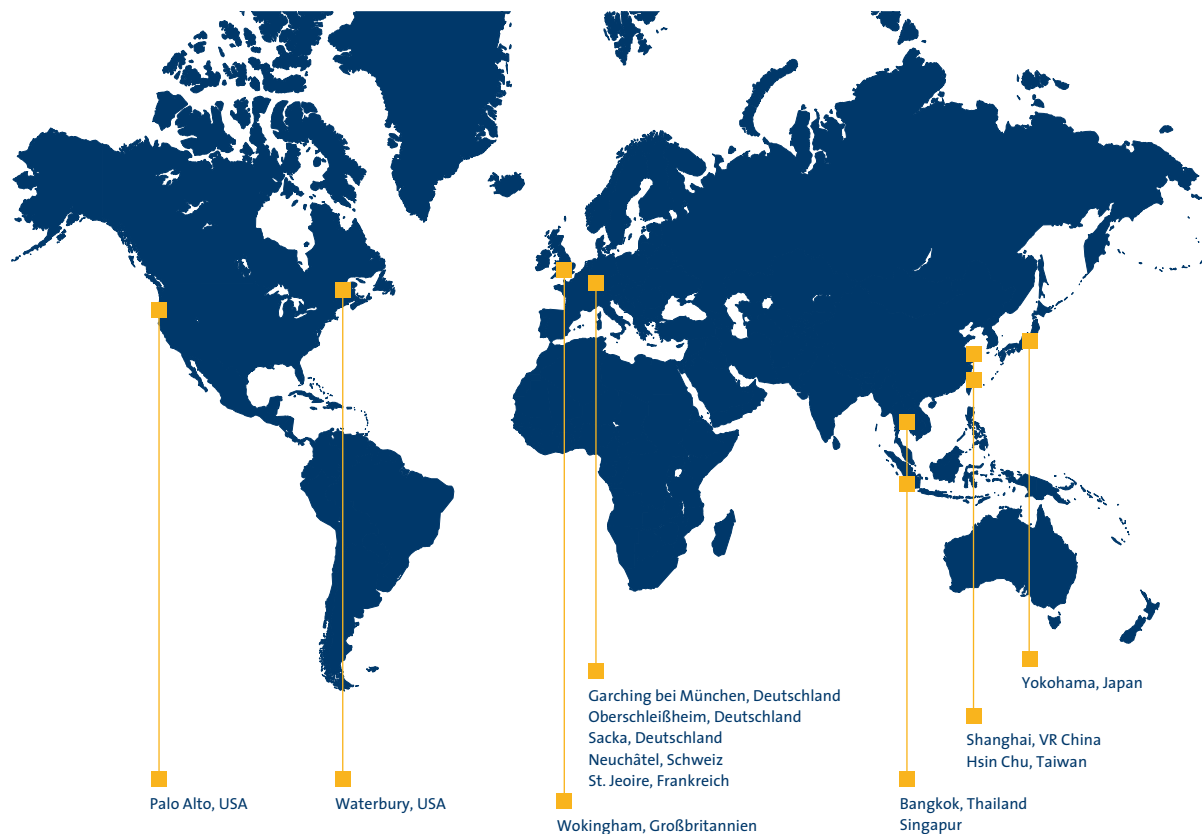
# + Inhaltsverzeichnis



Kennzahlen  
Segmentübersicht

	<b>Vorwort</b>
02	Interview mit dem Vorstand
08	Bericht des Aufsichtsrats
10	<b>SÜSS-Segmente</b>
22	<b>Investor Relations</b>
26	<b>Corporate Governance</b>
36	<b>Konzernlagebericht</b>
36	<b>Geschäft und Rahmenbedingungen</b>
36	Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
39	Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
40	Forschung und Entwicklung
42	Überblick über den Geschäftsverlauf
50	<b>Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage</b>
50	Ertragslage
51	Finanz- und Vermögenslage
53	Investitionen
54	Die Holding – SÜSS MicroTec AG
56	Mitarbeiter im Konzern
57	<b>Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB</b>
58	Corporate Governance
58	Nachtragsbericht
59	Risikobericht
65	Prognosebericht
69	Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns
69	Vorausschauende Aussagen
70	<b>Konzernabschluss nach IFRS</b>
70	Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
72	Konzernbilanz
74	Konzern-Kapitalflussrechnung
76	Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
78	Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2007
80	Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2006
82	Segmentberichterstattung
84	<b>Konzernanhang</b>
96	Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
102	Erläuterungen zu den Aktiva
106	Erläuterungen zu den Passiva
119	Sonstige Angaben
134	<b>Versicherung der gesetzlichen Vertreter</b>
135	<b>Bestätigungsvermerk</b>
	<b>Service</b>
136	Glossar
	Finanzkalender
	Impressum/Kontakt

# +++ SÜSS MicroTec – ein Global Player



Präzisionsmaschinen von SÜSS MicroTec – das sind faszinierende Beispiele für den Erfindungsreichtum und die Leistungskraft deutscher Ingenieurskunst. Mit weltweit mehr als 8.000 installierten Systemen zählt SÜSS MicroTec seit annähernd 60 Jahren zu den führenden Spezialausrüstern für die Chip- und Mikrosystemtechnikindustrie. Ob Autoairbag, Computer oder Mobiltelefon – Halbleiter und Mikrosysteme sind das Herzstück all dieser Geräte und Anwendungen. Es sind SÜSS-Technologien, die es ermöglichen, leistungsfähigere Chips in größerer Stückzahl zu niedrigeren Kosten herzustellen.

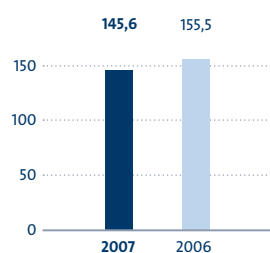
Im Fokus stehen dabei lukrative Spezialmärkte sowie der Ausbau unserer Stellung in den wachstumsstarken Halbleitermärkten Asiens. Unser Ziel ist es, auch in den kommenden Jahren profitabel zu wachsen und ganz vorne dabei zu sein, wenn der Trend zur dreidimensionalen Integration von Chips demnächst Industriestandard wird.

# + SÜSS auf einen Blick +

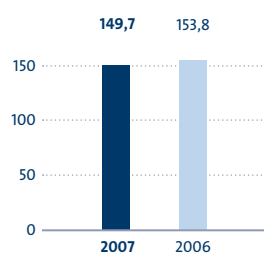
## Konzern-Kennzahlen (IFRS)

in Mio. €	2007	2006	Veränderung
<b>Umsatz und Auftragslage</b>			
Auftragseingang	149,7	153,8	-2,7 %
Auftragsbestand zum 31.12.	77,5	78,5	-1,3 %
Umsatz gesamt	145,6	155,5	-6,4 %
<i>Umsatz Europa</i>	48,2	43,2	+11,6 %
<i>Umsatz Nordamerika</i>	41,2	47,7	-13,6 %
<i>Umsatz Japan</i>	17,9	17,1	+4,7 %
<i>Umsatz Sonstiges Asien</i>	38,3	47,2	-18,9 %
<i>Umsatz Rest of the World</i>	0,0	0,3	-
Umsatzrendite	3,1 %	9,6 %	-6,5 %-Punkte
Rohertrag	60,9	69,6	-12,5 %
Rohertragsmarge	41,8 %	44,8 %	-3,0 %-Punkte
Herstellungskosten	84,7	85,8	-1,3 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	12,1	9,5	+27,4 %
EBITDA	10,6	22,2	-52,3 %
EBITDA-Marge	7,3 %	14,3 %	-7,0 %-Punkte
EBIT	6,0	16,0	-63,0 %
EBIT-Marge	4,1 %	10,3 %	-6,2 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	4,5	14,9	-69,8 %
Ergebnis je Aktie	0,26	0,88	-70,0 %
<b>Bilanz</b>			
Eigenkapital	102,6	99,2	+3,4 %
Eigenkapitalquote	62,9 %	63,0 %	-0,1 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	4,4 %	15,0 %	-10,6 %-Punkte
Bilanzsumme	163,1	157,3	+3,7 %
Net Cash	7,6	14,7	-48,3 %
Free Cashflow	-7,7	7,2	-

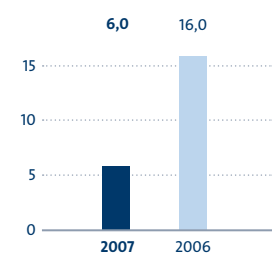
**Konzernumsatz**  
in Mio. €



**Auftragseingang**  
in Mio. €



**EBIT**  
in Mio. €

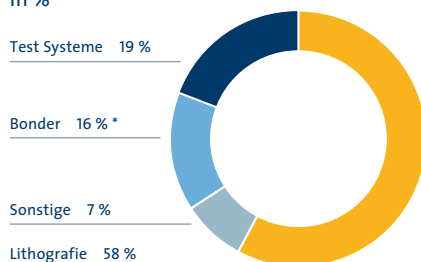


# ++ SÜSS-Segmente

++  
Kennzahlen  
Segmentübersicht

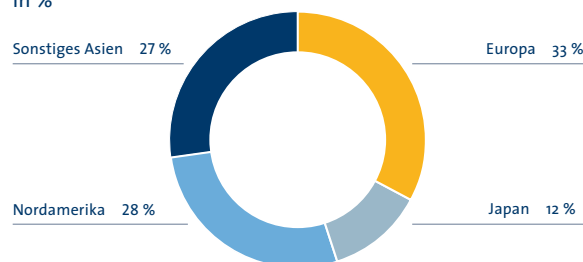
Segmente	Produktlinien	Adressierte Märkte
<b>Lithografie</b>  Umsatz: 83,8 Mio. € Ergebnis: 13,7 Mio. €	Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produktionslinien Mask Aligner und Coater. Dieses Segment stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäfts der SÜSS-Gruppe dar.	Advanced Packaging Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter 3D-Integration
<b>Substrat Bonder</b>  Umsatz: 16,3 Mio. € Ergebnis: -1,0 Mio. €	Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Substrat Bondern, die zwei oder mehrere Trägermaterialien (Substrate) – meist Wafer – miteinander verbinden. Derzeit Phase der Marktdurchdringung. Anwendungen des Wafer Bondings werden in Zukunft wachsen.	Mikrosystemtechnik (MEMS) Verbindungshalbleiter 3D-Integration
<b>Test Systeme</b>  Umsatz: 27,8 Mio. € Ergebnis: 0,4 Mio. €	Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Test- und Prüfsystemen. Wenig zyklischer Geschäftsverlauf, moderates, aber nachhaltiges Wachstum. Dieses Segment stellt rund ein Viertel des Geschäftsvolumens der SÜSS-Gruppe dar.	Halbleiterindustrie Mikrosystemtechnik (MEMS)
<b>Sonstige</b>  Umsatz: 11,2 Mio. € Ergebnis: -6,1 Mio. €	Umfasst neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie in Palo Alto, USA, die Aktivitäten in der Mikrooptik (Neuchâtel, Schweiz) sowie das Geschäftsfeld C4NP und die Holdingfunktionen der SÜSS MicroTec AG.	Mikrooptik Halbleiterindustrie Advanced Packaging (C4NP)

**Umsatz nach Segmenten**  
in %



\* davon Device Bonder 4,4 %

**Umsatz nach Regionen**  
in %









**DR. STEFAN SCHNEIDEWIND**  
Vorstandsvorsitzender



**MICHAEL KNOPP**  
Finanzvorstand

*Der Aktienmarkt reagierte sehr negativ auf die Gewinnwarnung. Der Aktienkurs litt stärker als der anderer Halbleiterunternehmen, die ähnliche – oder sogar schlechtere – Zahlen zu kommunizieren hatten. Wie erklären Sie sich das?*

**Knopp:** Nach einer langen Durststrecke verzeichnen wir erst seit Kurzem wieder Gewinne. Deswegen haben die Finanzmärkte sehr sensibel auf unsere Gewinnwarnung reagiert. Wir befinden uns noch immer in einer Phase, in der wir das Vertrauen unserer Anleger wiedergewinnen müssen.

*Das dritte Quartal hat Ihnen also die Bilanz verhagelt. Wie verlief das vierte Quartal?*

**Schneidewind:** Mit 54 Millionen Euro konnten wir den höchsten Auftragseingang in einem Quartal seit sieben Jahren erzielen. Nur einmal, im ersten Quartal 2001 mit damals 56 Millionen Euro, lag diese für uns so wichtige Kennzahl überhaupt höher.

**Knopp:** Mit einem Auftragspolster von 78 Millionen Euro zum 31. Dezember 2007 sind wir zudem mit viel Schwung in das neue Jahr gestartet. Sie müssen wissen, dass zwischen Auftragseingang und Endabnahme in der Regel drei bis sechs Monate liegen. Das heißt, die 78 Millionen Euro Auftragsbestand werden bis Ende Juni umsatzwirksam. Damit wären dann bereits mehr als 50 Prozent des Jahresumsatzes 2007 unter Dach und Fach gebracht.

*2007 war auch geprägt von den Anstrengungen, interne Prozessreformen voranzubringen – welche Neuigkeiten gibt es hier zu berichten?*

**Schneidewind:** Am wichtigsten und anspruchsvollsten ist sicher die konzernweite Einführung unseres ERP-Systems (Enterprise Resource Planning System) auf SAP-Basis. Dieses integriert alle administrativen und operativen Aufgabebereiche entlang der gesamten Wertschöpfungskette mithilfe einer zentralen Datenbasis. Die Systeme werden eingesetzt zur Planung, Steuerung und Kontrolle der Informations-, Material-, Personal-, Energie- und Zahlungsflüsse im Unternehmen. Damit ist – um nur ein Beispiel zu nennen – ein besseres Ersatzteil-Management möglich. Dies reduziert das gebundene Kapital, vereinfacht das Servicegeschäft, erleichtert die Verrechnungen von Intercompany-Transaktionen und ermöglicht mit besseren Controlling-Funktionen Kosteneinsparungen bei der Lagerhaltung und Materialbeschaffung. Material ist schneller verfügbar, die Durchlaufzeiten in der Produktion werden kürzer.

*Und wie ist der Stand der Dinge bei der globalen Kundendatenbank SCOPE?*

**Schneidewind:** SCOPE läuft und der Nutzen dieser Datenbank ist enorm. Für den Vorstand ist SCOPE ein wichtiges Werkzeug, mit dem wir den Fortschritt des Unternehmens hervorragend beobachten und vor uns liegende Stolpersteine rechtzeitig entdecken können. Und mit Sicherheit ist SCOPE wesentlich verlässlicher, als es die Aussagen von Researchhäusern sind, die wenig über die spezielle Situation in den von uns adressierten Märkten der Backend-Fertigung wissen. Mit SCOPE können wir verlässlichere Planungen erstellen.

Auch dem Vertrieb hilft SCOPE: Ein Halbleiterhersteller hat zum Beispiel verschiedene Produktionsstandorte. Unsere regionalen Sales-Manager sind nun dank der SCOPE-Datenbank jederzeit im Bilde über die Investitionsabsichten dieses Kunden in den Regionen und können ihre interne Planung besser steuern und abstimmen.

*Wie geht es mit dem C4NP-Projekt und der Kooperation mit IBM weiter? Neben technologischen Erfolgen benötigen Sie doch vor allem weitere Kunden, um die Aufwendungen für die Entwicklung der Produktlinie zu rechtfertigen. Was passiert, wenn diese Kunden in 2008 ausbleiben?*

**Schneidewind:** C4NP ist bei IBM erfolgreich in Produktion gegangen und IBM hat im Sommer 2007 der Öffentlichkeit sehr gute Ergebnisse präsentiert. Damit sind die Weichen gestellt und es ist der Nachweis für die Leistungsfähigkeit von C4NP unter Produktionsbedingungen erbracht. Nun müssen neue Kunden neben IBM gefunden werden, damit sich diese neue Technologie auf dem Markt verbreitet und durchsetzt. Wir werden 2008 alles daransetzen, für C4NP einen weiteren Kunden zu gewinnen.

Im Zuge des Lernprozesses bei C4NP hat sich herausgestellt, dass für die Produktions-Tools veränderte Spezifikationen erforderlich sind. Dies verzögert die Auslieferung dieser Tools und verursacht auch zusätzliche Kosten. Bis zum Sommer werden die noch fehlenden Maschinenteile an IBM ausgeliefert sein und unter Produktionsbedingungen laufen.

*Eines der großen Themen Ihrer Industrie ist derzeit die 3D-Integration, also das Übereinanderstapeln von Wafern und Mikrochips. Wie will SÜSS von diesem Trend profitieren und Marktanteile gewinnen?*

**Schneidewind:** Um den Wachstumsmarkt 3D zu verstehen, muss man wissen, dass der Treiber der Halbleiterindustrie nicht mehr der Computer, sondern die Unterhaltungselektronik ist. Mobiltelefone zum Beispiel sind in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Sie bieten mehr Funktionen bei gleichzeitig geringerer Gehäusegröße. Technologisch ist das nur mithilfe der 3D-Integration von Chips möglich. Das iPhone von Apple ist das prominenteste Beispiel hierfür.

Hersteller von Image-Sensoren für die Mobiltelefonie sind die ersten Unternehmen, die mit 3D-Technologie produzieren. Diese sind schon heute unsere Kunden. Und sie werden ihre Produktionskapazitäten auf Grund des wachsenden 3D-Marktes weiter ausbauen. Für die dabei notwendigen Lithografieprozesse sind Maschinen von SÜSS erste Wahl. Wir erwarten deshalb eine weiter steigende Nachfrage für diese spezielle Anwendung bei unseren Kunden in Asien.

*Gibt es im Zusammenhang mit 3D eine spezifische Applikation, die ein besonders hohes Wachstum verspricht?*

**Schneidewind:** Ja, die gibt es. Bei der Herstellung von Kamera-Modulen für fotofähige Handys wurde jetzt das so genannte Wafer-Level-Packaging eingeführt. Dabei werden ganze Siliziumwafer übereinander gestapelt. Dieses Verfahren macht die Kamera-Module und damit auch die Geräte selbst wesentlich kleiner und preisgünstiger. Dies ist für unser Geschäft mit Substrat Bondern und Lithographiesystemen eine enorme Chance.



*Die Vorhersagen für die Halbleiterbranche und die Halbleiter-ausrüster, zu denen ja SÜSS gehört, sind für 2008 nicht sehr optimistisch. Können Sie dazu genauer Stellung nehmen?*

**Schneidewind:** Das ist so nur zum Teil richtig. Tatsächlich erwarten die meisten Researchinstitute für den Halbleitermarkt und den für integrierte Schaltkreise, also Integrated Circuits (ICs), sogar ein Wachstum von durchschnittlich 7,9 Prozent nach nur 3,9 Prozent in 2007. Fast alle Institute schränken jedoch ein, dass diese Zahlen auf einem Szenario basieren, welches keine substantielle Konjunkturabschwächung in den für unsere Branche wichtigen Weltregionen annimmt. Außerdem räumen sie ein, dass es zum Beispiel bei der Produktion von Speicherchips teilweise Überkapazitäten gibt.

Allerdings werden die Hersteller von Halbleiter-Equipment den Researchhäusern zufolge nicht von diesem Wachstum profitieren können: Nachdem der Gesamtmarkt in 2007 noch leicht zulegen konnte – SÜSS erlebte ja bereits im zweiten Halbjahr 2006 seinen Boom – erwarten die Marktbeobachter 2008 im Schnitt einen Rückgang der Umsätze mit Maschinen um neun Prozent. Häuser wie IC Insights, Gartner Dataquest und Research Infrastructure liegen bei minus zehn Prozent, VLSI ist mit minus 5,2 Prozent optimistischer, Semico Research liegt mit minus acht Prozent dazwischen.

*Der Branchenverband SEMI sagt für 2008 einen Rückgang der Verkaufszahlen für Halbleiter-Equipment um zwei Prozent voraus. Was heißt das konkret für den Ausblick von SÜSS MicroTec?*

**Schneidewind:** Vorhersagen wie die von SEMI können nützlich sein, um sich einen generellen Eindruck über die Stimmung in unserer Branche zu verschaffen. Aber die SÜSS-Gruppe mit ihrem Equipment für spezielle Märkte folgte in der Regel nicht hundertprozentig der allgemeinen Markttendenz.

Von der Konjunktur für Halbleiter-Equipment relativ unabhängig ist zum Beispiel unser Geschäft mit MEMS, in dem wir 40 Prozent des Umsatzes erzielen. MEMS sind Bauteile, die eine mechanische mit einer elektronischen Funktion verbinden, wie sie zum Beispiel in Airbag-Sensoren Verwendung findet. Solche Anwendungen weisen ein stetiges Wachstum von fünf bis acht Prozent jährlich auf, weshalb wir auch für unser MEMS-Geschäft im laufenden Jahr optimistisch sind.

Gleiches gilt für den schnell wachsenden Markt für Maschinen zur Herstellung von Leuchtdioden (LEDs). Auch hier sehen wir nicht die branchenüblichen Nachfrage-Schwankungen, denn die energiesparenden Bauteile werden – auch auf Grund der aktuellen Klimadebatte – immer stärker nachgefragt.



Drittens ist auch unser Geschäft mit so genannten manuellen und halbautomatischen Tools relativ stabil. Diese Maschinen werden vorwiegend von Hochschulen für die Forschung und Entwicklung bestellt – und zwar jedes Jahr, unabhängig vom Investitionszyklus der Halbleiterbranche. Dies gilt auch für die Entwicklungsabteilungen der Halbleiterhersteller.

Gleichwohl werden wir auch künftig mit einer gewissen Zyklizität in unserer Branche leben müssen. Um diese unbeschadet zu überstehen, müssen wir unsere Herstellungskosten weiter senken – ohne gleichzeitig unsere Effektivität und Flexibilität zu beeinträchtigen.

**Wie kann SÜSS in dem skizzierten Marktumfeld profitabel bleiben?**

**Knopp:** Der Schlüssel zu unserer Profitabilität und zur Steigerung unseres Ertrags liegt in den internen Abläufen. Wir arbeiten hart an Initiativen zur Effizienzsteigerung – bei gleichzeitiger Reduzierung unserer Lagerbestände, Produktionskosten und Lieferzeiten. Diese Maßnahmen sind auf Grund des sehr starken Euros doppelt wichtig. Natürlich müssen wir alles daran setzen, Aufträge zu sichern und alle offenen Endabnahmen so rasch wie möglich zu erhalten, damit diese Umsätze in die Bilanz einfließen können.

**Sind Sie langfristig als eigenständiges Unternehmen überlebensfähig?**

**Schneidewind:** Ja. SÜSS bedient lukrative Märkte, auf welchen sich eine Vielzahl von sehr kleinen Unternehmen tummeln, die teilweise nur einen Bruchteil unseres Umsatzes erzielen. Es ist zu erwarten, dass hier eine Konsolidierung stattfinden wird. SÜSS ist groß genug, um aus dieser Phase sogar gestärkt herausgehen zu können.



**Warum haben Sie sich von dem Geschäft mit Device Bondern getrennt, das seinen Produktionsstandort in Frankreich hat?**

**Schneidewind:** Device Bonders kommen in der Chipfertigung zum Einsatz, wenn bereits vereinzelte elektronische Bauteile weiterverarbeitet werden. Das heißt, der Device Bonder integriert mit höchster Genauigkeit die aus einem Wafer herausgesägten Devices in eine Baugruppe, die dann zum Endprodukt weiterverarbeitet wird. Allerdings können wir mit unserer Plattform die erwähnten Wachstumsmärkte zum Beispiel für die 3D-Integration nicht bedienen. Der Durchsatz müsste zehn- bis 30-mal höher sein.

**Knopp:** Hierfür wären sehr hohe Investitionen notwendig gewesen. Weil uns dieses Risiko nach eingehender Prüfung zu groß erschien, haben wir uns von diesem Segment getrennt, wie bereits im Geschäftsbericht 2006 angekündigt. Das in St. Jeoire in Frankreich angesiedelte Device-Bonder-Geschäft wurde im Rahmen eines MBO zum 16. Juli 2007 an das Management der Suss S.A.S. verkauft. Dieser Schritt steht auch im Einklang mit der Strategie des Konzerns, sich auf wenige Kerngeschäfte zu konzentrieren. Zudem waren die Synergieeffekte mit anderen Segmenten des Konzerns zu gering.

**Schneidewind:** Allerdings werden auch nach dem Spin-off die neue Gesellschaft mit dem Namen SET S.A.S. und die SÜSS-Gruppe eng kooperieren, um zum Beispiel die Servicequalität der rund 200 unter dem Namen SÜSS MicroTec ausgelieferten Maschinen zu gewährleisten. Auch bleibt die Suss MicroTec S.A.S. als Vertriebsgesellschaft der SÜSS-Gruppe in Frankreich erhalten.



*Von Ihrem Produktionsstandort Frankreich haben Sie sich verabschiedet. Werden Sie an Ihrem Substrat-Bonder-Werk in Waterbury im US-Bundestaat Vermont festhalten?*

**Schneidewind:** In jedem Fall. Erstens ist es in Zeiten eines starken Euro ein Wettbewerbsvorteil, auch im Dollar-Raum zu produzieren, um gegen rein amerikanische Firmen konkurrenzfähig zu bleiben. Zweitens haben wir in Waterbury unsere Kernkompetenz für Substrat Bonder nun mehrere Jahre lang aufgebaut. Wir haben dort ein starkes Team, das Jahr für Jahr steigende Umsätze erwirtschaftet. Und was den Vertrieb unserer gesamten Produktpalette im US-Markt angeht: Speziell im für uns wichtigen Absatzmarkt Nordamerika – wir erzielen dort rund ein Drittel unserer Umsätze – ist es für unsere Kunden sehr wichtig, dass sie von einer „amerikanischen“ Firma kaufen und betreut werden.

*Trotz der verhaltenen Wachstumsaussichten für 2008 – warum sollten Anleger dennoch in SÜSS investieren?*

**Schneidewind:** Da wären zum einen die stark steigende Nachfrage nach MEMS und Mikrochips sowie der Trend zu immer kleineren und leistungstärkeren Schaltkreisen und sinkenden Herstellungskosten pro Rechneinheit. Dieser schnelle technologische Wandel erfordert die Umrüstung auf neue Maschinen – davon werden wir profitieren, insbesondere im Bereich Advanced Packaging und MEMS. Außerdem fokussieren wir uns auf innovative Technologien wie C4NP und 3D. Die 3D-Integration ist der wichtigste Wachstumstreiber unserer Industrie für die kommenden fünf Jahre.

**Knopp:** Hinzu kommen Effizienzsteigerungen im Vertrieb mittels der bereits erwähnten globalen Kundendatenbank SCOPE, strategische Kooperationen zur Ergänzung des Produktportfolios sowie Produktivitätssteigerungen durch die Standardisierung von Maschinenteilen. Vor allem aber wird uns SAP wesentlich schlagkräftiger machen.

Nicht zu vergessen: Wir sind ein wirklicher Global Player mit einer ausgewogenen Umsatzverteilung in Asien, Nordamerika und Europa und einem weltweiten Netzwerk für Service und Vertrieb. SÜSS ist ein auch in schwierigen Zeiten wieder profitables Unternehmen mit einer gesunden Eigenkapitalbasis und einer niedrigen Verschuldungsquote. Wir locken Kunden an, deren Brands zu den wertvollsten der Welt gehören: Bosch, Casio, IBM, Intel, Motorola, Philips, Samsung, Siemens, Texas Instruments, um nur einige zu nennen.

*Welche strategische Vision haben Sie? Wo sehen Sie SÜSS in fünf Jahren?*

**Schneidewind:** Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren jährlich um zehn Prozent organisch zu wachsen, was aber sinnvolle Zukäufe nicht ausschließt. SÜSS soll zu einer Company mit 250 Millionen Euro Jahresumsatz werden, die auch in Abschwungphasen der Halbleiterbranche profitabel bleibt und für unsere Aktionäre kontinuierlich Mehrwert generiert.

*Herr Dr. Schneidewind, Herr Knopp, wir bedanken uns für das Gespräch und wünschen Ihnen für das Geschäftsjahr 2008 viel Erfolg.*

# + Bericht des Aufsichtsrats

## SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2007 kontinuierlich durch laufende schriftliche Berichterstattung sowie in sechs gemeinsamen Sitzungen zeitnah und umfassend vom Vorstand über den Geschäftsverlauf und die Planung der Gesellschaft und des SÜSS MicroTec-Konzerns unterrichten lassen und wesentliche Fragen der Geschäftsführung mit dem Vorstand erörtert. Dabei hat der Aufsichtsrat den Vorstand beraten und die Geschäftsführungstätigkeit des Vorstands überwacht. In diesem Zusammenhang hat der jeweils vollständig vertretene Aufsichtsrat in seinen Sitzungen vom 30. März, 20. April (Telefonkonferenz), 6. Juli, 2. August (Telefonkonferenz), 24. September und 14. Dezember 2007 die eingetretenen Abweichungen des tatsächlichen Geschäftsverlaufs einschließlich des Auftragsseingangs von der Planung und die dafür maßgeblichen Gründe ausführlich mit dem Vorstand erörtert. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat über wichtige Geschäftsvorfälle, die sonstigen berichtspflichtigen Umstände und die von ihm für das Risikomanagement getroffenen Maßnahmen sowie über erkennbar gewordene geschäftliche Risiken und auch für das Unternehmen relevante Fragen der Compliance unterrichtet.

In seiner Sitzung vom 30. März 2007 hat sich der Aufsichtsrat schwerpunktmäßig mit dem Jahresabschluss 2006 und der Vorbereitung der Tagesordnung (TO) für die Hauptversammlung vom 6. Juli 2007 befasst.

In der Sitzung vom 20. April 2007 stand neben der laufenden Berichterstattung des Vorstands ein Bericht des Vorstandsvorsitzenden über die aktuelle Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt, ferner die geplante Veräußerung des Device-Bonder-Geschäfts in Frankreich.

Am 6. Juli 2007, dem Tag der ordentlichen Hauptversammlung, fand eine weitere Aufsichtsratssitzung statt. In ihr waren nochmals die Zahlen des ersten Quartals Thema der Beratungen. Ferner wurde der Wechsel von Herrn Dr. Schücking auf Herrn Verspay vollzogen. Letzterer nahm die Wahl zum Aufsichtsrat für die restliche Amtszeit von Dr. Schücking an und wurde in den Prüfungsausschuss gewählt.

Bei der außerordentlichen Sitzung am 2. August 2007 standen strategische Fragestellungen und ein Bericht des Vorstands über die Fachmesse Semicon West im Vordergrund der Beratungen.

Am 24. September 2007 besprach der Aufsichtsrat den Fortschritt des C4NP-Projekts und genehmigte den Plan für die Einführung eines ERP-Systems auf SAP-Basis. Dr. Reineck wurde als Nachfolger von Dr. h.c. Görtz mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 in den Aufsichtsrat und in den Personalausschuss des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG gewählt. Es wurde ferner ein so genannter Nominierungsausschuss gebildet, um die Neuwahl des Aufsichtsrats auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG im Juni 2008 vorzubereiten. Diesem Ausschuss gehören Dr. Süß (Vorsitz) und Dr. Reineck an.

Am 14. Dezember standen folgende Themen auf der Tagesordnung: aktuelle Geschäftslage, Ausblick und Planung für 2008, die Aufnahme des Schuldscheindarlehens, die Neustrukturierung der Finanzierung für die US-Tochtergesellschaft Süss MicroTec Inc. und die Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass Interessenkonflikte zwischen Mitgliedern des Aufsichtsrats und der Gesellschaft bei der Arbeit des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2007 nicht zutage getreten sind.

In Summe ergaben sich 2007 folgende personelle Veränderungen im Aufsichtsrat: Mit Ablauf der Hauptversammlung vom 6. Juli 2007 schied Herr Dr. Schücking aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat dankt ihm für seine engagierte Mitarbeit im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen. Die SÜSS-Gruppe verdankt Herrn Dr. Schücking viele wertvolle Empfehlungen und Hinweise. Die Hauptversammlung hat am 6. Juli 2007 Herrn Verspay anstelle von Herrn Dr. Schücking zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Neben Herrn Verspay konnte der Aufsichtsrat bei seiner Sitzung am 14. Dezember 2007 erstmals Herrn Dr. Reineck als neues Mitglied begrüßen. Herr Dr. Reineck, vom 1. April bis zum 30. September 2007 Vorstandsmitglied der SÜSS-Gruppe, löste Herrn Dr. h.c. Görtz ab, der sein Amt niederlegte. Der Konzern dankt auch Herrn Dr. h.c. Görtz für seine wertvolle Mitarbeit und sein Engagement im Aufsichtsrat und seinen Ausschüssen.



**DR. WINFRIED SÜß**  
Aufsichtsratsvorsitzender



Der Aufsichtsrat erklärt hiermit, dass nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung gegen die von ihm geprüften Vorlagen keine Einwendungen zu erheben sind. Auch die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind aus der Sicht des Aufsichtsrats nicht zu beanstanden. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 ist damit festgestellt.

Die Sitzungen der Ausschüsse des Aufsichtsrats haben teilweise in Form von Telefonkonferenzen stattgefunden. Neben den ordentlichen und außerordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats fanden 2007 Sitzungen des Technologie-, des Personal- und des Prüfungsausschusses statt.

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007, der nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellte Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007, der Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2007 wurden durch den von der Hauptversammlung gewählten und vom Aufsichtsrat beauftragten Abschlussprüfer, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, geprüft und mit uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 sowie den gemäß § 315 a des Handelsgesetzbuchs nach den als IFRS bezeichneten internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellten Konzernabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007, den Lagebericht und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2007 geprüft. An der Verhandlung des Aufsichtsrats über die genannten Vorlagen haben die beiden zuständigen Wirtschaftsprüfer des Abschlussprüfers teilgenommen. Sie haben dem Aufsichtsrat mündlich über die wesentlichen Ergebnisse ihrer Prüfung berichtet. Der Aufsichtsrat hat die genannten Vorlagen und die Feststellungen des Abschlussprüfers mit den Vertretern des Abschlussprüfers und dem Vorstand erörtert und die Vorlagen gebilligt.

Mit dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 ist der Aufsichtsrat einverstanden. Seine Prüfung des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007 hat der Aufsichtsrat insbesondere auch auf die Vollständigkeit und den Inhalt der nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebenen Angaben erstreckt. Dabei haben sich keine Besonderheiten ergeben. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Beteiligungsgesellschaften dafür, dass sie im Geschäftsjahr 2007 mit ihrem Einsatz für die Gesellschaft und den SÜSS MicroTec-Konzern maßgeblich zum Erfolg der SÜSS-Gruppe beigetragen haben.

Ich denke, von einem Erfolg zu sprechen, ist durchaus gerechtfertigt, auch wenn die ursprünglich kommunizierten Umsatz- und Ergebnisziele nicht erreicht werden konnten und auch die Kursentwicklung der SÜSS-Aktie Wünsche offen lässt. Schließlich ist es dem Management gelungen, in einem äußerst schwierigen Marktumfeld profitabel und auf Kurs zu bleiben.

Garching, 27. März 2008

Der Aufsichtsrat

Dr. Winfried Süß





+

++





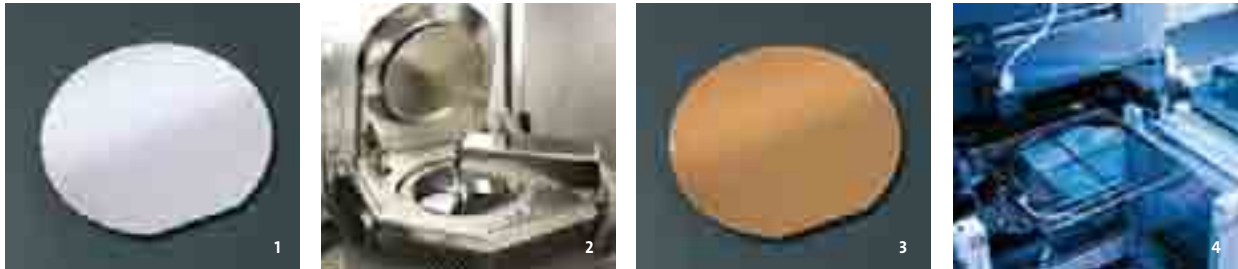
## +++ Präzise und zuverlässig

Ob in LEDs, Festplatten oder Airbagsensoren – in der faszinierenden Welt mikroelektronischer Chips und integrierter Mikrosysteme tragen Lithografiesysteme von SÜSS MicroTec entscheidend dazu bei, zahlreiche Funktionen auf engstem Raum zu bündeln und zu integrieren.



Kernprodukt von SÜSS MicroTec ist der Mask Aligner (Maskenjustierer): Ein Belichtungsgerät, das in der Lage ist, feinste Strukturen auf Substratoberflächen zu erzeugen. Coater ergänzen die Aligner ideal, denn sie decken die Prozesskette vor und nach dem Justieren ab.





### EIN LANGER WEG VOM QUARZSAND ZUM CHIP

SÜSS-Maschinen werden bei einer Vielzahl von Prozessschritten eingesetzt. Aus Quarzsand werden scheibenförmige Siliziumwafer gefertigt (1). Mit einem Spin- oder Spray-Coater (2) werden die Wafer mit einem lichtempfindlichen Fotolack beschichtet (3). Der Mask Aligner belichtet den Lack und überträgt so die für die Schaltungen notwendigen Strukturen der Maske mittels Schattenwurf auf den Wafer (4).

Grundsätzlich unterscheidet man bei der Chipherstellung zwischen der eigentlichen Herstellung der Schaltkreise auf dem Chip (dem so genannten Frontend) und allen nachfolgenden Prozessschritten (dem so genannten Backend). Dabei werden unter anderem die bereits fertiggestellten Mikroprozessoren auf ein Trägersubstrat aufgelötet und mit den Schaltkreisen in Kontakt gebracht. Bei diesem Verfahren, dem so genannten Advanced Packaging, müssen Hunderte kleinster Lotkugeln submikrometergenau auf die Chips aufgebracht werden. Um die Strukturen zum Aufbringen der Lotkugeln vorzubereiten, wird die Lithografiertechnik von SÜSS MicroTec seit einem Jahrzehnt ebenfalls erfolgreich eingesetzt.

## Wettbewerbsvorteile dank SÜSS-Technologie

Durch fortwährende Optimierung und technische Weiterentwicklung sind Lithographiesysteme von SÜSS MicroTec in der Lage, mit den immer anspruchsvolleren Forderungen der Industrie nach höherer Qualität, schnelleren Verbindungen und kleineren Abmessungen mühelos Schritt zu halten. Unsere in Garching bei München produzierten Mask Aligner verfügen nicht nur über eine erstaunlich hohe Präzision. Sie sind auch in der Anschaffung kostengünstig und können mehr Wafer in der Stunde verarbeiten als Belichtungssysteme der konkurrierenden Stepper-technologie.

Spin-Coater von SÜSS MicroTec sind dagegen Meister an Flexibilität und Vielseitigkeit. Neben herkömmlichen Fotolacken schaffen sie es selbst mit extrem zähflüssigen Polyimiden, gleichmäßige Schichten aufzubringen. Polyimide sind hoch temperaturbeständige Kunststoffe, ohne die in der modernen Chipfertigung zurzeit gar nichts läuft. Für die in unserem Werk in Vaihingen an der Enz produzierten SÜSS-Belacker entsteht hier ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, der eine Reihe von wichtigen, neuen Anwendungsgebieten eröffnet hat.

Das von SÜSS MicroTec entwickelte Spray-Coater-Verfahren beherrscht dagegen die hohe Kunst, selbst auf scharfen Kanten und Innenseiten von Ecken eine dünne Materialschicht gleichmäßig aufzubringen, ohne dass diese zerläuft oder heruntertropft. Dieses mittlerweile patentierte „Spraywunder“ hat seit einiger Zeit erfolgreich Eingang in die automatisierte Produktion von Mikrosensoren gefunden, bei denen statt ebenen Siliziumscheiben Oberflächen mit vorgeätzten Kanten, schwingungsfähigen Strukturen und steilen Kanälen beschichtet werden müssen. Mikrosensoren sind unter anderem als so genannte Image-Chips beim Handy fürs Fotografieren zuständig, oder lösen als Drucksensoren den Autoairbag aus.







Das Segment Substrat Bonder ist das drittgrößte Geschäftsfeld von SÜSS. Das Substrat- oder Waferbonden ist ein Fügeprozess, bei dem zwei oder mehrere strukturierte Wafer zum Beispiel mittels Wärme und Druck verbunden werden, um einen mikromechanischen Chip herzustellen.

## +++ Präzise und effizient

Der Bildspeicherchip in unserem Fotohandy, der Drucksensor im Autoairbag: Egal, ob es um mehr Spaß oder um mehr Sicherheit geht, ohne die Substrat Bonder von SÜSS würde unser moderner Alltag nicht so reibungslos funktionieren. Denn SÜSS-Bonder sind es, die mehrere Funktionsebenen eines mikromechanischen Chips miteinander verbinden, so dass daraus leistungsfähige MEMS-Bauteile entstehen.

# + + + Substrat Bonder + +

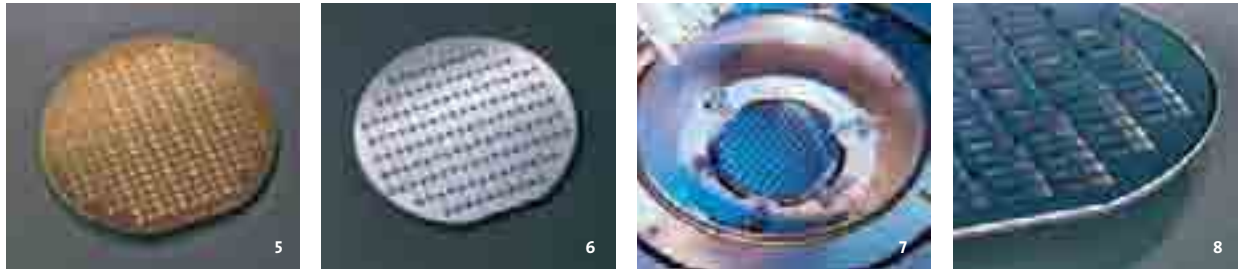
## AUF DEM WEG IN DIE DRITTE DIMENSION

Was genau macht ein Substrat Bonder von SÜSS MicroTec, der in unserem Werk in Waterbury im US-Bundesstaat Vermont entwickelt wird? Und wann kommt er zum Einsatz? Am einfachsten versteht man das, wenn man sich ansieht, für welche zwei grundsätzlich verschiedenen Arten von Anwendungen der Bonder gebraucht wird: Zum einen ist das die Verkapselung hoch empfindlicher Bauteile für die Mikrosystemtechnik, so genannter MEMS (MicroElectroMechanicalSystems). Bei der Herstellung dieser mikromechanischen Bauteile werden im Gegensatz zu elektronischen Elementen die mechanischen Eigenschaften von Silizium und anderen Halbleitermaterialien genutzt. Unter Verwendung von Prozessen, die von der Herstellung elektronischer Schaltkreise bekannt sind, werden mechanische Strukturen in Siliziumscheiben geschaffen. Aus diesen Strukturen entstehen Sensoren, die in Sicherheitssystemen der Automobilindustrie wie den Auslöse-Mechanismen von Airbags, Stabilitätskontroll-Systemen, aber auch bei der Motorsteuerung zur Abgasreduktion Verwendung finden. In Mikrofonen von Mobiltelefonen, Bildstabilisierungs-Programmen von Videokameras, Navigationsgeräten und Spielekonsolen verstecken sich ebenfalls MEMS.

### Von der Siliziumscheibe zum MEMS-Bauteil

Doch wie entsteht aus Siliziumscheiben ein MEMS-Bauteil? Für die mikromechanischen Anwendungen wird auf einen fertig bearbeiteten Wafer ein zweiter Wafer aufgebondet. Dieser Schritt ist für die Leistungsfähigkeit der MEMS extrem kritisch und gelingt nur mit hoch präzisen Anlagen wie jenen von SÜSS MicroTec. Typischerweise erfordert das Verbinden zuvor ein exaktes Justieren der beiden zu bondenden Wafer. Nach dieser Justierung werden beide Wafer mit mechanischer Klemmung in einer Bondkammer mit exakt kontrollierter Temperatur und Druck „gebondet“ (geklebt). Auf diese Weise entstehen zum Beispiel MEMS-Bauteile für besagte Anwendungen in der Automobiltechnik. Schon seit Mitte der 90er-Jahre wächst dieser Markt stetig. Doch in den vergangenen Jahren kamen neue Anwendungen im Konsumgüterbereich dazu, die sehr hohe Wachstumsraten aufweisen.





Während der Lack an den belichteten Stellen unter Wärmezufuhr aushärtet (5), wird der restliche Fotolack in einem weiteren Bearbeitungsschritt mit einem Entwicklungsgerät (Developer) abgelöst (6). In der Bondkammer (7) werden Substrate (meist Wafer) nach präziser Justierung und mechanischer Klemmung mittels exakt vorkontrollierter Temperatur und Druck miteinander verbunden (8).

## Zukunftsmarkt 3D-Integration

Eine neuer, spannender Markt für Wafer-Bonding-Prozesse ist das Stapeln von Wafern und Chips, die so genannte 3D-Integration: Mikrochips müssen heutzutage immer kleiner und leistungsfähiger werden. Gleichzeitig sollen sie möglichst wenig kosten. Deshalb hat die Halbleiterindustrie begonnen, die Bauteile übereinander anzuordnen und elektrisch zu verbinden. Diese 3D- oder TSV-Prozesse (Through Silicon Via) erfordern ebenfalls ein präzises Justieren und Bonden von Wafern. Basierend auf den für die MEMS-Produktion entwickelten Anlagen liefert SÜSS MicroTec Geräte für die 3D-Prozesse. Die Hersteller von tragbaren elektronischen Geräten (Mobiltelefone, MP3-Player, PDAs) sind die treibende Kraft auf dem 3D-Markt, denn die Vorteile liegen auf der Hand: Kameramodule lassen sich drastisch verkleinern, während gleichzeitig die Auflösung zunimmt. Ohne die Leistungssteigerung mithilfe der 3D-Prozesse wären Mobiltelefone nicht annähernd so klein und handlich herzustellen, wie es heutzutage Standard ist.

## Langjährige Erfahrung und breites Know-how

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung mit der hoch präzisen Justierung für Lithografie-Anwendungen hat SÜSS eine breite Know-how-Basis für die komplexen Anforderungen des Bondens von Wafern aufgebaut. Diese Verbindung von mechanischer Präzision und exakter Prozesskontrolle ermöglicht eine hoch volumige und kostengünstige Produktion mikromechanischer Bauteile und gestapelter Bauteile für 3D-Anwendungen – eine Expertise, die unsere Kunden zu schätzen wissen.





+

++





Mit Test Systemen von SÜSS lässt sich das elektrische Verhalten der Bauteile auf dem Chip messen. Dieser Markt entstand zu Beginn der 70er-Jahre, als die Halbleiterindustrie stetig wuchs und mit ihr der Bedarf nach kontrollierter Chipqualität. SÜSS war hier von Anfang an dabei und entwickelte Prober zur Qualitätskontrolle auf Wafern und Substraten.

## +++ Präzise und flexibel

Wann immer Mikrochips auf Herz und Nieren geprüft werden müssen, haben Test Systeme von SÜSS MicroTec ihren großen Auftritt. Ob es um Stichproben, optische Nachkontrollen oder um die individuelle Prüfung kleiner Chargen in Forschungslabors geht: Unsere Prober sind flexibel einsetzbar und auch auf ausgefallene Aufgaben vorbereitet.

# + + + Test Systeme

„DIE GUTEN INS TÖPFCHEN ...“

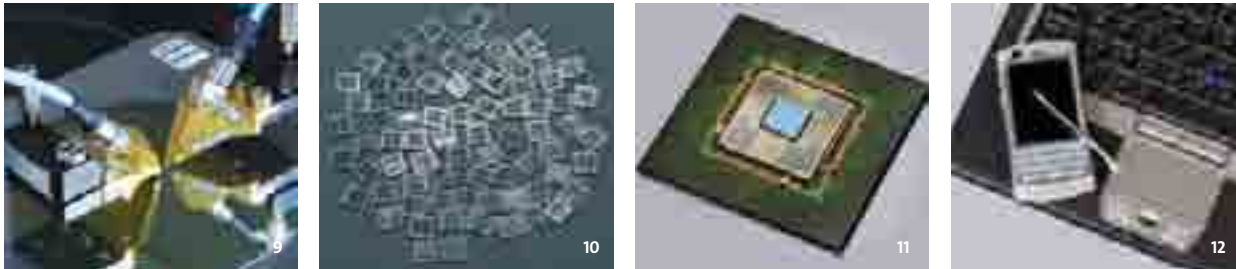


Im Bereich Test Systeme mit Sitz in Sacka bei Dresden konzentriert sich SÜSS MicroTec auf ein sehr spezielles Marktsegment: Hier steht nicht die Produktion, sondern die Analyse von elektronischen Bauteilen im Mittelpunkt. Beim Testen und Prüfen werden die elektrischen Funktionen von Bauteilen auf einem Mikrochip analysiert und bewertet – in Forschung, Entwicklung und auch bei der Massenproduktion. Da die Chipherstellung ständig komplexer und anspruchsvoller wird, erfordert auch das Testen immer genauere Verfahren. Nur sorgfältig auf Funktionalität und Lebensdauer geprüfte Chips garantieren uns letztlich einwandfreie Endprodukte wie Fotohandys, Autoairbags oder Playstations. Prober, wie die Testgeräte auch genannt werden, kommen deshalb in allen Produktionsmärkten zum Einsatz. Besonders wichtige Analysebereiche sind der Halbleitermarkt, die Hochfrequenztechnik, die Mikrosystemtechnik (MEMS) und die Optoelektronik.

## Strenge Qualitätskontrollen ...

Neben Funktionstests werden SÜSS MicroTec-Prober auch für die so genannte Chipcharakterisierung, die Fehleranalyse und für Zuverlässigkeitstests eingesetzt. Alle Test-Bereiche gewinnen an Bedeutung – und alle stellen sie die gleichen hohen Anforderungen an unsere Entwicklungsingenieure: Tests müssen immer schneller, kostensparender, individueller und gleichzeitig präziser ablaufen. Für den Nutzer von Unterhaltungselektronik lässt sich dieser Wandel in der Hightech-Welt am ehesten beim Blick in den Mikroprozessor begreifen: Anfang der 90er-Jahre fanden sich darin noch weniger als vier Millionen Transistoren. Heute sind es schon um die 50 Millionen Transistoren, die unserem PC zur vollen Leistungsfähigkeit verhelfen. Und künftig sollen 400 Millionen Transistoren und mehr im Computer Platz finden – obwohl er immer kleiner wird. Die Optimierung von Test- und Produktionsverfahren muss deshalb im Gleichschritt verlaufen – mit einem „kleinen Vorsprung“ für die Testgeräte. Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Millionen von Chips in Laptops und Handys auch funktionieren. Wird diese Qualitätskontrolle nicht ernst genug genommen, riskieren die Chiphersteller, dass sie fehlerhafte Bauteile an ihre Kunden ausliefern.

Deutlich wird das wiederum am Beispiel PC: Für eine einwandfreie PC-Funktionalität müssen Zuverlässigkeitstests durchgeführt werden. Bislang fanden diese nacheinander an Hunderten von einzelnen Chips statt oder aber nach dem Vereinzeln und Verkapseln dieser Bauelemente. Die Tests dauerten folglich pro Siliziumwafer bis zu 300 Stunden. Mithilfe der neuesten Prober-Generation reduziert sich die Testzeit jetzt von Wochen auf Stunden. Zum Beispiel analysiert ein manueller SÜSS MicroTec-Prober bereits auf Wafer-Ebene viele winzige Teststrukturen gleichzeitig. Diese Analysemethode ist weltweit ein absolutes Novum. Kunden profitieren davon in doppelter Hinsicht: Die Testdurchläufe sind erheblich schneller geworden, die Produktionskosten deutlich niedriger.



Mithilfe von Proben werden die Siliziumwafer effizient auf Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit getestet (9). Dazu werden sowohl elektrische als auch nicht-elektrische Testverfahren vor der Vereinzelung der Chips (10) eingesetzt. Der verdrahtete („verpackte“) Chip (11) findet dann seinen Einsatz in modernen Endgeräten, wie z. B. Laptops oder Handys (12).

## ... für einwandfreie Endprodukte

Zahlreiche Innovationen bietet SÜSS MicroTec auch für Prüfverfahren in der Mikrosystemtechnik an. Hier geht es um das Testen von Bauteilen, die eine elektrische mit einer mechanischen Funktion verbinden. Man spricht deshalb auch von MicroElectroMechanicalSystems (MEMS). Die hier zu fertigenden Sensoren – zum Beispiel in Airbags oder Navigationssystemen – sollen physikalische Größen wie Druck, Beschleunigung oder Kraft messen. Denn ein rein elektrisches Testverfahren, wie in der Mikroelektronik üblich, erlaubt in diesem Fall nur bedingt eine Aussage über die Funktionsfähigkeit des Sensors. Bei dem so genannten „on-wafer-testing“ für MEMS-Bauteile führen SÜSS MicroTec-Prober bereits während der Produktion dieser Mikrosysteme auf dem Wafer Testverfahren mit nicht-elektrischen Signalen durch. Unsere MEMS-Testgeräte überprüfen – etwa unter Einwirkung einer physikalischen Größe wie Druck oder Kraft, die Funktionsfähigkeit der Sensoren. Weil rund 60% der Gesamtkosten eines MEMS-Bauteils beim „Packaging“, dem Verpacken, anfallen, stellt das Testen und Aussortieren der funktionsfähigen MEMS-Sensoren sicher, dass wirklich nur die funktionierenden Teile den teuren Packaging-Schritt durchlaufen. SÜSS hält es mit dem Aschenputtel-Prinzip: „Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen.“ Wir helfen dadurch mit, die Produktion in der Mikrosystemtechnik effizienter zu machen und dadurch Kosten für die Kunden zu sparen.

Weil es inzwischen eine wahre Flut unterschiedlicher Sensortypen gibt, hat auch die Typenvielfalt der Prüfmodule in der Mikrosystemtechnik stark zugenommen. Viele dieser Module sind Sonderanfertigungen für unsere Kunden. Individuelle und flexible Lösungen stehen auch bei künftigen Innovationen im Mittelpunkt: Deshalb entwickelt SÜSS MicroTec Prober in enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden wie zum Beispiel den Fraunhofer-Instituten oder globalen Branchengrößen wie IBM oder Texas Instruments.



# + + + Investor Relations +

## Aktive Investor Relations-Arbeit

Seit ihrer ersten Börsennotierung im Jahr 1999 hat sich die SÜSS MicroTec AG stets zu einer aktiven und nachhaltig an den Interessen ihrer Aktionäre orientierten Investor Relations bekannt. Das Unternehmen sieht es deshalb als seine Pflicht an, die Öffentlichkeit regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu informieren. Neben dem Dialog mit privaten und institutionellen Investoren, steht der Kontakt mit Finanzanalysten und der Wirtschafts- und Finanzpresse im Vordergrund der Investor Relations-Aktivitäten.

Zielsetzung aller Investor Relations-Maßnahmen ist es dabei, ein tieferes Verständnis bei den verschiedenen Zielgruppen für die Geschäftsfelder der SÜSS MicroTec-Gruppe zu erzeugen und die unternehmerischen Perspektiven in den adressierten Märkten zu vermitteln.

So veröffentlicht das Unternehmen im Rahmen der Vorlage des Konzernabschlusses einen umfassenden Geschäftsbericht, der die Anteilseigner über die Unternehmensentwicklung und die Risiken der Unternehmenstätigkeit im abgeschlossenen sowie über die Perspektiven im neuen Geschäftsjahr informiert. Der Geschäftsbericht wird jedem Interessenten als Druckversion zur Verfügung gestellt, kann aber auch in Form einer pdf-Datei auf der Homepage der SÜSS MicroTec AG [www.suss.com](http://www.suss.com) heruntergeladen werden. Darüber hinaus veröffentlicht das Unternehmen Quartals- und Halbjahresfinanzberichte.

Neben den Pflichtveröffentlichungen im Rahmen der Unternehmensberichterstattung und der Ad-hoc-Publizität informiert die SÜSS MicroTec AG auf der Basis von Pressemitteilungen regelmäßig ihre Anteilseigner sowie die Finanzöffentlichkeit über aktuelle, für die Entwicklung des Unternehmens wichtige Ereignisse.

## Hauptversammlung bestätigt Unternehmenskurs

Am 6. Juli 2007 begrüßten der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG rund 160 private Aktionäre, institutionelle Investoren und Pressevertreter zur ordentlichen Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München. Im Rahmen der Tagesordnung erläuterte der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Schneidewind die Unternehmensergebnisse des Geschäftsjahres 2006 und stellte die Schwerpunkte der Vorstandstätigkeit dar. Im Anschluss daran sprachen sich die anwesenden Aktionäre erneut klar für die Arbeit des Vorstands und des Aufsichtsrats aus. Alle Beschlussvorschläge wurden von den Aktionären mit großer Mehrheit angenommen.







## Die Entwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie

Das Jahr 2007 war an den internationalen Aktienmärkten trotz einer insgesamt positiven Stimmung von einigen Tiefschlägen geprägt. Rekordölpreise, ein schwacher US-Dollar sowie insbesondere die US-Hypothekenkrise hinterließen deutliche Spuren. Während die maßgeblichen Indizes an den europäischen Börsen per Jahressaldo nur moderate Zuwächse zu verzeichnen hatten, konnten der DAX und der TecDAX mit einem Plus von 22,3 % bzw. 30,2 % abschließen.

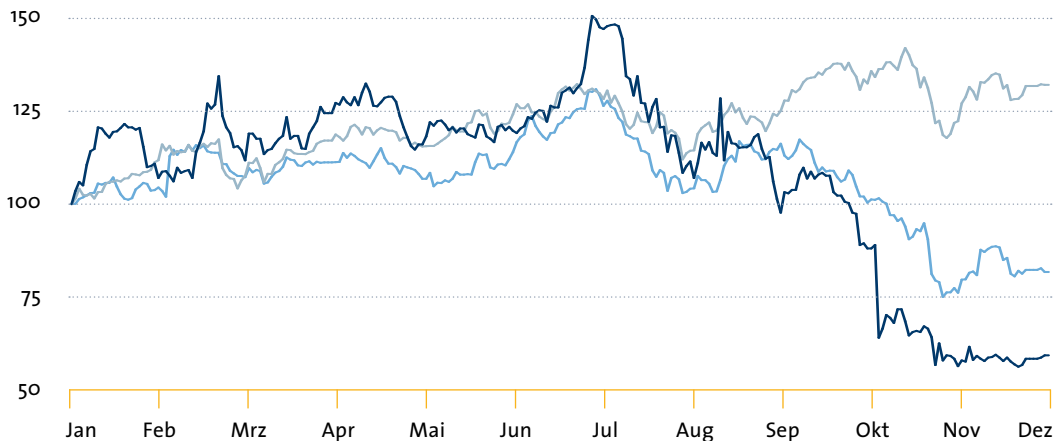
Die Entwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie wurde neben der allgemeinen Marktunsicherheit in der zweiten Jahreshälfte vor allem durch die von der Gesellschaft am 29. Oktober 2007 ausgegebene Gewinnwarnung belastet. Auf Grund der unter den Erwartungen gebliebenen Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2007 musste die SÜSS MicroTec-Aktie im Vergleich zum Vorjahr einen Wertabschlag von rund 39 % hinnehmen und notierte am 31. Dezember 2007 mit 4,29 € deutlich unter dem Jahresanfangskurs von 7,05 €.

Mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von 110.882 Stück an allen deutschen Börsenplätzen war die Handelbarkeit auch für institutionelle Anleger im Geschäftsjahr 2007 gewährleistet. Der durchschnittliche Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie lag im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 bei 7,53 €.

### Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie in 2007

Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2007: 7,05 €

- SÜSS MicroTec AG, indiziert
- TecDAX
- Prime IG Semiconductor, indiziert





# + + Corporate Governance

Das Vertrauen in die Unternehmensführung und in das Kontrollsystem einer Aktiengesellschaft stellt einen wesentlichen Faktor für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung dar. Um den Finanzplatz Deutschland zu stärken und das Vertrauen in diesen weiter zu verbessern, verabschiedete die von der Bundesministerin der Justiz eingesetzte Regierungskommission am 23. Januar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex.

Er enthält neben der Kurzdarstellung wesentlicher gesetzlicher Bestimmungen sowohl Empfehlungen als auch Anregungen für eine gute Corporate Governance. Es besteht keine gesetzliche Pflicht, den dort aufgeführten Standards nachzukommen, jedoch sind börsennotierte Gesellschaften nach dem § 161 AktG verpflichtet, im Sinne eines „comply or explain“ jährlich eine Entsprechungserklärung zu den aktuellen Kodex-Empfehlungen abzugeben. Der Kodex wird jedes Jahr – vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen – überprüft und bei Bedarf angepasst. Der aktuelle Deutsche Corporate Governance Kodex wurde am 14. Juni 2007 aktualisiert und am 20. Juli 2007 in seiner überarbeiteten Fassung veröffentlicht.

Eine verantwortungsvolle und faire Unternehmensführung, die von einer effizienten Zusammenarbeit zwischen Vorstand und dem Aufsichtsrat des Unternehmens ausgeht, nimmt einen hohen Stellenwert bei der SÜSS MicroTec AG ein. Aus diesem Grund begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat von SÜSS MicroTec sämtliche Initiativen und Empfehlungen zum Thema Corporate Governance Kodex. Die jährliche Corporate Governance Erklärung stellt daher vor allem eine Selbstverpflichtung des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG gegenüber der Öffentlichkeit dar, eine faire und verantwortungsvolle Unternehmenspolitik mit dem Ziel umzusetzen, die Interessen der Aktionäre, der Kunden, der Geschäftspartner und der Mitarbeiter zu berücksichtigen und so das Vertrauen in die Unternehmensführung und -kontrolle zu stärken.

So zählt ein großer Teil der Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex bereits seit längerem zum festen Bestandteil der Unternehmens- und Kommunikationsgrundsätze von SÜSS MicroTec.

## Entsprechenserklärung

Am 19. Dezember 2007 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechungserklärung gemäß § 161 AktG erneut abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 12. Juni 2006 mit zwei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung und der erfolgsorientierten Vergütung des Aufsichtsrats – entsprochen haben und zukünftig auch der aktualisierten Fassung vom 14. Juni 2007 entsprechen werden.



Die insgesamt zwei Abweichungen zu den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex werden nachfolgend erläutert:

- + In **Ziffer 3.8** empfiehlt der Kodex, im Falle des Abschlusses einer Directors & Officers-Versicherung (D&O-Versicherung) für den Vorstand und den Aufsichtsrat die Vereinbarung eines angemessenen Selbstbehalts. Bei der von der SÜSS MicroTec AG und ihren Tochterunternehmen abgeschlossenen D&O-Versicherung handelt es sich um eine Gruppenversicherung für eine größere Anzahl von Mitarbeitern ohne organspezifischen Selbstbehalt. Die SÜSS MicroTec AG vertritt die Auffassung, dass ein Selbstbehalt im Hinblick auf die Verantwortung und Motivation der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer gewissenhaften und verantwortungsvollen Unternehmensführung nicht erforderlich ist.
- + Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in **Ziffer 5.4.7** eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern sowie eine Vergütung für die Mitgliedschaft und den Vorsitz in Ausschüssen. Abweichend von dieser Empfehlung besteht die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder aus einem Fixum und enthält keinen erfolgsorientierten Bestandteil. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist darüber hinaus in § 13 der Satzung festgelegt. Die Mitgliedschaft in Ausschüssen findet dadurch Berücksichtigung, dass für die Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses ein Sitzungsgeld gezahlt wird. Der Vorsitz in Ausschüssen wird nicht besonders vergütet.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechungserklärung sowie aller vorhergehenden sind auf der Internetseite der SÜSS MicroTec AG unter [www.suss.com](http://www.suss.com) veröffentlicht.

Von den Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex können Unternehmen auch ohne Erklärungs-pflicht abweichen. Im Sinne einer größtmöglichen Transparenz für ihre Anteilseigner, nimmt die SÜSS MicroTec AG jedoch in jedem Jahr auch zur Umsetzung der Anregungen Stellung. Die SÜSS MicroTec AG befolgt die Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex mit folgenden wenigen Ausnahmen:

- + Abweichend von Ziffer 2.3.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.
- + In Ziffer 2.3.4 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird dazu angeregt, den Aktionären der Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (z. B. Internet) zu ermöglichen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.
- + Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet abweichend von Ziffer 3.6 Abs. 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratsitzungen statt.
- + Abweichend von der Anregung in Ziffer 5.4.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex laufen die Amtszeiten der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht zu unterschiedlichen Terminen aus.
- + Abweichend von der Anregung in Ziffer 5.4.7 Abs. 2 Satz 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex erhält der Aufsichtsrat keine auf den langfristigen Unternehmenserfolg bezogene Vergütungskomponente, sondern eine feste Vergütung.



## Aktionäre und Hauptversammlung

Die SÜSS MicroTec AG informiert ihre Aktionäre über die Geschäftsentwicklung sowie die aktuelle Finanz- und Ertragslage kontinuierlich durch Pressemitteilungen, durch die Veröffentlichung von Geschäfts- und Quartalsberichten, in zahlreichen Einzelgesprächen sowie auf der jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung. Die Hauptversammlung dient den Aktionären als Plattform zur Diskussion mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat sowie zur Stimmrechtsausübung. Die Hauptversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats und beschließt die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Darüber hinaus entscheidet die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und die Zustimmung zu wichtigen Unternehmensverträgen sowie über Änderungen der Satzung der Gesellschaft.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fand die ordentliche Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG am 6. Juli 2007 im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Im Verlauf der Hauptversammlung stimmten die Aktionäre über die einzelnen Tagesordnungspunkte, wie Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Änderungen der Satzung und die Wahl des Abschlussprüfers ab. Weiterhin standen die Beschlussfassungen der Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2002/I auf der Tagesordnung.

## Enge Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat

Die Unternehmensführung der SÜSS MicroTec AG ist durch eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt. Beide Organe der Gesellschaft sind an das Unternehmensinteresse gebunden und verpflichten sich zur nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts. Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der strategischen Ausrichtung, der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements und der Compliance.

## Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 1. August 2007 wurde Michael Knopp zum neuen Finanzvorstand der Gesellschaft berufen. Der Diplom-Kaufmann trat damit die Nachfolge von Stephan Schulak an, der nach insgesamt fünf Jahren Vorstandstätigkeit für die SÜSS MicroTec AG zum 31. März 2007 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus der Gesellschaft ausgeschieden war. In der Zeit vom 1. April 2007 bis zum 30. September 2007 war Dr. Stefan Reineck Mitglied des Vorstands. Bis zum Eintritt von Herrn Knopp als Finanzvorstand verantwortete er die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern, Versicherungen und Personal, danach den Bereich Strategie.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 wurde Dr. Stefan Reineck in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gewählt. Er löste Dr. h.c. Horst Görtz ab. Des Weiteren schied Dr. Christoph Schücking mit Wirkung zum 6. Juli 2007 als Mitglied des Aufsichtsrats aus seinem Amt aus. Ihm folgte Heinz-Peter Verspay, Rechtsanwalt aus Köln, nach.







Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Demnach erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung in Höhe von 15.000 € pro Geschäftsjahr zuzüglich Sitzungsgeldern, wobei der Aufsichtsratsvorsitzende jeweils das Dreifache und sein Stellvertreter das Anderthalbfache der Vergütung eines einfachen Mitglieds erhält. Das Sitzungsgeld dient der Vergütung der Ausschusstätigkeit und ist Instrument, um eine hohe Präsenz der AR-Mitglieder bei den Sitzungen zu gewährleisten. Im Geschäftsjahr 2007 haben die Mitglieder des Aufsichtsrats mit einer Ausnahme keine Vergütungen bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten. Die Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle, deren Partner Dr. Christoph Schücking bis zum 6. Juli 2007 ebenfalls Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG war, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für ihre Beratungsleistungen für Unternehmen der SÜSS MicroTec-Gruppe insgesamt 142.874,81 € erhalten. Im Übrigen wird auf die Angaben unter Textziffer (32) des Anhangs zu den nahe stehenden Personen verwiesen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nach der Überzeugung des Vorstands und des Aufsichtsrats hinreichend unabhängig. An die Mitglieder des Aufsichtsrats hat die SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2008 für das Geschäftsjahr 2007 folgende Vergütungen gezahlt:

Aufsichtsrat	Vergütung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 der Satzung in €	Sitzungsgeld gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 der Satzung in €	Auslagenersatz und 19 % MwSt. abzgl. 30 % AR-Steuer etc. (§ 13 Abs. 4 der Satzung) in €
Dr. Winfried Süß* (Aufsichtsratsvorsitzender)	0	0	0
Gerhard Rauter (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	22.500	22.500	2.684,87 abzgl. 1.048,00 D&O- Versicherung = 1.636,87
Dr. h.c. Horst Görtz <sup>a</sup>	11.250	19.500	3.360,41 zzgl. 5.842,50 MwSt. abzgl. 524,25 D&O- Versicherung = 8.678,66
Peter Heinz, MBA	15.000	13.500	9.923,94 abzgl. 9.020,25 AR-Steuer und 699,00 D&O- Versicherung = 204,69
Prof. Dr. Anton Heuberger	15.000	10.500	2.804,93 zzgl. 4.845,00 MwSt. abzgl. 699,00 D&O- Versicherung = 6.950,93
Dr. Christoph Schücking <sup>b</sup>	7.500	9.000	848,38 zzgl. 3.135,00 MwSt. abzgl. 349,50 D&O- Versicherung = 3.633,88
Dr. Stefan Reineck <sup>c</sup>	3.750	1.500	997,50 MwSt. abzgl. 174,75 D&O-Versicherung = 822,75
Heinz-Peter Verspay <sup>d</sup>	7.500	6.000	2.565,00 MwSt. abzgl. 349,50 D&O-Versicherung = 2.215,50

\* Herr Dr. Winfried Süß hat im Geschäftsjahr 2007 auf seine Vergütung in Höhe von 72 T€ (davon 27 T€ Sitzungsgelder) verzichtet.

<sup>a</sup> Mitglied des Aufsichtsrats bis 30. September 2007

<sup>b</sup> Mitglied des Aufsichtsrats bis 6. Juli 2007

<sup>c</sup> Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Oktober 2007

<sup>d</sup> Mitglied des Aufsichtsrats seit 6. Juli 2007



### Personelle Zusammensetzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse sowie Funktionen der einzelnen Mitglieder

	Aufsichtsrat	Audit		Personal	Technologie	Finanzierung
		Committee	Nominierung			
Dr. Winfried Süß	Vorsitzender	Mitglied	Vorsitzender	Vorsitzender	Vorsitzender	Mitglied
Gerhard Rauter	Stellvertretender Vorsitzender			Mitglied	Mitglied	
Dr. h.c. Horst Görtz	Mitglied			Mitglied		
Peter Heinz	Mitglied	Vorsitzender			Mitglied	Vorsitzender
Prof. Dr. Anton Heuberger	Mitglied				Mitglied	
Dr. Stefan Reineck	Mitglied		Mitglied	Mitglied		
Heinz-Peter Verspay	Mitglied	Mitglied				Mitglied
Dr. Christoph Schücking	Mitglied	Mitglied				Mitglied

### Directors' Dealings und Anteilsbesitz

Seit 1. Juli 2002 müssen u. a. die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats eines deutschen börsennotierten Unternehmens sowohl dem Unternehmen als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitteilen, wenn sie Aktien des Unternehmens oder mit diesen Aktien verbundene Rechte erwerben oder veräußern. Diese Pflicht gilt gleichermaßen für bestimmte mit den Vorstands- bzw. Aufsichtsratsmitgliedern eng verbundene Personen. Im Geschäftsjahr 2007 sind der SÜSS MicroTec AG folgende Mitteilungen über Erwerb und Veräußerungen von SÜSS-Aktien durch Organmitglieder und diesen nahe stehende Personen gemäß § 15a WpHG zugegangen:

- + Michael Knopp (Finanzvorstand seit 1. August 2007):  
Kauf von 5.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 24.977,00 € am 29.10.2007
- + Dr. Stefan Schneidewind (Vorstandsvorsitzender):  
Kauf von 5.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 24.850,00 € am 29.10.2007
- + Dr. Stefan Reineck (Mitglied des Aufsichtsrats):  
Kauf von 1.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 4.740,00 € am 29.10.2007
- + Stephan Schulak (Finanzvorstand bis 31. März 2007):  
Verkauf von 25.000 SÜSS MicroTec-Stückaktien zum Preis von insgesamt 213.500,00 € am 22.02.2007



## Aktienoptionsprogramme

Die SÜSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktienoptionsplänen ein wichtiges Element der Mitarbeiterbeteiligung am Erfolg des Unternehmens sowie die Möglichkeit, Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über zwei Aktienoptionsprogramme. In beiden Fällen können die Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundenen nachgeordneten Unternehmen i. S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

### Aktienoptionsprogramm 1999

Die zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 unter dem Aktienoptionsprogramm 1999 ausstehenden 68.000 Optionen sind verfallen. Die Laufzeit des Aktienoptionsprogramms 1999 endete im Mai 2007.

### Aktienoptionsprogramm 2002

Aus dem von der Hauptversammlung am 14. Juni 2002 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2002 waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 39.900 Optionen (davon 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands) ausstehend.

Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 12.200 Bezugsrechte ausgeübt. 4.500 Optionen, die 2003 ausgegeben worden waren, wurden zum Bezugspreis von 1,11 € ausgeübt. 7.700 der in 2004 ausgegebenen Optionen wurden zum Bezugspreis von 3,44 € ausgeübt. Im Geschäftsjahr 2007 sind 1.550 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2002 verfallen. Am Ende des Geschäftsjahres standen insgesamt 26.150 Optionen aus dem Optionsprogramm 2002 aus. Davon können 7.500 Optionen bis zum Ausübungszeitraum Mai 2009 zu einem Ausübungspreis von 1,11 € und 18.650 Optionen zu einem Ausübungspreis i. H. v. 3,44 € bis zum Ausübungszeitraum August 2010 ausgeübt werden, wenn eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen ist und sich der Börsenkurs der Gesellschaft in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt hat als der Nemax oder sein Nachfolgeindex TecDAX oder (ii) wenn der Börsenkurs der SÜSS-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen ist.



### Aktienoptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2007 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 309.000 Optionen aus. Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 347.300 Optionen zu Bezugspreisen von 8,39 € bzw. 8,42 €, davon 110.000 zum Bezugspreis von 8,39 € und 30.000 zum Bezugspreis 8,42 € an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 13.500 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2007 verfallen. Im Geschäftsjahr 2007 wurden keine Optionen aus diesem Programm ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 642.800 Stück, davon wurden 220.000 an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der 2-jährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) der Börsenkurs der SÜSS-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 % p. a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDAX oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 10 % p. a. gestiegen. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 4,95 € für 136.500 am 31. August 2005 ausgegebene Optionen, 7,53 € für 159.000 am 8. Juni 2006 ausgegebene Optionen sowie 8,39 € für 317.300 am 23. Mai 2007 ausgegebene Optionen und 8,42 € für 30.000 am 22. August 2007 ausgegebene Optionen.

## Rechnungslegung und Abschlussprüfung

Die Rechnungslegung der SÜSS MicroTec-Gruppe erfolgt auf der Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS). Der Einzelabschluss wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Der Konzernabschluss wird vom Vorstand aufgestellt und vom Aufsichtsrat gebilligt. Ein internes Kontrollsystem sowie einheitliche Bilanzierungsgrundsätze stellen sicher, dass in allen wesentlichen Punkten ein angemessenes Bild der Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens wiedergegeben wird. Der ausführliche Risikobericht der Gesellschaft, der über den verantwortungsvollen Umgang des Unternehmens mit den unterschiedlichen Risikoarten informiert, ist auf den Seiten 59 bis 64 des Geschäftsberichts veröffentlicht.

Am 6. Juli 2007 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2007 die KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus München zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG.





## Besitz von Aktien und Bezugsrechten

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2007 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2007	Veränderung gegenüber 31.12.2006	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2007	Veränderung gegenüber 31.12.2006
<b>Aufsichtsrat</b>				
Dr. Winfried Süß	1.131.000	-	0	-
Gerhard Rauter	0	-	0	-
Dr. h.c. Horst Görtz <sup>a</sup>	17.216	-	0	-
Peter Heinz, MBA	1.338	-	0	-
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	-	0	-
Dr. Christoph Schücking <sup>b</sup>	500	-	0	-
Dr. Stefan Reineck <sup>c</sup>	1.600	+1.600	40.000	+40.000
Heinz-Peter Verspay <sup>d</sup>	0	-	0	-
<b>Vorstand</b>				
Dr. Stefan Schneidewind	18.278	+5.000	150.000	+70.000
Michael Knopp <sup>e</sup>	5.000	+5.000	30.000	+30.000
Dr. Stefan Reineck <sup>f</sup>	1.600	+1.600	40.000	+40.000
Stephan Schulak <sup>g</sup>	0	-25.000	0	-

<sup>a</sup> Mitglied des Aufsichtsrats bis 30. September 2007

<sup>b</sup> Mitglied des Aufsichtsrats bis 6. Juli 2007

<sup>c</sup> Mitglied des Aufsichtsrats seit 1. Oktober 2007

<sup>d</sup> Mitglied des Aufsichtsrats seit 6. Juli 2007

<sup>e</sup> Mitglied des Vorstands seit 1. August 2007

<sup>f</sup> Mitglied des Vorstands bis 30. September 2007

<sup>g</sup> Mitglied des Vorstands bis 31. März 2007



# +++ Konzernlagebericht +++

## und Lagebericht der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2007

### Geschäft und Rahmenbedingungen

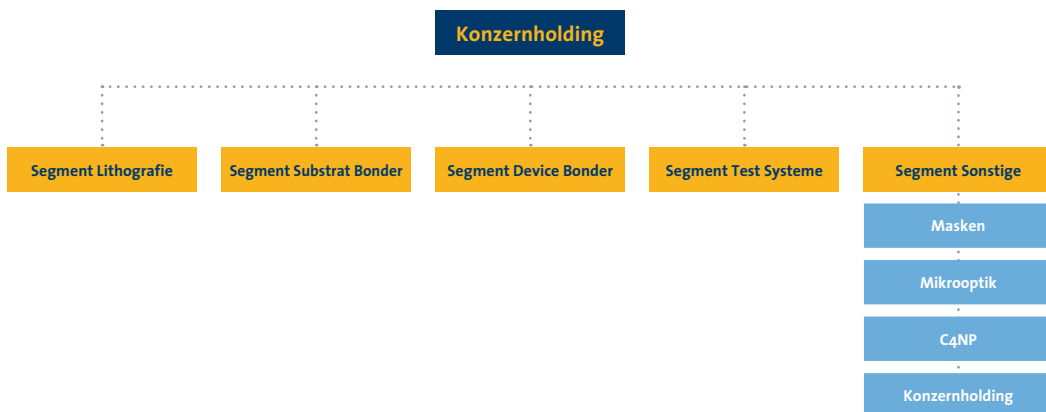
#### Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

##### Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

Der SÜSS MicroTec-Konzern fertigt und vertreibt Anlagen und Prüfsysteme für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

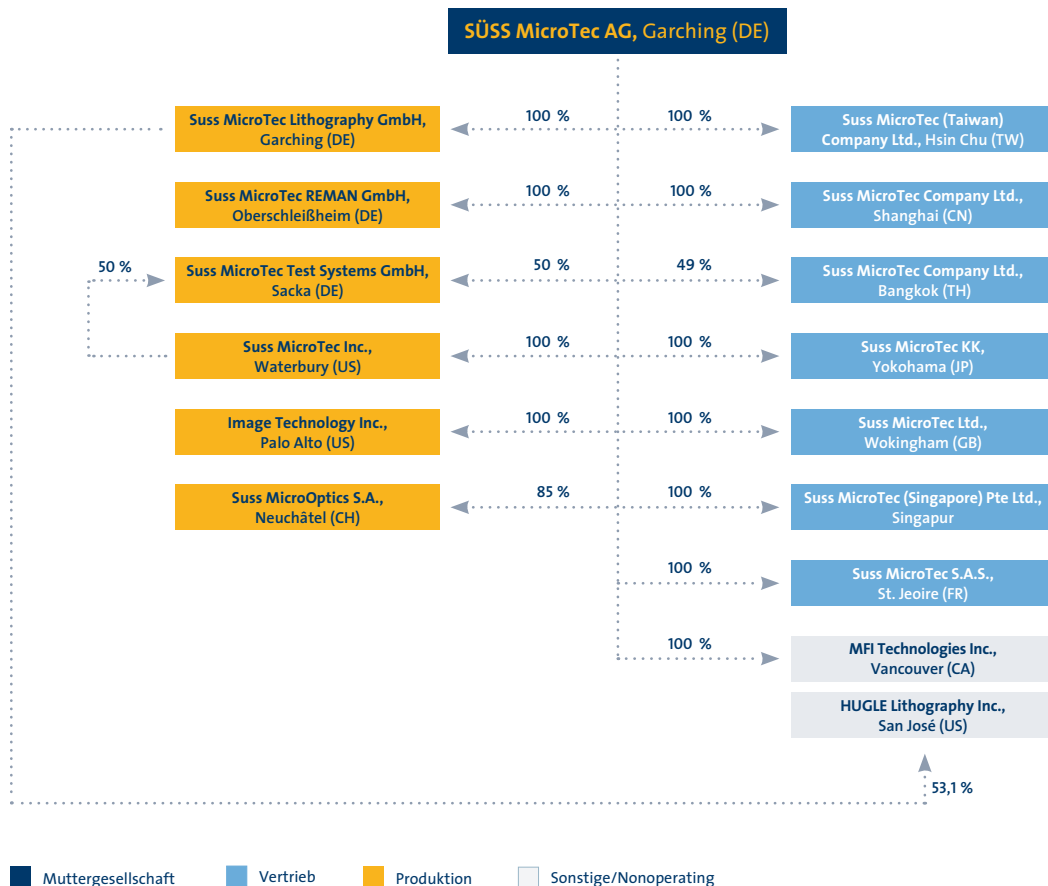
Der Konzern ist in fünf Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Der folgende Lagebericht bezieht sowohl die fortgeführten als auch die nicht fortgeführten Aktivitäten des Konzerns in die Betrachtung mit ein. Zu den nicht fortgeführten Aktivitäten des Geschäftsjahres 2007 zählt das Segment Device Bonder, welches mit Wirkung zum 16. Juli 2007 im Rahmen eines MBO („Management-Buy-Out“) veräußert wurde.





### Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt unter anderem über Standorte in Deutschland, den USA, Frankreich, Japan, China und Taiwan.



Im zweiten Quartal wurde die neugegründete Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd. in den Konsolidierungskreis einbezogen, an der die SÜSS MicroTec AG mit 100 % beteiligt ist. Bei der Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd. handelt es sich um eine reine Vertriebsgesellschaft, die vor allem die Präsenz der Division „Test Systeme“ in Singapur verstärken soll. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis ist für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns nicht wesentlich.

Im dritten Quartal hat die SÜSS MicroTec AG ihre inaktive Beteiligung an der Suss MicroTec Laboratory Equipment GmbH an die Suss MicroTec Lithography GmbH verkauft. Im Anschluss wurde die Suss MicroTec Laboratory Equipment GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2007 auf die Suss MicroTec Lithography GmbH verschmolzen. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis hat keine Auswirkung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.

Daneben bestehen noch geringfügige Beteiligungen an folgenden Gesellschaften:

- + 10 % Zentrum für Technologiestrukturentwicklung, Glaubitz (DE)
- + 10 % ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT)

Diese geringfügigen Beteiligungen haben unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft sowie die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.

## Leitung und Kontrolle

### Personalveränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Mit Wirkung zum 1. August 2007 wurde Michael Knopp zum neuen Finanzvorstand der Gesellschaft berufen. Der Diplom-Kaufmann trat damit die Nachfolge von Stephan Schulak an, der nach insgesamt fünf Jahren Vorstandstätigkeit für die SÜSS MicroTec AG zum 31. März 2007 im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aus der Gesellschaft ausschied. In der Zeit vom 1. April 2007 bis zum 30. September 2007 war Dr. Stefan Reineck Mitglied des Vorstands. Bis zum Eintritt von Herrn Knopp als Finanzvorstand verantwortete er die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Recht, Steuern, Versicherungen und Personal, danach den Bereich Strategie.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2007 wurde Dr. Stefan Reineck in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gewählt. Er löste Dr. h.c. Horst Görtz ab. Des Weiteren schied Dr. Christoph Schücking mit Wirkung zum 6. Juli 2007 als Mitglied des Aufsichtsrats aus seinem Amt aus. Ihm folgte Heinz-Peter Verspay, Rechtsanwalt aus Köln, nach.



### Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Demnach erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine feste Vergütung in Höhe von 15.000 € pro Geschäftsjahr zuzüglich einem Sitzungsgeld von je 1.500 € je Sitzung. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält dabei das Dreifache und sein Stellvertreter das Anderthalbfache der Vergütung eines einfachen Mitglieds.

### Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Performance der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellkosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem Ergebnis vor Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus Währungsumrechnung und Anlagenabgängen, vor Zinserträgen und -aufwendungen sowie vor Ertragsteuern. Es werden keine kalkulatorischen Kostenpositionen verwendet, so dass die Werte für die interne Steuerung direkt auf die veröffentlichten Werte gemäß IFRS-Rechnungslegung übergeleitet werden können.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Net Cash Position (Flüssige Mittel abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

## Forschung und Entwicklung

Im Folgenden werden die wesentlichen neuen Produkte und Entwicklungen der jeweiligen Segmente bzw. Unter-einheiten dargestellt und erläutert.

### Lithografie

Für die Anwendungen Wafer-Bumping und die Massenproduktion von Leuchtdioden (LED) wurde unter der Bezeichnung Gamma Xpress ein neues Produktionscluster für die Beschichtung und Entwicklung von Lithografie-lacken auf den Markt gebracht. Die modulare Bauweise erlaubt es, sehr schnell für typische Anwendungen ein genau passendes Cluster zu konfigurieren. Aber nicht nur die Konfiguration wird erleichtert, auch die Herstellungszeit der Maschine wird dadurch wesentlich verkürzt und somit die Lieferbarkeit optimiert. Häufig ist es für Kunden, die innovative Halbleiterprodukte herstellen, sehr wichtig, eine Produktionslinie schnell aufstellen und „einfahren“ zu können. Beides wird durch das neue Maschinenkonzept unterstützt. So wird das für den Kunden kritische „time-to-market“ durch SÜSS verkürzt. Weitere Anwendungen dieses neuen Produktionsclusters liegen in den Bereichen Gold Bump Coating, wie es bei den Ansteuerungsbausteinen von Flachbildschirmen verwendet wird, und bei der Fertigung von Metallbahnen bei der Umverdrahtung von Chips. Zu den organisatorischen Maßnahmen gehörte in 2007 auch die Zertifizierung der Entwicklungsprozesse gemäß ISO 9001.

### Substrat Bonder

2007 wurde das erste Produktionscluster ELAN CBC300SOI an einen führenden Hersteller von Silicon-on-Insulator (SOI) Wafern ausgeliefert. Diese vorbehandelten („engineered“) Wafer werden zunehmend für die Herstellung schneller und gleichzeitig stromsparender Prozessoren eingesetzt. Die Vorbehandlung dieser Wafer beinhaltet die flächige Verbindung eines 300-mm-Siliziumwafers mit einem Substrat aus elektrisch isolierendem Material, was über einen Bondprozess erfolgt. Bei der Herstellung ist es äußerst wichtig, Verunreinigungen – auch durch allerfeinste Partikel – zu vermeiden. Auch muss der hier verwendete Fusionsprozess schnell und kontrolliert ablaufen, um beste Resultate zu erzielen. Das neue Bondercluster verfügt auch über eine vollautomatisierte Lade- und Entnahmevorrichtung für Wafer, was den Durchsatz der Gesamtanlage maximiert.

Mit dem Aufkommen der 3D-Technologie wird es notwendig, die existierenden 200-mm-Tools auf 300-mm-Wafer-Durchmesser aufzurüsten. Dies ist ebenfalls ein Schwerpunkt unserer F&E-Aktivitäten im Segment Substrat Bonder. Technologisch besteht die Herausforderung darin, Kenngrößen wie die Justiergenauigkeit, die Temperaturkontrolle und andere auch im 300-mm-Bereich zu gewährleisten.

Ein dritter Fokus im Bereich F&E ist die Entwicklung eines kosteneffizienten Metall-Bond-Prozesses, der bestehende Bond-Prozesse, wie das Anodische Bonden und das Glasfritt-Bonden, ersetzen kann.

### C4NP

Der Partner und erste Kunde IBM konnte im Sommer des vergangenen Jahres den erfolgreichen Einsatz des von uns gelieferten Entwicklungstools für die „High-Volume-Production“ vermelden – einschließlich der hausinternen Zertifizierung, deren Ergebnisse teilweise auch für die Fachwelt veröffentlicht wurden.

### Test Systeme

Um kleinste elektrische Signale an Wafern messen zu können, muss der gesamte Testaufbau elektromagnetisch gegen die heute überall vorhandenen Störwellen abgeschirmt werden. Dies leistet eine besondere Geräteklasse unserer Test Systeme mit der Markenbezeichnung „ProbeShield“. 2007 wurde eine nächste Generation des PA300 ProbeShield entwickelt. Insbesondere wurden die messtechnischen Eigenschaften des Geräts verbessert. Eine deutliche Abgrenzung vom Wettbewerb konnte durch die Entwicklung von Messeinrichtungen für Rauschmessungen (1/f-Messungen) erfolgen. Diese Messungen werden in zunehmendem Maße für die Device- und Wafercharakterisierung (DWC) eingesetzt. Entsprechende Schutzrechte wurden angemeldet.

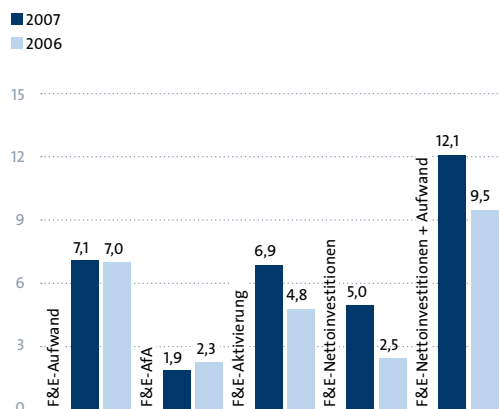
Weiterhin wurden Komponenten entwickelt, um die 300-mm-Prober für Zuverlässigkeitsmessungen im Bereich Wafer Level Reliability (WLR) nutzbar zu machen. Auch spezielle Kontaktierungssysteme für Hochtemperatur-Probecards konnten zum Patent angemeldet werden.

Wesentliche Verbesserungen konnten außerdem auf dem Gebiet der Bilderfassung und Bildverarbeitung für Prober eingeführt werden. Das neuentwickelte digitale Mikroskop-Kamera-System iVista bietet hohe Auflösung und schnelle Bilderfassung. Damit kann die Maschine gleichzeitig schnell und scharf „sehen“, somit schneller und genauer die Messnadeln auf den Wafer setzen und damit produktiver werden.

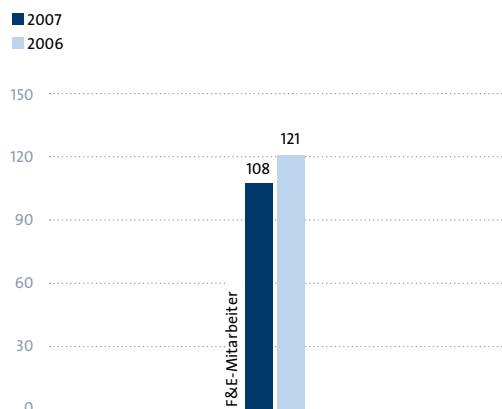
Die gesamten Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen im Jahresvergleich von 9,5 Mio. € auf 12,1 Mio. €. Schwerpunkt innerhalb der Aktivierung von Entwicklungsleistungen war das Projekt C4NP.



F&E-Ausgaben im Jahresvergleich  
in Mio. €



F&E-Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



## Überblick über den Geschäftsverlauf

### Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 2007 um 3,6 %. Der Rückgang gegenüber der Wachstumsrate von 3,9 % im Jahr 2006 ist unter anderem auf steigende Ölpreise und höhere Zinssätze zurückzuführen. Für Gesamteuropa betrug die BIP-Wachstumsrate 2,9 % nach 3,2 % in 2006, für die westeuropäischen Staaten 2,7 % in 2007 nach 3,0 % in 2006. Die Gründe für das langsamere Wachstum sind die Abkühlung der Weltwirtschaft sowie Belastungen des Exports durch einen stärkeren Euro. Für Deutschland ergab sich auf Grund der Euro-Aufwertung und höheren Steuern eine Verlangsamung des Wachstums auf 2,5 % (2006: 2,9 %). Mit einem Plus von 6,1 % wuchsen die Wirtschaften der Staaten Mittel- und Osteuropas wesentlich schneller und erreichten fast das Niveau von 2006 (6,3 %). Auf dem amerikanischen Kontinent verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum von 3,2 % auf 2,5 % in 2007, was hauptsächlich auf einen Rückgang der Wachstumsrate in den USA von 2,9 % in 2006 auf 2,0 % in 2007 zurückzuführen ist. Zu den Faktoren, die das Wachstum in den USA verlangsamten, gehören Abschwächungen am Immobilienmarkt und im Wohnungsbau, die die Konsumentennachfrage wie auch die Beschäftigung im Bausektor und in damit verbundenen Branchen drückten, sowie die Unsicherheit an den Finanzmärkten nach erheblichen Abschreibungen bei Großbanken auf Kredite an Hypothekenschuldner mit geringer Bonität.

Die Region Asien/Pazifik konnte einen Anstieg des Wachstums auf 5,7 % (2006: 5,5 %) verzeichnen. China und Indien waren hier abermals die wesentlichen Wachstumstreiber. Für die chinesische Wirtschaft, die von den boomenden Infrastrukturinvestitionen, einer starken Exportindustrie sowie erheblich steigender Teilhabe der einheimischen Haushalte an den Kapitalmärkten mit einer im internationalen Vergleich hohen Sparquote profitierte, wurde ein Wachstum von 11,5 % in 2007 errechnet.

### Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Der Vereinigung der Halbleiterindustrie Semiconductor Industry Association (SIA) zufolge verzeichnete die Halbleiterbranche in 2007 weltweit ein Umsatzplus von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr auf 255,6 Milliarden US-Dollar. Grund hierfür waren nach Einschätzung der SIA die guten Verkaufszahlen für Geräte mit einem hohen Anteil an Halbleiter-Chips. Demnach stieg der Absatz von PCs um 13,8 %. Handys, Digitalkameras und MP3-Player konnten ein Umsatzplus von jeweils 20 % verzeichnen. Der LCD-TV-Verkauf stieg in 2007 sogar um 50 %. Parallel dazu nahm der Preisdruck in der Halbleiterbranche weiter zu. War ein typischer PC 2007 mindestens 100-mal leistungsfähiger als ein vergleichbarer vor 10 Jahren, kostete er 2007 hingegen nur noch rund ein Drittel. Im Speicherbereich (DRAMs) fiel der mittlere Verkaufspreis (ASP) in 2007 um 39 %, was in der Branche trotz fast verdoppelter Stückzahlen zu einem Umsatzverlust von 7,4 % führte. Nach Angaben des Elektronikverbands ZVEI ging der Umsatz im deutschen Halbleitermarkt 2007 um rund 4 % im Vergleich zum Vorjahr zurück. Hauptursache hierfür sei der starke Euro-Kurs gewesen.

Das oben beschriebene Marktumfeld bewirkte, dass der globale Absatz von Maschinen, Ausrüstungen und Automatisierungstechnik für die Produktion von Halbleitern und Mikroelektronikbauteilen (MEMS) nach dem starken Wachstum 2006 eine kleine Verschnaufpause einlegte. Stärkere Impulse gingen lediglich von den weiterhin hohen Investitionen in die 300-mm-Technologie sowie von steigenden Investitionen in 45-Nanometer-Tools aus. Regional verbuchten vor allem Taiwan und die Volksrepublik China Umsatzzuwächse, während die Umsätze mit Equipment in Nordamerika und Europa stagnierten oder sogar leicht rückläufig waren.

### Unternehmensentwicklung

Nachdem das Jahr 2006 den Turnaround und einen Umsatzanstieg um 32,3 % gebracht hatte, verlief das Geschäftsjahr 2007 ruhiger. Die SÜSS MicroTec-Gruppe erwirtschaftete einen Umsatz von 145,6 Mio. € und ein EBIT von 6,0 Mio. €. Diese Zahlen lagen unter den ursprünglich kommunizierten Erwartungen, die einen Umsatz und ein EBIT in etwa auf dem Niveau des Jahres 2006 in Aussicht gestellt hatten. SÜSS konnte jedoch unter Beweis stellen, dass es auch in einem schwierigen Markt in der Lage ist, deutlich profitabel zu bleiben.

SÜSS hatte einen leichten Umsatzrückgang im Segment Lithografie antizipiert, jedoch erwartet, diesen mit einem entsprechenden Umsatzanstieg im Geschäft mit Substrat Bondern ausgleichen zu können. Dieser Umsatzanstieg fiel jedoch schwächer als erwartet aus, da einige Tools nicht rechtzeitig ausgeliefert werden konnten, um noch in 2007 umsatzwirksam zu werden. Zudem trugen die ungünstigen Wechselkursentwicklungen des US-Dollars und des japanischen Yen erheblich zu dem Umsatzrückgang im Konzern bei.

Vor diesem Hintergrund kann der erzielte Umsatz von 145,6 Mio. € als zufriedenstellend bezeichnet werden. Dies gilt nicht für das erzielte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 6,0 Mio. €. Die Zurückhaltung wichtiger Kunden erzeugte Margendruck und führte zu einem Rückgang der Rohertragsmarge von 44,8 % (2006) auf 41,8 % (2007). Grund hierfür ist zum einen die schwächere Branchenkonjunktur in 2007: Die geringere Investitionstätigkeit der Kunden versetzte diese eher in die Lage, Preisnachlässe durchzusetzen, während in 2006 die Zusage einer schnellen Auslieferung der Maschinen für den Vertragsabschluss entscheidend war. Zum anderen belasteten zusätzliche Kosten für die an IBM noch auszuliefernden C4NP-Produktionsanlagen sowie die ungünstigen Wechselkursentwicklungen des US-Dollars und des japanischen Yen die Rohertragsmarge.

Der Auftragseingang belief sich auf 149,7 Mio. € nach 153,8 Mio. € im Geschäftsjahr 2006, wobei hier insbesondere der außerordentlich hohe Auftragseingang im vierten Quartal – der zweithöchste der Firmengeschichte – mit 54,2 Mio. € zu Buche schlug. Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag somit 2007 bei 1,03 nach 0,99 (2006).

Der Auftragsbestand zum 31. Dezember 2007 betrug 77,5 Mio. € (Vorjahr: 78,5 Mio. €) und ermöglichte SÜSS einen guten Start in das erste Halbjahr 2008.



### Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter, MEMS und Test Systeme. In 2006 wuchs zum Beispiel das Geschäft mit Advanced-Packaging-Kunden in Asien außerhalb Japans überproportional; 2007 hielten sich diese Kunden dann mit Neuinvestitionen in Produktionsanlagen erwartungsgemäß etwas zurück.

### Auftragseingänge in den Regionen

Der Blick auf die Entwicklung des Auftragseingangs in den Regionen im Vergleich zu 2006 macht den Verlust an Wettbewerbsfähigkeit im US-Dollar-Raum auf Grund der Wechselkursentwicklung deutlich:

In **Europa** konnte der Auftragseingang um 16,3 % auf nunmehr 53,6 Mio. € gesteigert werden, nach 46,1 Mio. € in 2006. Zu dieser positiven Entwicklung trugen vor allem höhere Ordereingänge bei Coatern und Mask Alignern bei. Am stärksten rückläufig war der Auftragseingang bei den Device Bondern (-82,5 %), bedingt durch den Verkauf des Geschäfts im Juli 2007.

**Nordamerika** verzeichnete mit -15,1 % oder -7,2 Mio. € auf nunmehr 40,4 Mio. € den stärksten regionalen Rückgang. Während die Mask Aligner (+26,3 %) und die Substrat Bonder (+62,7 %) zulegen konnten, erhielt SÜSS bei Coatern (-57,7 %), Device Bondern (-35,7 %) und Fotomasken (-28,6 %) weniger Aufträge als 2006. Der Rückgang bei den Masken erklärt sich primär mit der schwierigen Situation bei einem wichtigen Kunden sowie der Wechselkursentwicklung insgesamt, wohingegen das Minus bei den Coatern fast ausschließlich mit der Wechselkursentwicklung zusammenhängt: Unsere Coater werden in Vaihingen an der Enz hergestellt, also im Euro-Raum – viele unserer Konkurrenten produzieren im Dollarraum.

**Japan** erhielt 2007 – bedingt durch die Yen-Schwäche – 6,9 % weniger Aufträge als 2006, in absoluten Zahlen: 17,5 nach 18,8 Mio. €. Am augenfälligsten war der Rückgang bei den Coatern (-75,0 %), wo viele Bestellungen bereits im vierten Quartal 2006 vorweggenommen worden waren. Einen Order-Zuwachs gab es dagegen bei den Mask Alignern (+21,3 % oder +1,3 Mio. € auf nunmehr 7,4 Mio. €) und bei den Test Systemen (+43,3 % oder +1,3 Mio. € auf 4,3 Mio. €), wozu unter anderem die Verstärkung des Vertriebs beigetragen haben dürfte.

In **Asien** (ex Japan) gab es 2007 mit 38,2 Mio. € 7,3 % weniger Aufträge als 2006 (41,2 Mio. €). Nach dem Boomjahr 2006 war die Zurückhaltung bei Neubestellungen insbesondere bei den Mask Alignern (-18,6 %) teilweise erwartet worden. Gegensteuern konnte das Segment Test Systeme mit einem Plus von 2,0 Mio. € oder 62,5 %.

### Umsätze in den Regionen

Wie oben beschrieben, ging der Umsatz 2007 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % oder 9,9 Mio. € auf nunmehr 145,6 Mio. € zurück. Während Europa und auch Japan – trotz der Yen-Schwäche – zulegen konnten, verzeichneten Nordamerika und Asien, wo Geschäfte überwiegend in US-Dollar abgerechnet werden, einen Rückgang der Umsatzerlöse.

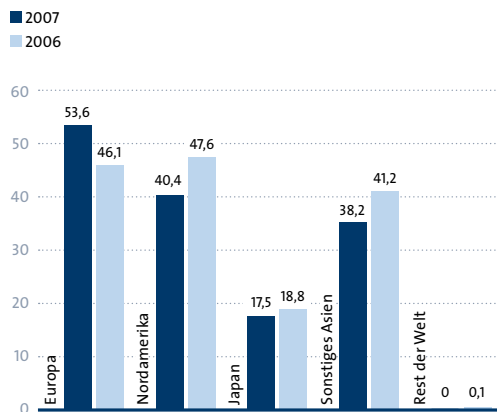
In **Europa** verbuchte SÜSS gegen den Branchentrend 11,6 % oder 5,0 Mio. € mehr Umsatz als 2006. Dafür maßgeblich ist vor allem das Plus bei Mask Alignern (+43,3 %), im Bereich Test Systeme (+21,5 %) und bei Cluster-Aufträgen aus dem LED- und Speicherchip-Markt. Den stärksten prozentualen Umsatzrückgang in Europa verzeichneten die Substrat Bonder (-60,6 %): Nach 3,3 Mio. € wurden 2007 nur 1,3 Mio. € Erlöst, allerdings hatte es hier 2006 mit 1,3 Mio. € einen außergewöhnlich hohen Einzelauftrag gegeben.

In **Nordamerika** fiel der Umsatz gegenüber 2006 um 13,6 % auf 41,2 Mio. €. Der Umsatzanstieg bei den Substrat Bondern (34,6 %) konnte den Rückgang bei Mask Alignern (-12,3 %), Test Systemen (-46,8 %) und Fotomasken (-28,6 %) nicht ausgleichen. Das Minus in diesen Segmenten hat dieselben Ursachen, die bereits beim Auftragseingang für negative Vorzeichen verantwortlich waren: die Wechselkursentwicklungen und Probleme bei einem wichtigen Kunden.

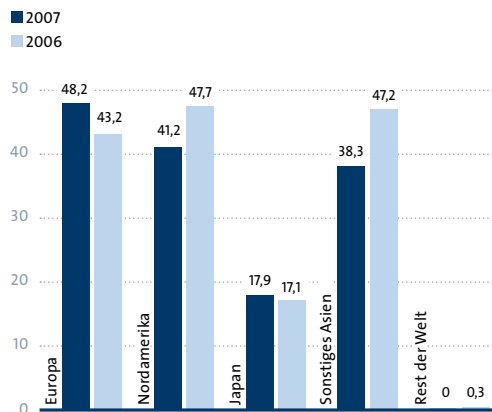
In **Japan** konnte der Umsatz um 4,7 % oder 0,8 Mio. € auf 17,9 Mio. € gesteigert werden, wohingegen Asien (ex Japan) mit 18,9 % den stärksten Rückgang verzeichnete. Auffällig dabei ist, dass die Mask Aligner um 91,3 % auf 19,9 Mio. € zulegen konnten, wohingegen die Umsätze mit Coatern um 77,5 % schrumpften. Sie gingen in absoluten Zahlen von 24,9 auf 5,6 Mio. € zurück. Dies ist wohl die signifikanteste Änderung beim Blick auf die Umsatz- und Auftrags-eingangszahlen überhaupt. Vor allem im ersten Halbjahr konnten nach dem Boomjahr 2006 so gut wie keine Umsätze mit Coatern in Asien realisiert werden. Im zweiten Halbjahr und hier insbesondere im vierten Quartal gab es wieder vermehrt neue Aufträge, die jedoch in 2007 nicht mehr umsatzwirksam wurden.



Entwicklung der Auftragseingänge nach Regionen  
in Mio. €



Entwicklung der Umsätze nach Regionen  
in Mio. €



## Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten

### Lithografie

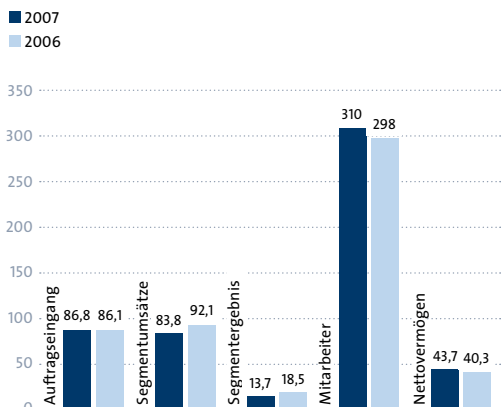
Das Segment Lithografie beinhaltet die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsstandorte dieser zwei Linien sind in Deutschland in Garching bei München und in Vaihingen an der Enz angesiedelt. Darüber hinaus sind wichtige Teile der Vertriebsorganisation in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt mit einem Umsatzanteil von knapp 60 % am Gesamtgeschäft das Kernsegment der SÜSS MicroTec-Gruppe dar. Zu den adressierten Märkten der Produktlinien zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie das Advanced Packaging.

Trotz des insgesamt schwächeren Geschäftsverlaufs konnte die Lithografie in 2007 erneut ein – wenn auch nur geringes – Wachstum beim Auftragseingang verzeichnen. Nach einem verhaltenen ersten Halbjahr 2007 trugen insbesondere die Mask Aligner zu dem Wachstum im dritten und vor allem vierten Quartal des Geschäftsjahres bei. Der Segmentumsatz in Höhe von 83,8 Mio. € im Geschäftsjahr 2007 reichte jedoch nicht an den Vorjahreswert von 92,1 Mio. € heran (-9,0 %). Maßgeblichen Anteil daran hatten die Coater, deren Absatz nach einem sehr starken Jahr 2006 nun vor allem durch die ungünstige Wechselkursentwicklung belastet wurde. Die geringeren Segmentumsätze sowie der schwache US-Dollar schlugen sich auch im Segmentergebnis nieder, welches sich infolge dessen von 18,5 Mio. € im Vorjahr um 4,8 Mio. € (-25,9 %) auf 13,7 Mio. € verschlechterte. Die Rohertragsmarge stieg von vormals 45,9 % auf 46,9 %. Der Anstieg des Segmentvermögens (netto) von 40,3 Mio. € auf 43,7 Mio. € ist primär auf die deutlich verringerten Kundenanzahlungen zurückzuführen. Der durchschnittliche Mitarbeiterbestand erhöhte sich im Geschäftsjahr 2007 von 298 um 12 Personen auf nunmehr 310.



### Segmentübersicht Lithografie

in Mio. € bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



### Substrat Bonder

Die SÜSS-Substrat Bonder werden am Standort Waterbury im US-Bundesstaat Vermont entwickelt und produziert. Der Vertrieb der Substrat Bonder ist über Waterbury hinaus in kleineren Einheiten an Standorten in Europa sowie in Asien ansässig. Das wachstumsstärkste Segment der SÜSS-Gruppe konnte seinen Auftragseingang in 2007 von vormals 16,6 Mio. € um 19,3 % auf 19,8 Mio. € steigern. Der Segmentumsatz stieg im Geschäftsjahr 2007 um 2,2 Mio. € (+15,6 %) auf 16,3 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

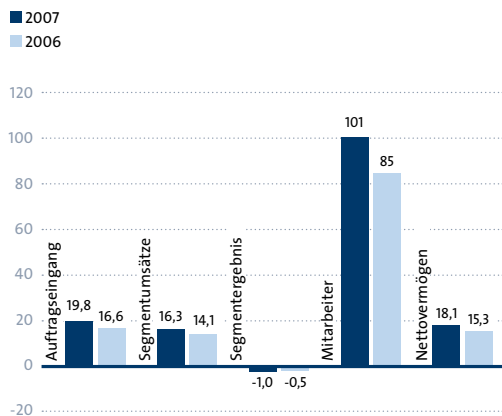
Auf Grund der geplanten weiteren Produkteinführungen ist die Intensität der Forschung und Entwicklung weiterhin sehr hoch. Das Segmentergebnis verschlechterte sich vor diesem Hintergrund im Vergleich zum Vorjahr von -0,5 Mio. € auf -1,0 Mio. €. Die Rohertragsmarge verschlechterte sich im Geschäftsjahr 2007 von vormals 38,2 % auf 31,3 %. Der Anstieg der durchschnittlichen Mitarbeiterzahl von 85 auf nunmehr 101 trägt dem Umsatzwachstum Rechnung. Das Netto-Segmentvermögen stieg infolge aktivierter Entwicklungsleistungen von vormals 15,3 Mio. € auf 18,1 Mio. € im Geschäftsjahr 2007 an.

### Device Bonder

Das Segment Device Bonder mit seinem Sitz in St. Jeoire, Frankreich, wurde am 16. Juli 2007 im Rahmen eines MBO („Management-Buy-Out“) an das frühere Management der Gesellschaft veräußert. Am französischen Standort befanden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Auf Grund der geringen Größe des Marktes sowie der technischen Komplexität waren keine weiteren Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

### Segmentübersicht Substrat Bonder

in Mio. € bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



Der Auftragseingang im Segment Device Bonder fiel im Geschäftsjahr 2007 mit 3,5 Mio. € rund 62 % schlechter aus als im Vorjahr (9,2 Mio. €). Maßgeblich hierfür ist die Veräußerung des Segments, da Auftragseingänge dadurch nur bis einschließlich 16. Juli 2007 bei SÜSS verbucht worden sind. Die Segmentumsätze, die infolge des Verkaufs nur aus den bis zum Stichtag 16. Juli 2007 erhaltenen Kundenaufträgen realisiert wurden, gingen um 9,9 % von 7,1 Mio. € auf 6,4 Mio. € zurück. Das nicht fortgeführte Segment des SÜSS-Konzerns erzielte, wie bereits im Vorjahr, ein positives Ergebnis in Höhe von 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €). Die Mitarbeiterzahl verringerte sich im Betrachtungszeitraum um 18 Personen von 43 Mitarbeitern auf 25.

#### Test Systeme

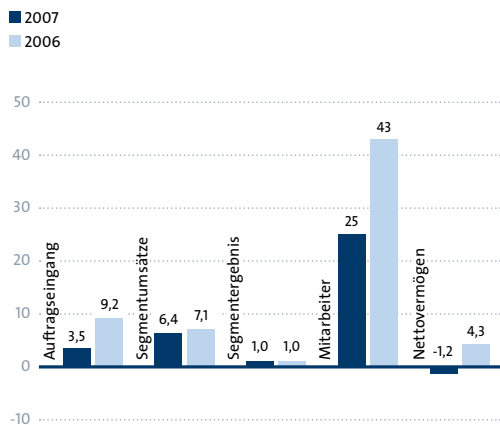
Das Segment Test Systeme umfasst die Entwicklung, die Produktion sowie den europaweiten Vertrieb und ist in Sacka bei Dresden angesiedelt. Mit einem Umsatzbeitrag von rund einem Fünftel des Geschäftsvolumens der SÜSS-Gruppe stellen die Test Systeme das zweitgrößte Segment des Konzerns dar. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten daher nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment.

Der Auftragseingang stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 von 26,9 Mio. € um 11,2 % auf 29,9 Mio. €. Wesentliche Impulse hierfür kamen insbesondere aus dem Bereich Opto- und MEMS-Applikationen, wo die SÜSS-Produkte „Blue Ray“ sowie „Croy/Vacuum“ nachgefragt worden sind sowie von dem 300-mm-„Probe Shield Device Charakterization“-System, welches anlässlich der Fachmesse SEMICON West (San Francisco, USA) in den Markt eingeführt wurde und das hochpräzise Messen neuartiger Schaltkreise auf kleinsten Strukturen ermöglicht und parallel eine optimale Unterstützung für den Operator bietet.



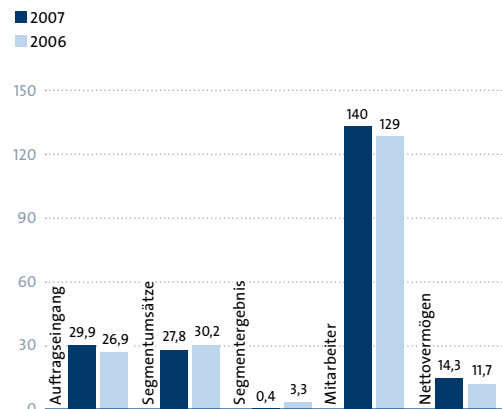
#### Segmentübersicht Device Bonder

in Mio. € bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



#### Segmentübersicht Test Systeme

in Mio. € bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt





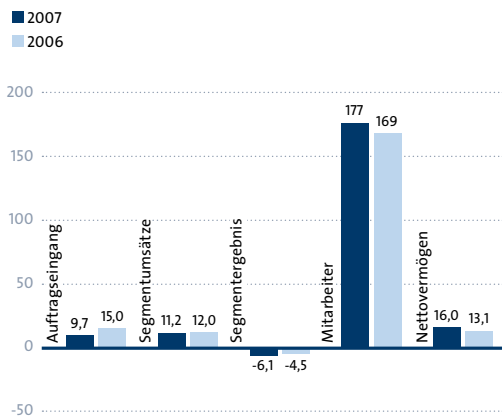
Bei den Umsätzen konnte kein Zuwachs erzielt werden. Dieser erreichte nach 30,2 Mio. € im Vorjahr lediglich 27,8 Mio. €. Belastend waren hier die ungünstige Wechselkursentwicklung sowie der damit einhergehende Druck durch im Dollar-Raum produzierende Wettbewerber. Das Segmentergebnis fiel mit 0,4 Mio. € deutlich schlechter als im Vorjahr aus (3,3 Mio. €). Begründen lässt sich dies mit einer schwächeren Rohertragsmarge infolge des anhaltenden Margendrucks sowie erhöhten Aufwendungen im Vertrieb in Asien und höheren Kosten für Produktentwicklungen im ersten Halbjahr. Erwähnenswert ist hierbei insbesondere die Eröffnung eines Applikations- und Messtechnik-Zentrums in Singapur. Die Mitarbeiteranzahl stieg im Segment Test Systeme um 11 Mitarbeiter auf 140 Personen (Vorjahr: 129). Die Erhöhung des Netto-Segmentvermögens auf 14,3 Mio. € nach 11,7 Mio. € im Geschäftsjahr 2006 ist im Wesentlichen auf verringerte Kundenanzahlungen zurückzuführen.

### Segment Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie (Palo Alto, Kalifornien, USA) die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel (Schweiz) sowie das Geschäftsfeld C4NP. Ebenfalls im Segment Sonstige enthalten sind die nicht auf die Segmentebene zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Das negative Segmentergebnis resultiert daher zu einem Großteil aus den Aufwendungen der Konzernholding. Der Bereich Mikrooptik konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2007 den Umsatz um 6,1 % auf 3,5 Mio. € erhöhen. Das Geschäftsfeld C4NP verzeichnete in 2007 erstmalig Umsätze in Höhe von 1,3 Mio. €. Im Maskengeschäft verringerte sich hingegen der Umsatzbeitrag von 8,7 Mio. € im Vorjahr auf 6,3 Mio. €. Der Anstieg beim Netto-Segmentvermögen ist vor allem auf aktivierte Entwicklungsleistungen für C4NP in Höhe von 2,1 Mio. € zurückzuführen.

### Segmentübersicht Sonstige

in Mio. € bzw. Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt



## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### Ertragslage

2007 waren EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) und das Jahresergebnis (EAT) abermals deutlich positiv, wenn auch die Ergebnisse hinter dem hervorragenden Jahr 2006 zurückblieben. Gleichwohl unterstreichen die Ergebnisse die Nachhaltigkeit des 2006 erzielten Turnaround. Ursächlich für den Ergebnismrückgang war die verhaltene Nachfrage insbesondere zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres und des damit verbundenen Umsatzrückgangs. Damit einhergehend reduzierte sich der Rohertrag deutlich um 8,7 Mio. € von 69,6 Mio. € auf nun 60,9 Mio. €.

Neben der geringeren Auslastung waren folgende Faktoren für den Rückgang verantwortlich:

- + Verschlechterter Rohertrag auf Grund der Entwicklung der Wechselkurse von US-Dollar und japanischen Yen, insbesondere im zweiten Halbjahr
- + Zusätzliche Kosten für die an IBM noch auszuliefernden C4NP-Produktionsanlagen

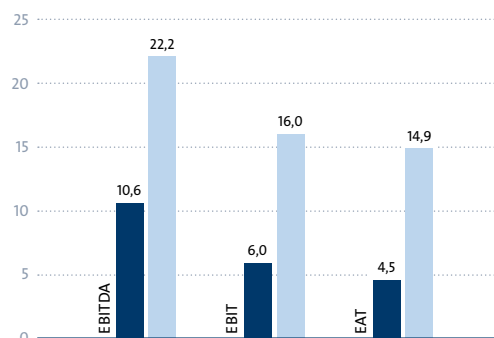
Der **Lagerbestand** reduzierte sich von 58,0 Mio. € zum Jahresende 2006 um 7,2 % auf 53,8 Mio. € zum Jahresende 2007. Ohne den Verkauf des Segments Device Bonder ergab sich ein leichter Anstieg um 0,5 Mio. €. Dabei stand im Wesentlichen einem reduzierten Lagerbestand des Segments Test Systeme ein Anstieg in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder gegenüber. Insgesamt ist die Lagerentwicklung nach wie vor nicht zufriedenstellend. Im Jahr 2008 werden die Anstrengungen verstärkt, um den Lagerbestand zu reduzieren. Von besonderer Bedeutung ist dabei die 2008 und 2009 stattfindende konzernweite Einführung des ERP-Systems SAP, das erstmalig eine durchgehende, gesellschaftsübergreifende Steuerung der Lagerbestände ermöglichen wird.



Entwicklung wesentlicher Ergebniskennzahlen

in Mio. €

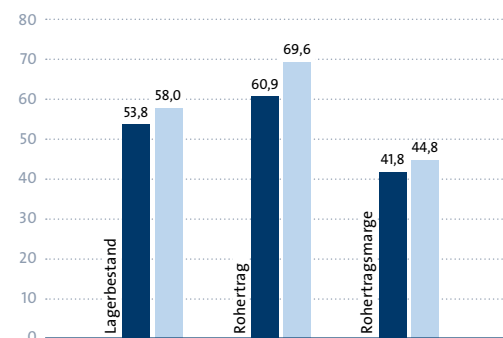
■ 2007  
■ 2006



Entwicklung des Lagerbestands und des Rohertrags

in Mio. €

■ 2007  
■ 2006



Die **Kosten für Verwaltung und Vertrieb** stiegen im Jahresvergleich um 1,7 Mio. € von 45,1 Mio. € auf 46,8 Mio. €. Dies bedeutete einen Anstieg von 3,8 %. Dabei blieben die Kosten im Bereich Verwaltung mit 20,6 Mio. € nahezu unverändert, wohingegen sich die Kosten für den Bereich Vertrieb um 1,8 Mio. € auf 26,1 Mio. € erhöhten.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträgen** sind Buchverluste auf konzerninterne Fremdwährungskredite in Höhe von 2,0 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) enthalten, die durch die Abschwächung des US-Dollars und des japanischen Yen im Jahr 2007 entstanden sind.

Beim **Steueraufwand** wirkte sich die Nutzung von wertberichtigten Verlustvorträgen positiv auf die Steuerquote aus. Hinzu kam eine Wertaufholung auf vormals durchgeführte Wertberichtigungen auf aktive latente Steueransprüche. Demgegenüber stand eine aus dem Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 resultierende Neubewertung der entsprechenden Steuerpositionen. Auf Grund des Überhangs der aktiven latenten Steuern in Deutschland ergab sich daraus für den SÜSS MicroTec-Konzern ein zusätzlicher, nicht zahlungswirksamer Einmaleffekt von 1,3 Mio. €.

Letztendlich ergab sich im **Konzern ein Jahresergebnis** in Höhe von 4,5 Mio. € (Vorjahr: 14,9 Mio. €). Das **Ergebnis je Aktie** (unverwässert) betrug 0,26 € nach 0,88 € im Vorjahr.

Der Nettoumsatz pro Mitarbeiter reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 % von 205 T€ auf 199 T€.

## Finanz- und Vermögenslage

Unser Ziel, stets eine ausreichende kurzfristige Liquiditätsreserve für das operative Geschäft zu halten, wurde auch im Jahr 2007 deutlich erreicht. Neben dem Bestand an Barmitteln von 20,1 Mio. € (Vorjahr: 20,5 Mio. €) verfügt der Konzern über Kreditlinien in Höhe von insgesamt 16,2 Mio. €, die größtenteils an so genannte „Financial Covenants“ gebunden sind. Die Inlandskreditlinie im Rahmen eines Bankenkonsortiums beträgt 12 Mio. € und ist banküblich besichert.

Die Liquiditätsentwicklung in 2007 war durch einen gegenüber dem Vorjahr deutlich reduzierten Zufluss aus dem operativen Geschäft geprägt. Der operative Cashflow reduzierte sich von 14,4 Mio. € auf 1,5 Mio. €. Auf Grund der gegenüber dem Vorjahr von 7,3 Mio. € auf 9,2 Mio. € erhöhten Investitionen ergab sich ein negativer Free Cashflow von 7,7 Mio. € (Vorjahr: +7,2 Mio. €). Demgegenüber stand ein positiver Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 7,8 Mio. €. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Aufnahme eines Schuldscheindarlehens im Nennwert von 9,0 Mio. €. Die Bankguthaben konnten dadurch fast auf Vorjahresniveau gehalten werden.

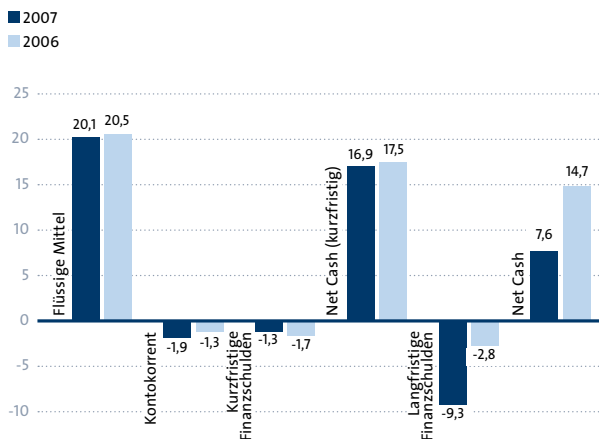
Die Net Cash Position – der Saldo aus Geldmitteln und Finanzschulden – hat sich im Jahresverlauf deutlich verschlechtert. Der zum Jahresende 2006 vorhandene positive Saldo von 14,7 Mio. € reduzierte sich in 2007 auf 7,6 Mio. €. Der Konzern verfügt damit aber nach wie vor über ausreichenden finanziellen Spielraum, um große Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Goodwill bestimmen im Wesentlichen die selbst erstellten, aktivierten Forschungs- und Entwicklungskosten die langfristigen Vermögenswerte. Der Goodwill ist den Segmenten Lithografie (13,6 Mio. €, Vorjahr: 13,6 Mio. €), Test Systeme (4,1 Mio. €, Vorjahr: 4,3 Mio. €) und dem Maskengeschäft im Segment Sonstige (4,3 Mio. €, Vorjahr: 4,8 Mio. €) zugeordnet. Die Position „Entwicklungskosten“ erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 11,7 Mio. € auf 16,2 Mio. €. Hiervon repräsentiert derzeit das Projekt „C4NP“ mit 7,8 Mio. € (Vorjahr: 5,7 Mio. €) an aktivierten Entwicklungskosten den größten Einzelposten. Weiterhin sind jeweils aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,9 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) für das Segment Lithografie, 5,1 Mio. € (Vorjahr: 2,9 Mio. €) für das Segment Substrat Bonder und 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) für das Segment Test Systeme enthalten. Darüber hinaus sind Restbuchwerte von 2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) für erworbene Lizenzen und Patente der Segmente Lithografie und Substrat Bonder enthalten sowie 1,3 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €) im Segment Sonstige. Der Anstieg von letzterem ist in der im 4. Quartal begonnenen gruppenweiten Einführung des ERP-Systems SAP begründet.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Das Sachanlagevermögen veränderte sich nur unwesentlich und stieg von 4,9 Mio. € im Vorjahr auf 5,0 Mio. € an. Die latenten Steueransprüche erhöhten sich im Geschäftsjahr um 1,3 Mio. € und belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 10,5 Mio. €.



### Entwicklung der Bankguthaben und Finanzschulden in Mio. €



Zusammenfassend ergaben sich, abgesehen von dem Anstieg der immateriellen Vermögensgegenstände, bei den langfristigen Vermögenswerten keine wesentlichen Veränderungen.

Beim Working Capital reduzierte sich der Lagerbestand von 58,0 Mio. € auf 53,8 Mio. €. In dem Rückgang enthalten sind 4,6 Mio. € aus dem Verkauf des Segments Device Bonder. Die Kundenanzahlungen reduzierten sich um 6,7 Mio. € von 21,0 Mio. € auf 14,3 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote verringerte sich im Jahresvergleich leicht von 63,0 % auf 62,9 %.

#### Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Zusammenfassend konnte SÜSS im Geschäftsjahr 2007 unter Beweis stellen, dass es auch in einem schwierigen Marktumfeld in der Lage ist, deutlich profitabel zu bleiben. Infolge der operativen Ergebnisperformance und der Aufnahme des Schuldscheindarlehens in Höhe von 9,0 Mio. € ist die Gesellschaft in der Lage, eine auf Wachstum konzentrierte Unternehmensstrategie zu verfolgen.

## Investitionen

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 2 bis 3 % des Umsatzes bewegen werden. Ausnahmen stellen nur die in dem Segment Sonstige enthaltenen Produktlinien „Fotomasken“ und „Mikrooptik“ dar. In beiden Fällen wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesen Bereichen führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Der größere Anteil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht. Dominierendes Projekt war auch in 2007 die Weiterentwicklung einer kommerziellen C4NP-Linie, die aus mehreren Maschinen besteht, sowie die Erweiterung der Produktpalette im Segment Substrat Bonder. Wir gehen langfristig davon aus, dass rund 25 % bis 35 % der Ausgaben für Forschung und Entwicklung aktiviert werden und der verbleibende Betrag aufwandswirksam erfasst wird.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit der gruppenweiten Einführung des ERP-Systems SAP begonnen. Im Rahmen des Projekts werden 2008 und 2009 Investitionen in Software und Hardware von rund 6 Mio. € vorgenommen werden.

## Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften. Wie im Falle C4NP geschehen, übernimmt die Holding auch Prinzipalfunktion, soweit dies aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen sinnvoll erscheint.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleiniger Anteilseigner an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften oder durch Lizenzeinnahmen aus Patenten und Rechten.

### Darstellung der finanziellen Kennzahlen der Holding:

Gesellschaft in T€	SMT AG (dt. Handelsrecht)			
	2007	2006	Änderung	in %
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.837	-1.922	-915	48 %
Eigenkapital	96.177	98.364	-2.187	-2 %
Bilanzsumme	112.141	108.565	3.576	3 %
EK-Quote in %	86 %	91 %		
Anlagevermögen	84.406	70.021	14.385	21 %
in % der Bilanzsumme	75 %	64 %		
Umlaufvermögen	27.735	38.544	-10.809	-28 %
in % der Bilanzsumme	25 %	36 %		



### Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultierte im Wesentlichen aus der Umschuldung eines kurzfristigen Darlehens an die Süss MicroTec Inc. in eine unbefristete Ausleiherung in Höhe von 21,0 Mio. €. Gegenläufig wirken sich die planmäßigen Tilgungen in Höhe von 7,8 Mio. € aus.

Die kurzfristigen Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen gingen um 9,5 Mio. € zurück. Der Rückgang der kurzfristigen Forderungen ist hauptsächlich auf die Umschuldung eines kurzfristigen Darlehens der Süss MicroTec Inc. auf ein unbefristetes Darlehen in Verbindung mit dem Aufbau von kurzfristigen Forderungen durch die Tochtergesellschaften in Waterbury, USA, und Japan zurückzuführen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten nahmen im Geschäftsjahr um 1,5 Mio. € ab, was vor allem auf die Finanzierung des C4NP-Entwicklungsprojekts zurückzuführen ist.

Die Finanzschulden sind im Verlauf des Jahres 2007 gestiegen, was vor allem durch die Platzierung eines Schuldscheindarlehen im Nennwert von 9,0 Mio. € bedingt ist. Das Schuldscheindarlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist am Ende der Laufzeit fällig. Durch dieses Darlehen ist die Gesellschaft in der Lage, flexibler auf zyklische Schwankungen in der Halbleiterbranche zu reagieren.

Die Veränderung des Eigenkapitals (-2,2 Mio. €) resultiert aus dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres (2,8 Mio. €), dem Zuführungen zum gezeichneten Kapital und zur Kapitalrücklage (gesamt 0,6 Mio. €) auf Grund ausgeübter bzw. bestehender Aktienoptionen gegenüberstehen.

### Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2007 ein Jahresfehlbetrag von 2,8 Mio. € (Vorjahr: -1,9 Mio. €).

Auf Grund des vorhandenen Gewinnabführungsvertrags mit der Süss MicroTec Test Systems GmbH, Sacka, wurde bei der Holding ein Verlust in Höhe von 0,04 Mio. € (im Vorjahr wurde ein Gewinn in Höhe von 0,7 Mio. € ergebniswirksam vereinnahmt) ergebniswirksam verbucht.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,4 Mio. € enthalten (Vorjahr: 1,6 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Weiterbelastung von Entwicklungsleistungen in Höhe von 2,2 Mio. € (Vorjahr: 2,5 Mio. €) im Rahmen des C4NP-Projekts sowie Fremdwährungsverluste in Höhe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €). Die Kosten aus selbst erbrachten Entwicklungsleistungen werden gemäß den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften nicht aktiviert.

Die Zinsaufwendungen gingen im Geschäftsjahr um 0,1 Mio. € zurück, weil das Schuldscheindarlehen erst Mitte Dezember platziert wurde.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2007 durchschnittlich 17 (Vorjahr: 17 Beschäftigte inkl. Vorstand) Mitarbeiter tätig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften sowie des C4NP-Projekts ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem soll die SÜSS MicroTec AG künftig am Erfolg des C4NP-Projekts partizipieren, das im Auftrag der Holding von mehreren Tochtergesellschaften entwickelt wird.

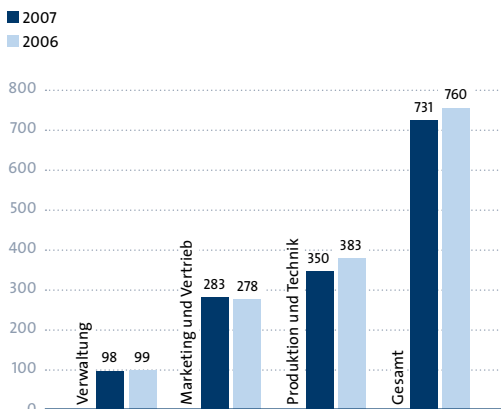
### Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind auf Grund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2007 waren 731 (Vorjahr: 760; -3,8 %) Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen des Konzerns beschäftigt.



Entwicklung der Mitarbeiterzahlen nach Bereichen



## Angaben gemäß § 315 Abs. 4 HGB

Das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG in Höhe von 17.019.126 € ist aufgeteilt in 17.019.126 nennwertlose, stimmberechtigte Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % der Stimmrechte überschreiten, gibt es zum Bilanzstichtag nicht. Am 22. Februar 2008 hat uns Herr Tito Tettamanti gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,34 % beträgt. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei von der Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, gehalten, die von Herrn Tettamanti kontrolliert wird.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16. Juni 2004 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 16. Juni 2009 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.022.358 € durch Ausgabe von bis zu 6.022.358 neuen Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlage zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die im Berichtsjahr geschlossenen Schuldscheinverträge beinhalten eine „Change-of-Control“-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen. Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.



## Risikobericht

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

### Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

#### Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Zahlreiche Faktoren, wie globale politische Konflikte einschließlich der Situation im Nahen und Mittleren Osten und in anderen Regionen, wirken sich weiterhin auf makroökonomische Faktoren sowie die internationalen Kapitalmärkte aus. Unsicherheiten hinsichtlich der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen können die Nachfrage nach unseren Produkten beeinträchtigen und unsere Budgetierung wie auch unsere Prognosen erschweren.

#### Energie- und Rohstoffpreise

Unser Unternehmen ist ferner Schwankungen bei den Energie- und Rohstoffpreisen ausgesetzt. Im Speziellen sind gerade in jüngster Zeit die Preise für Öl, Stahl und Kupfer weltweit gestiegen. Diese Preissteigerungen können negative Auswirkungen auf unsere Ertragslage haben, sofern es uns nicht möglich ist, die dadurch gestiegenen Kosten an die Kunden weiterzugeben oder anderweitig zu kompensieren.

#### Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

#### Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

#### Abhängigkeit von einzelnen „Know-how“-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

## Betriebliche Risiken

### Vermögens- und Ertragslage

Infolge negativer Marktentwicklungen könnten in der Konzernbilanz Wertminderungen im Rahmen künftiger Impairment-Tests notwendig werden. Dies betrifft sämtliche Segmente des Konzerns, unter anderem auch das im Segment Sonstige enthaltene C<sub>4</sub>NP-Projekt. Diese Wertminderungen hätten Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage des Konzerns, würden aber nicht liquiditätswirksam werden.

### Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

### Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Auf Grund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität, kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

## Finanzmarktrisiken

### Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sog. „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswerts, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall europäischer oder US-amerikanischer Kunden, die eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.



Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 26,1 Mio. € (Vorjahr: 24,4 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 15,4 Mio. € (Vorjahr: 13,9 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2007 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

**Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung**

in T€	2007	2006
1 – 30 Tage	5.103	5.094
31 – 60 Tage	2.501	1.673
61 – 90 Tage	1.660	1.665
<b>Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung</b>	<b>9.264</b>	<b>8.432</b>

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 1,5 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

**Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung**

in T€	2007	2006
91 – 180 Tage	616	1.138
181 – 360 Tage	784	798
> 360 Tage	60	113
<b>Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung</b>	<b>1.460</b>	<b>2.049</b>

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

**Liquiditätsrisiken**

Eine negative Entwicklung der Kapitalmärkte würde unsere Finanzierungskosten erhöhen und unsere finanzielle Flexibilität einschränken. Die aktuelle Entwicklung auf dem Hypothekenmarkt in den USA hat eine weltweite Wirkung auf die Kapitalmärkte. Solche Entwicklungen können unsere Fremdfinanzierungsmöglichkeiten einschränken. Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cash-flows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (25) des Konzernanhangs.

### Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf Grund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Vor allem der Wechselkurs des US-Dollars hat wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage des Konzerns. Daher soll die anteilige Wertschöpfung in den Vereinigten Staaten kontinuierlich erhöht werden, um eine den Umsatzanteilen adäquate Wertschöpfung in diesem Währungsraum zu erzeugen. Die Währungsicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen 3 bzw. 6 Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Darüber hinaus wird ein Sockelbetrag auf eine Laufzeit von 12 Monaten gesichert. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (31).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer 10 %igen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von T€ 11 (Vorjahr: T€ 288) und einer entsprechenden Verminderung des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

in T€	2007		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	388	167	555
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.864	277	2.141
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.431	-62	-1.493
Kundenanzahlungen	-1.082	0	-1.082
<b>Netto-Exposure</b>	<b>-261</b>	<b>382</b>	<b>121</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euros	24	-35	-11

in T€	2006		Summe
	USD	JPY	
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.045	761	1.806
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.727	363	2.090
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-214	-75	-289
Kundenanzahlungen	-137	0	-137
<b>Netto-Exposure</b>	<b>2.421</b>	<b>1.049</b>	<b>3.470</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euros	-220	-95	-315

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Geschäftsjahr platzierten variablen Teile des Schuldscheinanlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

### Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2007 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet. Die aktuelle Eigenkapitalausstattung lag weit über dem Risk Adjusted Capital, das den Eigenkapitalanteil darstellt, der zur Deckung potenzieller Verluste mindestens vorgehalten werden muss.

### Risikomanagement-System

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (KonTraG) ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.



## Prognosebericht

Nach einem rückläufigen Geschäftsjahr 2007 mit schrumpfendem Umsatz erwarten wir 2008 eine moderat positive Entwicklung gegen den Trend des allgemeinen Halbleitermarktes. SÜSS blickt zuversichtlich auf die Entwicklung der für die Gruppe interessanten Teilmärkte, die ein deutlich über dem Markt liegendes Wachstum erzeugen können. Risiken bergen vor allem makroökonomische Faktoren: Speziell ein konjunktureller Abschwung in den USA infolge der Immobilienkrise würde alle für SÜSS relevanten Teilmärkte beeinflussen, insbesondere den mit der Unterhaltungselektronik assoziierten Sektor der Chipindustrie. Positive Impulse für die Konjunktur und damit auch den Halbleiter- und Halbleiter-Equipment-Markt in ganz Asien könnten indes von den Olympischen Spielen in Peking ausgehen. In den USA sind es die Präsidentschaftswahlen im Herbst, die eine konjunkturelle Erholung und ein Erstarren der US-Währung einläuten könnten. Zumindest historisch betrachtet war dies häufig zu beobachten.

Die Geschäftsentwicklung von SÜSS MicroTec wird 2008 und darüber hinaus von exogenen und endogenen Faktoren beeinflusst. In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf diese Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für den Erfolg unseres Unternehmens ansehen.

### Halbleiterindustrie

Für die Chipindustrie wird nach einem guten Jahr 2007, das ein Wachstum von 4 % auf hohem Niveau zeigte, ein noch besseres Jahr 2008 erwartet, für das die Wachstumsprognosen von fünf führenden Marktforschungsinstituten zur Jahreswende 2007/2008 zu einem Mittelwert von 8 % führten. Hier spielt die Unterhaltungselektronik eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel die flächendeckende Einführung des digitalen Fernsehens in den USA. Allerdings stand hinter einem starken Mengenwachstum bei den Speicherbausteinen ein rapider Preisverfall für diese Art von Komponenten.

### Halbleiter-Equipment-Industrie

Die positive Grundstimmung der Chipindustrie wird sich nach Meinung der führenden Marktforschungsinstitute nicht auf die Investitionsbereitschaft bei Equipment in 2008 übertragen. Der Umsatz mit Halbleiter-Equipment ist in 2007 mit voraussichtlich mehr als 8 % stärker gewachsen als der zu Grunde liegende Umsatz der Chipindustrie. Die hohen Investitionen erfolgten vor allem bei den Herstellern von Speicherbausteinen und werden in 2008 – bedingt durch den Preisverfall bei diesen Chips – zwangsläufig zu rückläufigen Aufträgen dieser Hersteller an die Maschinenindustrie führen. Die Prognosen der Marktforscher reichten zur Jahreswende 2007/2008 von -5,2 % (VLSI) bis -10,6 % (iSuppli) bei einem Mittelwert von -9,0 %. Bei der Bewertung dieser Zahlen ist aber zu berücksichtigen, dass sie Märkte reflektieren, die für große, „Frontend“-orientierte Hersteller wie Applied Materials oder ASML bestimmend sind.

SÜSS hingegen ist im klassischen „Frontend“ der Chiphersteller kaum aktiv und ist als innovativer, spezialisierter Equipmenthersteller hauptsächlich in den Teilmärkten MEMS, Advanced Packaging und Verbindungshalbleiter aktiv. Für diese Teilmärkte gibt es nur wenige Prognosen.

## Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

### Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS)

Yole Développement, eines der führenden Forschungsinstitute für den MEMS-Markt, prognostiziert eine durchschnittliche Wachstumsrate von 13 % pro Jahr mit einem erwarteten Umsatz von 10,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2011. Rund 40 % der Umsätze von SÜSS entfallen auf den MEMS-Markt, der zwar vergleichsweise klein ist, aber stetig und ohne die typischen Zyklen der Halbleiterindustrie wächst.

Als starker Treiber für die Mikrosystemtechnik erweist sich weiterhin der Automobilsektor, wo Sicherheitslösungen wie das ESP (Electronic Stability Program) Einzug in das Produktportfolio der Hersteller halten. Auch die Märkte für Tintenstrahl-druckerköpfe und Projektionssysteme tragen deutlich zum Wachstum des gesamten Segments bei, sind aber durch den hohen Sättigungsgrad sowie den Preisdruck in ihrem Wachstum limitiert.

Die stärksten Wachstumsraten verzeichnen heute die Märkte für Silizium-Mikrophone sowie RF-MEMS (radio frequency) – sowohl bei Sicherheitslösungen in der Automobilbranche und industriellen wie medizintechnischen Anwendungen als auch bei Consumer Products wie Navigationssystemen.

### Wachstumsraten der MEMS-Märkte:

in Mio. US-Dollar	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Tintendruckerköpfe	1.663	1.735	1.872	1.949	1.963	2.042	4 %
Drucksensoren	1.028	1.103	1.093	1.147	1.208	1.275	4 %
Silizium-Mikrophone	117	169	245	309	365	442	31 %
Beschleunigungsmesser	652	779	815	936	1.158	1.403	17 %
Gyroskope	616	713	795	853	881	918	8 %
MOEMS	466	563	615	741	835	949	15 %
MEMS-Mikrodisplays	886	939	986	1.081	1.226	1.336	9 %
Mikrofluide	397	415	595	716	796	856	17 %
RF-MEMS	127	159	230	370	603	829	45 %
Mikrobrennstoffzellen	0	0	1	26	65	104	153 %
Emerging MEMS	0	0	50	238	431	628	263 %
<b>Gesamt (in Mio. US-Dollar)</b>	<b>5.951</b>	<b>6.574</b>	<b>7.298</b>	<b>8.366</b>	<b>9.533</b>	<b>10.783</b>	<b>13 %</b>

Quelle: Yole Développement SARL, 2007



Deutlich erkennbar ist, dass der Bereich Consumer Products in den Jahren bis 2010 im Vergleich zu den MEMS-Märkten in der Medizintechnik, der Industrie und in der Automobilbranche überdurchschnittlich stark wachsen wird. Vor allem die Nachfrage der Konsumenten in der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik nach multiplen, integrierten Funktionen in Geräten sollte einen starken Impuls auslösen. Auf der Angebotsseite reagieren die Hersteller auf die stärkere Nachfrage mit neuen Produkten. So stellen zum Beispiel Drehratensensoren und mehrachsige Beschleunigungssensoren (so genannte Gyroskope) als Instrumente für die Stabilisierung von Kameramodulen eine weitere lukrative Funktionserweiterung bei tragbaren Elektronikgeräten wie Mobiltelefonen dar.

Für die neuen Applikationen wie Mikrobrennstoffzellen werden Wachstumsraten von weit mehr als 100 % jährlich und ein Marktanteil von 7 % bis zum Jahr 2011 prognostiziert. Der MEMS-Markt wird somit in den kommenden Jahren deutlich von Innovationen aus diesem Bereich beeinflusst werden.

SÜSS adressiert die Anforderungen des wachsenden MEMS-Marktes mit seinen spezialisierten Technologien im Bereich Wafer Bonding, Mask Alignment, Coating und Testing-Technologien, die entscheidend sind bei der Produktion von MEMS-Bauteilen, was die immens starke Stellung von SÜSS in diesem Bereich erklärt. Zudem gibt es auf Grund der Produktvielfalt zahlreiche Hersteller von MEMS, so dass eine breite Kundenbasis existiert und auch Umsätze mit Neukunden realisiert werden können, wenn ein Bestandskunde einmal nicht investiert, weil seine Kapazitäten ausreichen.

Allerdings wächst der Equipment-Markt weniger schnell als der MEMS-Markt selbst, da immer mehr MEMS-Bausteine mit immer weniger Maschinen produziert werden können. Der Markt für Produktions-Equipment zur MEMS-Herstellung weist den Researchern von Yole Développement SARL zufolge eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von 9,1 % in den Jahren von 2006 bis 2011 auf. Das Gesamtvolumen soll 2009 ca. 837 Mio. US-Dollar betragen, im Jahr 2011 dann rund 1 Mrd. US-Dollar. Das Wachstum kommt dabei aus so unterschiedlichen Bereichen wie dem Bonden, dem Testen und dem Packaging, also dem „Verpacken“ von MEMS.

Jeder dieser Teilmärkte wird von wenigen Unternehmen dominiert, wobei SÜSS Marktführer im Bereich Lithografie-Equipment ist und die Nummer zwei im Markt für Wafer-Bonder-Equipment. Rund 40 % aller Umsätze des SÜSS-Konzerns entfallen auf den MEMS-Markt.

### Advanced Packaging

Für das Advanced Packaging insgesamt prognostizieren die Forscher von Prismark für den Zeitraum von 2006 bis 2011 einen Anstieg der Zahl der gebumpten Wafer von 10 auf 24,5 Mio. Stück oder eine jährliche Wachstumsrate von gut 17 %. Während die Zahl der gebumpten 200-mm-Wafer jährlich also um rund 2,7 Mio. Stück zunehmen dürfte, kann jedoch nicht von einer proportionalen Erhöhung des Bedarfs an entsprechendem Equipment ausgegangen werden. Gartner Dataquest sagt für das Wafer Level Packaging Equipment im ersten Quartal 2008 einen Rückgang von -6,6 % voraus, gefolgt von einem Wachstum von +12,2 % in 2009. Für das Marktforschungsinstitut Yole wird das Wachstum im Advanced Packaging vor allem aus dem 3D-Packaging kommen. So sollte zum Beispiel im Bereich Flash-Memory eine Ausweitung der Produktion durch die größeren Kapazitäten der neuen Memory-Sticks erfolgen.

SÜSS sieht auf Grund seiner Kundenbeziehungen mit renommierten Flash-Memory-Herstellern interessante Absatzchancen auf diesem Markt in den nächsten Jahren. Auch CIS (Contact Image Sensor)-Module finden als Bildsensoren verstärkt Eingang in Hightech-Geräten der Kommunikations- und Unterhaltungselektronik und sind damit ein Wachstumstreiber im 3D-Bereich.

### Verbindungshalbleitermarkt

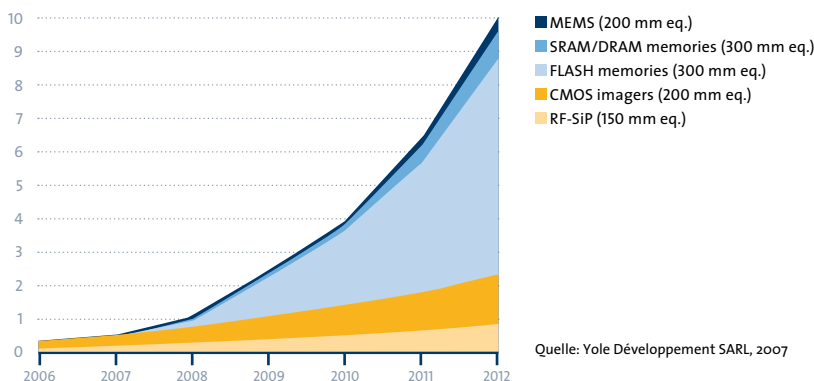
Der Markt für Verbindungshalbleiter ist stark diversifiziert und daher schwer einzuschätzen. Allerdings gibt es klar identifizierbare Wachstumstreiber, wie zum Beispiel den LED-Bereich (Leuchtdioden). LEDs sind im Vergleich zu herkömmlichen Lichtquellen platzsparend, sie haben eine extrem lange Lebensdauer und ermöglichen einen niedrigen Energieverbrauch, was angesichts der aktuellen Klimadebatte ein immer gewichtigeres Argument darstellt und zahlreiche Neuentwicklungen im LED-Markt forciert. So hat das Unternehmen Osram Opto Semiconductors mit mehr als 3.000 Patenten für optoelektronische Halbleiter für seine kontinuierliche Innovationskraft den „Best Innovator Award 2007“ gewonnen. Osram vertraut bei seinen LED-Produktlinien auf die hochwertigen Geräte von SÜSS und hat erst kürzlich die Partnerschaft mit SÜSS bekräftigt.

### Endogene Indikatoren

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebots entscheidend. Wir wissen aus Erfahrung, dass vorübergehende Schwächen bei den Chipherstellern zumindest teilweise durch Bestellungen von Forschungskunden ausgeglichen werden können. Genau für diesen Markt planen wir bedeutende Produkteinführungen im Jahr 2008. Außerdem gehen wir davon aus, dass unsere Neuentwicklungen für die 3D-Integration, die Wafer Level Redistribution, das Nanoimprinting und andere Anwendungen schon in 2008 das Interesse von Chipherstellern finden werden, die nach und nach diese neuen Prozesse in ihre Herstellung integrieren werden.



### Wachstum des Advanced-Packaging-Marktes in Mio. Wafer pro Jahr



## Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

Für die gesamte Gruppe streben wir in den nächsten drei bis fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 10 % an. Nach einem rückläufigen Geschäftsjahr 2007 mit schrumpfenden Umsätzen erwarten wir 2008 eine moderat positive Entwicklung gegen den Trend des allgemeinen Halbleitermarktes. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass wir – trotz des verkauften Segments Device Bonder – einen Umsatz mindestens auf dem Niveau des Berichtsjahres erzielen können.

Durch Skaleneffekte, verbesserte Fertigungs- und Steuerungsprozesse und neue Produkte gehen wir trotz anhaltender Dollarschwäche davon aus, die Rohertragsmarge auf dem Niveau des Berichtsjahres halten zu können.

Wir erwarten, dass das operative Geschäft ausreichend freien Cashflow generieren wird, so dass kein zusätzlicher Liquiditätsbedarf für das organische Wachstum des Basisgeschäfts auftreten sollte.

## Vorausschauende Aussagen

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2008

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind  
Vorstandsvorsitzender (CEO)

Michael Knopp  
Finanzvorstand (CFO)

# ++ Konzernabschluss +

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in T€	Anhang Nr.	01.01.2007 – 31.12.2007	
		Fortgeführte Aktivitäten	Nicht fortgeführte Aktivitäten
Umsatzerlöse	(3)	139.155	6.399
Umsatzkosten	(4)	-80.878	-3.786
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		<b>58.277</b>	<b>2.613</b>
Vertriebskosten		-24.989	-1.155
Forschungs- und Entwicklungskosten		-6.970	-155
Verwaltungskosten		-20.258	-389
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	4.382	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-5.381	-12
<b>Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT):</b>			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		9.719	907
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-4.658	-5
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>		<b>5.061</b>	<b>902</b>
Finanzergebnis	(7)	-205	-89
<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>4.856</b>	<b>813</b>
Ertragsteuern	(8)	-1.150	0
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>3.706</b>	<b>813</b>
Davon Minderheitsanteile		114	0
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		3.592	813
<b>Ergebnis je Aktie</b>			
Unverwässertes Ergebnis je Aktie in €	(9)	0,21	0,05
Verwässertes Ergebnis je Aktie in €	(9)	0,20	0,05



01.01.2006 – 31.12.2006

	Konzern	Fortgeführte Aktivitäten	Nicht fortgeführte Aktivitäten	Konzern
	145.554	148.406	7.085	155.491
	-84.664	-82.691	-3.156	-85.847
	<b>60.890</b>	<b>65.715</b>	<b>3.929</b>	<b>69.644</b>
	-26.144	-22.492	-1.857	-24.349
	-7.125	-6.658	-372	-7.030
	-20.647	-20.044	-660	-20.704
	4.382	1.431	1	1.432
	-5.393	-2.959	0	-2.959
	10.626	20.960	1.211	22.171
	-4.663	-5.967	-170	-6.137
	<b>5.963</b>	<b>14.993</b>	<b>1.041</b>	<b>16.034</b>
	-294	-309	-112	-421
	<b>5.669</b>	<b>14.684</b>	<b>929</b>	<b>15.613</b>
	-1.150	-782	82	-700
	<b>4.519</b>	<b>13.902</b>	<b>1.011</b>	<b>14.913</b>
	114	114	0	114
	4.405	13.788	1.011	14.799
	0,26	0,82	0,06	0,88
	0,25	0,81	0,06	0,87

## Konzernbilanz (IFRS)

AKTIVA in T€	Anhang Nr.	31.12.2007	31.12.2006
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>58.130</b>	<b>52.435</b>
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	19.483	14.514
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	21.961	22.726
Sachanlagen	(13)	5.049	4.948
Sonstige Finanzanlagen	(14)	5	5
Steuererstattungsansprüche	(20)	619	598
Sonstige Vermögenswerte	(15)	519	417
Latente Steueransprüche	(8)	10.494	9.227
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>105.000</b>	<b>104.840</b>
Vorräte	(16)	53.750	57.964
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(17)	25.582	23.244
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(18)	3.023	611
Wertpapiere	(19)	2	9
Steuererstattungsansprüche	(20)	847	1.029
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		20.092	20.459
Sonstige Vermögenswerte	(21)	1.704	1.524
<b>Bilanzsumme</b>		<b>163.130</b>	<b>157.275</b>



<b>PASSIVA</b> in T€	<b>Anhang Nr.</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2006</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b>102.568</b>	<b>99.155</b>
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		102.291	98.992
Gezeichnetes Kapital	(22)	17.019	17.007
Rücklagen	(22)	87.383	82.339
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(22)	-2.111	-354
Minderheitsanteile		277	163
<b>Langfristige Schulden</b>		<b>19.309</b>	<b>11.787</b>
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(23)	2.738	2.596
Rückstellungen	(24)	737	586
Finanzschulden	(25)	9.255	2.677
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(26)	51	195
Latente Steuerschulden	(8)	6.528	5.733
<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>41.253</b>	<b>46.333</b>
Rückstellungen	(27)	2.922	5.030
Steuerschulden	(30)	2.213	1.338
Finanzschulden	(25)	3.184	3.116
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(28)	4.089	3.185
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.828	6.418
Sonstige Verbindlichkeiten	(29)	20.017	27.246
<b>Bilanzsumme</b>		<b>163.130</b>	<b>157.275</b>

## Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS)

in T€	01.01. – 31.12.2007	01.01. – 31.12.2006
Gewinn/Verlust (nach Steuern)	4.519	14.913
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.129	3.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.534	2.437
Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten und Schulden eines aufgegebenen Geschäftsbereichs	98	0
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	333	202
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	1.540	1.526
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-579	-10
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	619	403
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-773	-417
Zahlungsunwirksame Aufzinsung der Wandel- und Optionsanleihe	20	127
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	2.090	2.400
Veränderung des Vorratsvermögens	-4.453	-8.009
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.988	-1.290
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-718	-796
Veränderung der Pensionsrückstellungen	182	67
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.818	1.368
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-5.429	-1.544
Veränderung der latenten Steuern	-472	-664
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>1.470</b>	<b>14.413</b>
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>3.329</b>	<b>11.127</b>

in T€	01.01. – 31.12.2007	01.01. – 31.12.2006
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.514	-2.291
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-8.605	-4.968
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	6	9
Einzahlung aus dem Abgang von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten und Veräußerungsgruppen	1.956	0
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-9.157</b>	<b>-7.250</b>
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>-11.103</b>	<b>-7.196</b>
Aufnahme von Bankdarlehen	8.910	398
Tilgung von Bankdarlehen	-1.503	-7.374
Tilgung der Wandelanleihe	0	-3.622
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	591	-2.314
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-191	-127
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	32	711
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>7.839</b>	<b>-12.328</b>
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Aktivitäten</b>	<b>7.951</b>	<b>-11.520</b>
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-519	-701
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>-367</b>	<b>-5.866</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang</b>	<b>20.459</b>	<b>26.325</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode</b>	<b>20.092</b>	<b>20.459</b>
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	331	862
Zinseinnahmen während der Periode	522	522
Steuerzahlungen während der Periode	1.138	1.132
Steuererstattungen während der Periode	342	0

## Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung (IFRS)

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage
<b>Stand 01.01.2006</b>	<b>16.793</b>	<b>90.673</b>
Ausgabe von Stückaktien: Ausübung von Aktienoptionen	214	497
Zuführung auf Grund Ausgabe von Bezugsrechten		403
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
<b>Stand 31.12.2006</b>	<b>17.007</b>	<b>91.573</b>
<b>Stand 01.01.2007</b>	<b>17.007</b>	<b>91.573</b>
Ausgabe von Stückaktien: Ausübung von Aktienoptionen	12	20
Zuführung auf Grund Ausgabe von Bezugsrechten		619
Jahresergebnis		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren nach Steuereffekt		
Fremdwährungsanpassung		
<b>Stand 31.12.2007</b>	<b>17.019</b>	<b>92.212</b>

Gewinnrücklage	Bilanzgewinn/ -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
<b>433</b>	<b>-24.466</b>	<b>683</b>	<b>84.116</b>	<b>49</b>	<b>84.165</b>
			711		711
			403		403
	14.799		14.799	114	14.913
		-31	-31		-31
		-1.006	-1.006		-1.006
<b>433</b>	<b>-9.667</b>	<b>-354</b>	<b>98.992</b>	<b>163</b>	<b>99.155</b>
<b>433</b>	<b>-9.667</b>	<b>-354</b>	<b>98.992</b>	<b>163</b>	<b>99.155</b>
			32		32
			619		619
	4.405		4.405	114	4.519
		63	63		63
		-1.820	-1.820		-1.820
<b>433</b>	<b>-5.262</b>	<b>-2.111</b>	<b>102.291</b>	<b>277</b>	<b>102.568</b>

## Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Anlagespiegel 2007

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.2007
	01.01.2007	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.629	-291	1.755	0	114	17.979
2. Entwicklungskosten	19.647	-697	6.850	0	0	25.800
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	154	-8	0	0	0	146
	<b>36.430</b>	<b>-996</b>	<b>8.605</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>43.925</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>37.137</b>	<b>-765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.372</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	6.051	-208	139	259	2.660	3.581
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.397	-894	736	-23	594	9.622
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.577	-229	1.356	23	808	10.919
4. Fahrzeuge	482	-4	73	0	43	508
5. Anlagen im Bau	159	-8	132	-259	0	24
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	280	-34	78	0	0	324
Technische Anlagen und Maschinen	1.320	-32	0	0	494	794
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.144	-11	0	0	379	754
	<b>30.410</b>	<b>-1.420</b>	<b>2.514</b>	<b>0</b>	<b>4.978</b>	<b>26.526</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	173	0	0	0	0	173
	<b>2.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.268</b>

**Kumulierte Abschreibungen**

**Restbuchwerte**

01.01.2007	Währungs- differenz	Kumulierte Abschreibungen			31.12.2007	Restbuchwerte	
		Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang		31.12.2006	31.12.2007
13.796	-240	1.239	0	108	14.687	2.833	3.292
7.968	-247	1.888	0	0	9.609	11.679	16.191
152	-8	2	0	0	146	2	0
<b>21.916</b>	<b>-495</b>	<b>3.129</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>24.442</b>	<b>14.514</b>	<b>19.483</b>
<b>14.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.411</b>	<b>22.726</b>	<b>21.961</b>
5.005	-170	248	0	2.188	2.895	1.046	686
9.140	-793	245	0	474	8.118	1.257	1.504
8.782	-195	826	0	745	8.668	1.795	2.251
420	-5	29	0	39	405	62	103
0	0	0	0	0	0	159	24
70	-13	97	0	0	154	210	170
928	-22	84	0	485	505	392	289
1.117	-11	5	0	379	732	27	22
<b>25.462</b>	<b>-1.209</b>	<b>1.534</b>	<b>0</b>	<b>4.310</b>	<b>21.477</b>	<b>4.948</b>	<b>5.049</b>
2.095	0	0	0	0	2.095	0	0
168	0	0	0	0	168	5	5
<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



## Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens Anlagespiegel 2006

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					31.12.2006
	01.01.2006	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.678	-158	130	9	30	16.629
2. Entwicklungskosten	15.550	-577	4.838	0	164	19.647
3. Aktivierte Leasinggegenstände Software	173	-19	0	0	0	154
	<b>32.401</b>	<b>-754</b>	<b>4.968</b>	<b>9</b>	<b>194</b>	<b>36.430</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>37.971</b>	<b>-834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.137</b>
<b>III. Sachanlagen</b>						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	6.102	-237	193	0	7	6.051
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.436	-948	946	-20	17	10.397
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.649	-285	844	41	672	10.577
4. Fahrzeuge	566	-16	27	-14	81	482
5. Anlagen im Bau	71	-2	106	-16	0	159
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	127	-22	175	0	0	280
Technische Anlagen und Maschinen	1.375	-55	0	0	0	1.320
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161	-17	0	0	0	1.144
	<b>30.487</b>	<b>-1.582</b>	<b>2.291</b>	<b>-9</b>	<b>777</b>	<b>30.410</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>						
1. At-equity bewertete Beteiligungen	2.095	0	0	0	0	2.095
2. Sonstige Finanzanlagen	201	0	0	0	28	173
	<b>2.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28*</b>	<b>2.268</b>

\*) betrifft Veränderung Konsolidierungskreis

Kumulierte Abschreibungen

Restbuchwerte

01.01.2006	Währungs- differenz	Kumulierte Abschreibungen			Restbuchwerte		
		Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2006	31.12.2005	31.12.2006
12.617	-128	1.344	-9	28	13.796	4.061	2.833
5.977	-335	2.326	0	0	7.968	9.573	11.679
139	-17	30	0	0	152	34	2
<b>18.733</b>	<b>-480</b>	<b>3.700</b>	<b>-9</b>	<b>28</b>	<b>21.916</b>	<b>13.668</b>	<b>14.514</b>
<b>14.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.411</b>	<b>23.560</b>	<b>22.726</b>
4.871	-194	328	0	0	5.005	1.231	1.046
8.832	-867	1.156	19	0	9.140	1.604	1.257
8.935	-199	722	-21	655	8.782	1.714	1.795
494	-33	25	11	77	420	72	62
0	0	0	0	0	0	71	159
21	-5	54	0	0	70	106	210
822	-41	147	0	0	928	553	392
1.128	-16	5	0	0	1.117	33	27
<b>25.103</b>	<b>-1.355</b>	<b>2.437</b>	<b>9</b>	<b>732</b>	<b>25.462</b>	<b>5.384</b>	<b>4.948</b>
2.095	0	0	0	0	2.095	0	0
168	0	0	0	0	168	33	5
<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>33</b>	<b>5</b>

## Segmentberichterstattung (IFRS)

### Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

in T€	Lithografie		Substrat Bonder		Test Systeme	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006
Außenumsatz	83.836	92.078	16.313	14.124	27.810	30.194
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamter Umsatz</b>	<b>83.836</b>	<b>92.078</b>	<b>16.313</b>	<b>14.124</b>	<b>27.810</b>	<b>30.194</b>
Segmentergebnis	13.666	18.486	-954	-508	395	3.251
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-1.148	-1.083	-383	-90	-216	426
Segmentvermögen	62.647	59.698	24.044	21.560	18.535	17.708
- davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0	4.060	4.317
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
<b>Konzernaktiva</b>						
Segmentsschulden	-18.908	-19.429	-5.917	-6.286	-4.237	-6.008
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
<b>Konzernschulden</b>						
Abschreibungen	2.721	3.138	1.173	1.081	324	308
- davon planmäßig	2.721	3.138	1.173	1.081	324	308
- davon außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
Investitionen	2.192	1.848	4.425	1.584	740	239
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt	310	298	101	85	140	129

### Segmentinformationen nach Regionen

in T€	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006
Europa	48.173	43.225	5.498	4.183	79.779	78.196
Nordamerika	41.154	47.684	4.893	2.700	39.499	42.594
Japan	17.867	17.098	209	103	6.254	3.329
Sonstiges Asien	38.329	47.170	277	80	734	579
Rest	31	314	242	193	2.411	2.345
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-2.852	-3.647
<b>Gesamt</b>	<b>145.554</b>	<b>155.491</b>	<b>11.119</b>	<b>7.259</b>	<b>125.825</b>	<b>123.396</b>

Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten		Konsolidierungseffekte		Summe	
2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006
11.196	12.010	139.155	148.406	6.399	7.085	-	-	145.554	155.491
6.072	5.065	6.072	5.065	0	0	-6.072	-5.065	0	0
<b>17.268</b>	<b>17.075</b>	<b>145.227</b>	<b>153.471</b>	<b>6.399</b>	<b>7.085</b>	<b>-6.072</b>	<b>-5.065</b>	<b>145.554</b>	<b>155.491</b>
-6.119	-4.545	6.988	16.684	902	1.042	-	-	7.890	17.726
-2.212	-405	-3.959	-1.152	233	-350	-	-	-3.726	-1.502
20.365	17.166	125.591	116.132	234	7.264	-	-	125.825	123.396
4.302	4.810	21.961	22.726	0	0	-	-	21.961	22.726
								37.305	33.879
								<b>163.130</b>	<b>157.275</b>
-4.360	-4.031	-33.422	-35.754	-1.399	-2.918	-	-	-34.821	-38.672
								-25.741	-19.448
								<b>-60.562</b>	<b>-58.120</b>
440	1.440	4.658	5.967	5	170	-	-	4.663	6.137
440	1.440	4.658	5.967	5	170	-	-	4.663	6.137
0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
3.753	3.534	11.110	7.205	9	54	-	-	11.119	7.259
177	169	728	681	25	43	-	-	753	724





### IFRS 8 „Segmentberichterstattung“

Durch IFRS 8 wird die Segmentberichterstattung vom so genannten risk and reward approach des IAS 14 auf den management approach in Bezug auf die Segmentidentifikation umgestellt. Maßgeblich sind dabei die Informationen, die dem so genannten chief operating decision maker regelmäßig für Entscheidungszwecke zur Verfügung gestellt werden. Gleichzeitig wird die Bewertung der Segmente vom financial accounting approach des IAS 14 auf den management approach umgestellt.

IFRS 8 ist verpflichtend auf Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig. IFRS 8 wird bei der erstmaligen Anwendung durch die SÜSS MicroTec AG zu geänderten Angaben in der Segmentberichterstattung führen.

### IFRIC 12 „Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen“

Das International Financial Reporting Committee (IFRIC) hat am 30. November 2006 die Interpretation IFRIC 12 „Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Interpretation steht die Bilanzierung von Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen bei Unternehmen, die im Auftrag von Gebietskörperschaften öffentliche Leistungen, wie etwa den Bau von Straßen, Flughäfen, Gefängnissen oder Energieinfrastruktur, anbieten. Während die Verfügungsmacht über die Vermögenswerte bei der öffentlichen Hand verbleibt, ist das Unternehmen vertraglich zum Bau, dem Betrieb und für die Instandhaltung verpflichtet.

IFRIC 12 behandelt die Frage, wie Unternehmen die sich aus derartigen vertraglichen Vereinbarungen ergebenden Rechte und Pflichten zu bilanzieren haben. Die Interpretation unterscheidet zwei Arten von Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen:

- (a) Das Unternehmen erwirbt einen unbedingten Anspruch auf Geldzahlung oder einen sonstigen finanziellen Ausgleich gegenüber der öffentlichen Hand, wodurch ein finanzieller Vermögenswert begründet wird. Dieser Vermögenswert stellt die Gegenleistung für die Erbringung einer öffentlichen Leistung dar, insbesondere für den Bau oder die wesentliche Verbesserung eines Vermögenswerts.
- (b) Das Unternehmen erhält das Recht, den Nutzern ein Nutzungsentgelt in Rechnung zu stellen. In diesem Fall erwirbt das Unternehmen einen immateriellen Vermögenswert hinsichtlich der Bewirtschaftung der öffentlich angebotenen Einrichtungen.

Die Interpretation, die bisher nicht von der EU übernommen wurde, ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2008 beginnen, verpflichtend anzuwenden.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung im Geschäftsjahr 2008 keine Auswirkungen.

### Änderungen an IAS 23 „Borrowing Costs“

Die wesentliche Änderung, die vom IASB im März 2007 veröffentlicht wurde, betrifft die Streichung des Wahlrechts, Fremdkapitalkosten direkt als Aufwand zu erfassen, die direkt dem Erwerb, Bau oder der Herstellung eines qualifizierten Vermögenswerts zugeordnet werden können. Ein qualifizierter Vermögenswert liegt in diesem Zusammenhang vor, wenn ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um den Vermögenswert in seinen beabsichtigten gebrauchsfähigen oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. Unternehmen müssen demnach zukünftig solche Fremdkapitalkosten als Teil der Anschaffungskosten der qualifizierten Vermögenswerte aktivieren.

Der Standard, der bisher nicht von der EU übernommen wurde, ist erstmals auf Fremdkapitalkosten für qualifizierte Vermögenswerte anzuwenden, deren Anfangszeitpunkt für die Aktivierung am oder nach dem 1. Januar 2009 liegt.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.





### c) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

#### Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG ermittelt den erzielbaren Betrag eines Segments grundsätzlich auf der Basis des beizulegenden Zeitwerts abzüglich Verkaufskosten. Diese Werte beruhen grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

#### Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellkosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal 10 Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Fremdkapitalkosten werden nicht aktiviert. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.

#### Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Grundstücke, Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre



### Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

### Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

### Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen. Im Falle einer Wertminderung wird das kumulierte übrige Eigenkapital um den Wertminderungsbetrag reduziert und der entsprechende Betrag unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

### Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

### Aktienbasierte Vergütungen

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

### Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der Zinsaufwendungen ausgewiesen.

### Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und wenn die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

### Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Anleihen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus Anleihen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

### Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

### Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 mit dem Eigentums- bzw. Gefahrenübergang an den Kunden erfasst, wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar ist und von dessen Bezahlung ausgegangen werden kann.

Ist in Verträgen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und Endabnahme mit dem Kunden vereinbart, werden Umsatzerlöse erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

### Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

### Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

### Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

### Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

### Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden grundsätzlich erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen erfasst. Die Gesellschaft wendet Hedge Accounting nicht an, obwohl es sich bei den derivativen Finanzinstrumenten um effektive Sicherungsgeschäfte handelt.

### Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgegrenzt.

### Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.



### Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

### e) Konsolidierung

#### Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

#### Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2007		2006	
	Bilanz	GuV	Bilanz	GuV
1 € vs 1 USD	1,47	1,37	1,32	1,26
1 € vs 100 JPY	165,00	161,63	156,65	146,17
1 € vs 1 GBP	0,73	0,69	0,67	0,68
1 € vs 1 CHF	1,66	1,64	1,61	1,58
1 € vs 100 TWD	47,90	45,12	42,90	40,91
1 € vs 100 SGD	2,12	2,06	–	–
1 € vs 100 CNY	10,74	10,32	10,29	9,86
1 € vs 100 THB	43,83	44,55	46,77	47,61

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

#### Angaben zum Konsolidierungskreis

Im zweiten Quartal wurde die neugegründete Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd. in den Konsolidierungskreis einbezogen, an der die SÜSS MicroTec AG mit 100 % beteiligt ist. Bei der Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd. handelt es sich um eine reine Vertriebsgesellschaft, die vor allem die Präsenz der Division „Test Systeme“ in Singapur verstärken soll. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis ist für die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns nicht wesentlich.



Im dritten Quartal hat die SÜSS MicroTEC AG ihre inaktive Beteiligung an der Suss MicroTEC Laboratory Equipment GmbH an die Suss MicroTEC Lithography GmbH verkauft. Im Anschluss wurde die Suss MicroTEC Laboratory Equipment GmbH rückwirkend zum 1. Januar 2007 auf die Suss MicroTEC Lithography GmbH verschmolzen. Diese Veränderung im Konsolidierungskreis hat keine Auswirkung auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns.

Weitere Änderungen des Konsolidierungskreises ergaben sich im Geschäftsjahr 2007 nicht. In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTEC AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTEC AG, Garching	17.019.126,00 €	Holding	96.177.282,11 €	-2.837.418,06 €	
Suss MicroTEC Lithography GmbH, Garching	2.000.100,00 €	100%	15.332.814,00 €	3.791.759,20 €	voll
Suss MicroTEC Test Systems GmbH, Sacka <sup>a)</sup>	511.291,88 €	100%	8.793.426,00 €	-44.469,44 €	voll
Suss MicroTEC Ltd., Wokingham Berkshire	£10.000,00	100%	£1.501.328,00	£54.284,91	voll
Suss MicroTEC KK, Yokohama	30.000,00 TJPY	100%	396.002.175,00 TJPY	8.127.615,00 TJPY	voll
Suss MicroTEC S.A.S., St. Jeoire	1.275.000,00 €	100%	184.538,00 €	42.356,00 €	voll
Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel	500.000,00 CHF	85%	3.193.122,00 CHF	1.506.632,09 CHF	voll
Suss MicroTEC Inc., Waterbury	\$105.000,00	100%	-\$4.568.814,00	-\$13.016.837,27	voll
Suss MicroTEC (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	5.000.000,00 TWD	100%	78.558.474,00	14.207.366,00	voll
Suss MicroTEC Company Ltd., Shanghai	1.655.320,00 CNY	100%	5.481.493,00 CNY	630.602,43 CNY	voll
Image Technology Inc., Palo Alto	\$24.287,00	100%	\$2.995.053,00	\$843.777,19	voll
MFI Technologies Group, Vancouver	\$2.737.476,00	100%	-\$4.241.774,00	-\$16.244,41	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose <sup>b)</sup>	\$1.190.442,00	53,1%	-\$39.579,00	-\$3.982,00	at cost
Suss MicroTEC Company Ltd., Bangkok <sup>c)</sup>	4.000,00 THB	49%	13.702.303,00 THB	1.938.902,06 THB	voll
Suss MicroTEC REMAN GmbH, Oberschleißheim	25.564,59 €	100%	205.872,00 €	423.254,49 €	voll
Suss MicroTEC (Singapore) Pte Ltd., Singapur	12.725,88 SGD	100%	-9.824,80 SGD	-34.824,80 SGD	voll
Zentrum für Technologiestruktur-entwicklung, Glaubitz	51.129,19 €	10%	n/a	n/a	at cost
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand <sup>d)</sup>	52.000,00 €	10%	1.191.729,00 €	-221.728,00 €	at cost

<sup>a)</sup> Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisführungsvertrages mit der SÜSS MicroTEC AG

<sup>b)</sup> auf Grund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

<sup>c)</sup> Vollkonsolidierung über Kontrollausübung

<sup>d)</sup> Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2006

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zu Grunde.

#### Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat weder im Geschäftsjahr 2007 noch im Vorjahr Akquisitionen vorgenommen.

### Nicht fortgeführte Aktivitäten

Mit Kaufvertrag vom 16. Juli 2007 hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Device Bondern getrennt. Die in St. Jeoire, Frankreich, angesiedelte Suss MicroTec S.A.S., eine 100 %ige Tochter der Konzernholding, hat sich mit dem früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. auf die Veräußerung des Device-Bonder-Geschäfts an eine vom früheren Management der Suss MicroTec S.A.S. gehaltene Gesellschaft im Rahmen eines Management-Buy-Out geeinigt.

Im Wege eines Asset Deals wurden die wesentlichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Device-Bonder-Geschäfts der Suss MicroTec S.A.S. veräußert. Die Übertragung des Device-Bonder-Geschäfts erfolgte mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2007. Der Kaufpreis beträgt T€ 2.000 und entspricht damit in etwa der Differenz zwischen übertragenen Vermögenswerten und von der Käuferin übernommenen Verbindlichkeiten zum wirtschaftlichen Übertragungstichtag. Cashwirksame Veränderungen der übertragenen Vermögenswerte und übernommenen Verbindlichkeiten im Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis zum 16. Juli 2007 werden darüber hinaus zwischen den Parteien ausgeglichen. Aus Konzernsicht ergab sich insgesamt ein Abgangsverlust in Höhe von T€ 98.

Im Einzelnen stellen sich die übertragenen Vermögenswerte bzw. die von der Käuferin übernommenen Verbindlichkeiten zum 16. Juli 2007 aus Konzernsicht wie folgt dar:

in T€	16.07.2007
<b>Übertragene Vermögenswerte</b>	
Immaterielle Vermögenswerte	4
Sachanlagen	589
Sonstige langfristige Vermögenswerte	1
Vorräte	4.624
Forderung aus Lieferungen und Leistungen	346
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	793
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	73
	<b>6.430</b>
<b>Von der Käuferin übernommene Verbindlichkeiten</b>	
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40
Langfristige Finanzschulden	992
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	3
Kurzfristige Rückstellungen	35
Kurzfristige Finanzschulden	178
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	196
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	565
	<b>2.685</b>

Die folgenden Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung beinhalten sowohl die fortgeführten als auch die nicht fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Eine getrennte Darstellung der fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten erfolgt in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung.

#### Risikoberichterstattung

Auf die Ausführungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu betrachten.

## Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

### (3) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Maschinen	115.294	121.798
Ersatzteile	13.848	15.167
Serviceleistungen	5.327	6.266
Sonstige	11.085	12.260
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.554</b>	<b>155.491</b>

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten vor allem Erlöse aus dem Maskengeschäft sowie aus den Bereichen Mikrooptik und C4NP.

### (4) Umsatzkosten

In den Umsatzkosten sind insgesamt Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 1.888 (2006: T€ 2.326) enthalten.

Zudem sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Demogeräte und fertige Erzeugnisse von T€ 1.824 (2006: T€ 1.367) und auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertige Erzeugnisse von T€ 2.635 eingeflossen. Diese Wertminderungen beinhalten Abwertungen von T€ 1.889, die im Rahmen der verlustfreien Bewertung angearbeiteter Lagerbestände für die C4NP-Maschinen anfielen. Im Vorjahr wurden auf die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe noch Zuschreibungen in Höhe von T€ 31 vorgenommen.

## (5) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Fremdwährungsgewinne	2.637	126
Rückstellungsaufösungen	773	417
Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	578	61
Mieterträge	166	47
Sonstige Zuschüsse	65	356
Versicherungsleistungen	24	146
Sonstiges	139	279
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.382</b>	<b>1.432</b>

Die Fremdwährungsgewinne enthalten vor allem Kursgewinne aus den realisierten Devisensicherungsgeschäften des Unternehmens sowie unrealisierte Kursgewinne aus der Bewertung der noch offenen Devisentermingeschäfte zum Bilanzstichtag. Damit konnte die SÜSS MicroTec AG wesentliche Teile der Fremdwährungsverluste kompensieren, die infolge der Abschwächung des US-Dollars sowie des japanischen Yen im Verhältnis zum Euro entstanden sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren zum einen aus gesunkenen Garantie- und Gewährleistungskosten sowie aus verminderten Risikovorsorgen bei der Muttergesellschaft.

Infolge einer sehr niedrigen Ausfallquote von Kundenforderungen konnten die auf Portfoliobasis gebildeten Einzelwertberichtigungen des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr reduziert werden.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen – wie im Vorjahr – insbesondere erhaltene Aufwandszuschüsse aus Förderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

## (6) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Fremdwährungsverluste	3.797	1.623
Buchverluste aus dem Abgang von Sachanlagen	247	202
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	0	51
Vertragsstrafen, Schadensersatz	0	59
Sonstiges	1.349	1.024
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.393</b>	<b>2.959</b>

Die Fremdwährungsverluste des abgelaufenen Geschäftsjahres beinhalten unrealisierte Währungsverluste aus der Bewertung konzerninterner Fremdwährungsdarlehen, die von der SÜSS MicroTec AG an die Süss MicroTec Inc. ausgereicht wurden. Zum 1. Oktober 2007 wurde ein großer Teil der offenen Forderungen in ein unbefristetes Darlehen umgewandelt. Entsprechend IAS 21 weist das Unternehmen die Bewertungseffekte aus der Stichtagsbewertung nicht mehr in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern im Kumulierten übrigen Eigenkapital aus. Des Weiteren enthält diese Position realisierte Fremdwährungsverluste aus dem operativen Geschäft des Unternehmens, das in den Fremdwährungen US-Dollar und japanischer Yen abgewickelt wurde. Beide Währungen haben sich im Verhältnis zum Euro im Berichtsjahr deutlich abgeschwächt.

## (7) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis enthält neben Wertminderungen auf zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte in Höhe von T€108 (2006: T€ 0) Zinsaufwendungen und Zinserträge.

Die Zinsaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€	2007	2006
Bankverbindlichkeiten	412	638
Pensionsrückstellungen	247	78
Optionsanleihe	39	227
Zinsswaps	10	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>708</b>	<b>943</b>

Bei den Zinsaufwendungen aus der Optionsanleihe handelt es sich in Höhe von T€ 19 (2006: T€ 100) um Zinszahlungen an die Anleihegläubiger und in Höhe von T€ 20 (2006: T€ 127) um den Aufstockungsbetrag zur Erreichung des Rückzahlungsbetrags bei Laufzeitende.

Die Zinserträge in Höhe von T€ 522 (2006: T€ 522) resultieren überwiegend aus Geldmarktanlagen.

## (8) Ertragsteuern

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in T€	2007	2006
Deutsche Körperschaftsteuer	-62	-300
Deutsche Gewerbeertragsteuer	-33	-180
Ausländische Ertragsteuer	1.245	1.180
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.150</b>	<b>700</b>
... davon laufend	1.668	1.277
... davon latent	-518	-577

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steuer-  
aufwand.

in T€	2007	2006
<b>Angenommener Steuersatz</b>		
Körperschaftsteuer	25,00 %	25,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuersatz	14,90 %	14,90 %
<b>Kombinierter Steuersatz</b>	<b>37,34 %</b>	<b>37,34 %</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>5.712</b>	<b>15.613</b>
<b>Erwartete Ertragsteuern</b>	<b>2.133</b>	<b>5.830</b>
Abweichende Steuersätze im Ausland	-642	-403
Steuersatzänderung Inland	1.310	0
Gewerbesteuerliche Anrechnung von Dauerschuldzinsen	25	79
Aktivierung Körperschaftsteuerguthaben	0	-598
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	385	274
Steueraufwand Vorjahre	230	544
Veränderung der Wertberichtigung auf latente Steueransprüche	-1.044	-3.823
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-1.224	-924
Steuerfreie Erträge	-26	-244
Steuerergütschriften	0	-115
Sonstiges	3	80
<b>Effektive Ertragsteuern</b>	<b>1.150</b>	<b>700</b>

Als Folge des nachhaltig positiven Geschäftsverlaufs im Segment Lithografie wurden im Berichtsjahr weitere Zuschreibungen auf latente Steueransprüche in Höhe von T€ 3.022 (2006: T€ 3.823) vorgenommen. Die Zuschreibungen erhöhen die latenten Steueransprüche auf einen Betrag, der nach Auffassung der Gesellschaft – basierend auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Gewinne sowie des Zeitpunkts der Umkehrung zeitlicher Buchungsunterschiede – wahrscheinlich realisiert werden kann. Damit sind die bei den deutschen Konzerngesellschaften vorhandenen Verlustvorträge in voller Höhe aktiviert. Gegenläufig wirkte bei der Veränderung der Wertberichtigung auf latente Steueransprüche die Wertberichtigung von T€ 1.978 auf das negative Jahresergebnis der Süss MicroTec Inc. Der resultierende Nettoeffekt von T€ 1.044 ist eine der beiden wesentlichen Ursachen für die nach wie vor relativ niedrige Konzernsteuerquote von rund 20 %. Die andere Ursache für die niedrige Konzernsteuerquote liegt in der Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge in Höhe von T€ 1.224 (2006: T€ 924), welche vor allem aus dem positiven Jahresergebnis der Süss MicroTec Lithography GmbH resultiert.

Gegenläufig wirkte sich auf die Konzernsteuerquote die Neubewertung der latenten Steueransprüche bei den deutschen Konzerngesellschaften aus. Durch das am 6. Juli 2007 vom Bundesrat verabschiedete Unternehmensteuerreformgesetz 2008 werden sich die Steuersätze in Deutschland ab dem Jahr 2008 deutlich vermindern. So wird der für die SÜSS MicroTec AG und ihre inländischen Tochtergesellschaften zu erwartende Ertragsteuersatz auf rund 28 % sinken. Dies machte im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Neubewertung der entsprechenden Steuerpositionen notwendig. Auf Grund des Überhangs an aktiven latenten Steuern in Deutschland ergab sich daraus für das Unternehmen ein zusätzlicher, nicht zahlungswirksamer Einmalaufwand von T€ 1.310.

Die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben beinhalten im Wesentlichen den bei der Muttergesellschaft erfassten Aufwand aus den Aktienoptionsplänen.

Der Steueraufwand Vorjahre betrifft Steuernachzahlungen von T€ 408, die im Wesentlichen von der Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd. zu leisten waren. Gegenläufig sind in dieser Position die Änderungen des zu versteuernden Einkommens in Höhe von T€ 268 der deutschen Konzerngesellschaften enthalten, die sich infolge abgeschlossener Betriebsprüfungen ergaben.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt wertberichtigte Verlustvorträge von T€ 1.224 in Anspruch genommen, während sich dieser Effekt im Vorjahr noch auf T€ 924 belief.

Eine Verringerung der Konzernsteuerquote des Vorjahres trat durch die Aktivierung eines Körperschaftsteuerguthabens von T€ 598 infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG) ein.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in T€	Aktiva		Passiva	
	2007	2006	2007	2006
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.308	532	5	33
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	781	1.063		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37	264	21	13
Langfristige Rückstellungen	179	374		
Immaterielle Vermögenswerte			3.078	3.352
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	3	4	110	135
Finanzschulden			30	19
Geschäfts- oder Firmenwert			861	825
Vorräte	1.376	1.113	91	460
Sachanlagen	0	234	2.329	648
Sonstiges	1	49	3	248
Verlustvorträge	6.809	5.594		
<b>Gesamt</b>	<b>10.494</b>	<b>9.227</b>	<b>6.528</b>	<b>5.733</b>

Der Konzern verfügt über Verlustvorträge in Höhe von T€ 38.747 (2006: T€ 36.268). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2012 insgesamt T€ 5.765. Im Zeitraum von 2022 bis 2027 verfallen insgesamt T€ 8.875. Verlustvorträge in Höhe von T€ 24.107 sind unbegrenzt nutzbar.

Die Veränderung der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme von Verlustvorträgen bei der Suss MicroTec Lithography GmbH. Gegenläufig wirkt der Aufbau von Verlustvorträgen durch den Jahresfehlbetrag bei der Suss MicroTec Inc.

Für Verlustvorträge in Höhe von T€ 14.640 (2006: T€ 21.288) wurden keine latenten Steuern angesetzt.



In den Abgrenzungsposten für latente Steuern sind zum Bilanzstichtag insgesamt Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von T€ 7.411 (2006: T€ 10.982) enthalten. Diese entfallen in Höhe von T€ 6.004 (2006: T€ 8.276) auf Verlustvorträge und in Höhe von T€ 1.407 (2006: T€ 2.706) auf temporäre Differenzen.

## (9) Ergebnis je Aktie

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in T€	2007	2006
Gewinn	4.519	14.913
Abzüglich: Minderheitsanteile	114	114
Gewinn, der auf die Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	<b>4.405</b>	<b>14.799</b>
Erhöhung des Gewinns		
durch verwässernd wirkende Optionsanleihe	26	142
<b>Gewinn, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt, nach Berücksichtigung von Verwässerungseffekten</b>	<b>4.431</b>	<b>14.941</b>
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien, unverwässert	17.012	16.823
Verwässerung auf Grund der bestehenden Aktienoptionsprogramme	61	67
Effekt aus der verwässernd wirkenden Optionsanleihe	373	373
<b>Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien, verwässert</b>	<b>17.446</b>	<b>17.263</b>
<b>Ergebnis je Aktie in €, unverwässert</b>	<b>0,26</b>	<b>0,88</b>
<b>Ergebnis je Aktie in €, verwässert</b>	<b>0,25</b>	<b>0,87</b>

Weitere Informationen zur Optionsanleihe sowie zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 22 und 25.

## (10) Sonstige Angaben zur IFRS – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

### Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in T€	2007	2006
Löhne und Gehälter	39.915	36.750
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.461	4.856
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.430	2.483
<b>Personalaufwand</b>	<b>46.806</b>	<b>44.089</b>

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge. Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.



## (13) Sachanlagen

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von T€ 481 (2006: T€ 629) auch geleaste Technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleaste Grundstücke, Gebäude und Einbauten enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zu Grunde liegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

## (14) Sonstige Finanzanlagen

Der Konzern hält weitere Beteiligungen mit Anteilen von weniger als 20 %. Diese werden bei Vorliegen von Marktwerten mit diesen bewertet. Anderenfalls erfolgt die Bewertung zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Wertminderungen.

## (15) Sonstige (langfristige) Vermögenswerte

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in T€	2007	2006
Rückdeckungsversicherung	398	254
Kautionen	120	161
Sonstiges	1	2
<b>Sonstige langfristige Vermögenswerte</b>	<b>519</b>	<b>417</b>

## (16) Vorräte

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in T€	2007	2006
Materialien und Hilfsstoffe	25.862	23.899
Unfertige Erzeugnisse	17.795	18.309
Fertigerzeugnisse	6.830	12.796
Demonstrationsgeräte	14.412	12.571
Handelswaren	110	108
Wertberichtigungen	-11.259	-9.719
<b>Vorratsvermögen</b>	<b>53.750</b>	<b>57.964</b>

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2007 bilanzierten Vorräte in Höhe von T€ 53.750 (2006: 57.964) sind T€ 22.308 (2006: T€ 6.408) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert. Dieser Anstieg resultiert aus einer Ausweisänderung bei der Suss MicroTec Inc., die ihre Demogeräte – analog zum Restkonzern – einer Bruttodarstellung unterzieht.

## (17) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in T€	2007	2006
Forderungen gegen Dritte	26.120	24.360
Wertberichtigungen	-538	-1.116
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>25.582</b>	<b>23.244</b>

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in T€	2007	2006
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	1.116	1.126
Im Berichtszeitraum als Ertrag erfasster Betrag	-326	-61
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-790	-1.065
Zuführungen	538	1.116
<b>Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende</b>	<b>538</b>	<b>1.116</b>

## (18) Sonstige finanzielle Vermögenswerte

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in T€	2007	2006
Offene Kaufpreisforderungen	1.906	0
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	397	371
Sonstiges	720	240
<b>Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>3.023</b>	<b>611</b>

Die offenen Kaufpreisforderungen resultieren aus dem Verkauf des Segments Device Bonder im Berichtsjahr und sind durch einen Tilgungsplan hinterlegt.

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten die positiven Marktwerte aus den Devisentermingeschäften aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften finden sich in der Textziffer 31 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (19) Wertpapiere

Als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte behandelt die Gesellschaft unter dieser Position den Aktienbesitz an der JMAR Technologies, Inc., der aus der Veräußerung von Patenten und der Technologie betreffend Röntgen-Lithografie im Geschäftsjahr 2001 stammt.

Der Aktienbestand wurde zum Bilanzstichtag mit dem Marktwert angesetzt, der aus dem amtlichen Börsenkurs abgeleitet wurde. Auf Grund der dauerhaften Wertminderung wurde der durch die Marktwertänderung entstandene Verlust in Höhe von T€ 7 unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst. Darüber hinaus wurden die in Vorjahren im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfassten Marktschwankungen in Höhe von T€ 101 ergebniswirksam angepasst.

Der Wert der Aktien beträgt zum Jahresende T€ 2 (2006: T€ 9).

## (20) Steuererstattungsansprüche

Die langfristigen Steuererstattungsansprüche resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von T€ 619 infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,77 % p. a. zu Grunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuererstattungsansprüche bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von T€ 847 (2006: T€ 1.029).

## (21) Sonstige (kurzfristige) Vermögenswerte

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2007	2006
Aktive Rechnungsabgrenzung	716	724
Geleistete Anzahlungen	606	564
Umsatzsteuer	382	236
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>1.704</b>	<b>1.524</b>

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

## Erläuterungen zu den Passiva

### (22) Eigenkapital

#### Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Vorjahresstichtag T€ 17.007. Infolge der Ausübung von insgesamt 12.200 Bezugsrechten in den im Aktienoptionsplan 2002 vorgesehenen Ausübungszeiträumen wurde das Grundkapital aus bedingtem Kapital 2002/II durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage um T€ 12 auf T€ 17.019 erhöht. Es ist in 17.019.126 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Gezeichneten Kapital von € 1,00 eingeteilt. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalentwicklung.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stammaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Das Stammkapital ist voll eingezahlt. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital blieb im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert und beträgt zum Bilanzstichtag T€ 6.022. Es ist genehmigt bis zum 16. Juni 2009.

Am 31. Dezember 2007 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt T€ 4.469 (2006: T€ 5.874). Es kann bis zu T€ 3.674 für die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen genutzt werden. Der Restbetrag von T€ 795 ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind T€ 45 dem Aktienoptionsplan 2002 und T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 zuzuordnen.

in T€	2007	2006
Grundkapital	17.019	17.007
Genehmigtes Kapital	6.022	6.022
Bedingtes Kapital	4.469	5.874

#### Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Kapitalrücklage	92.212	91.573
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzverlust	-5.262	-9.667
<b>Rücklagen</b>	<b>87.383</b>	<b>82.339</b>

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Geschäftsjahr durch die Ausübung von Aktienoptionen um T€ 20. Zudem wurden der Kapitalrücklage aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne T€ 619 ergebniswirksam zugeführt.

Im Vergleich zum Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG nach HGB unterscheidet sich die Kapitalrücklage im IFRS-Konzernabschluss durch die unterschiedliche Behandlung der Optionsanleihe sowie der Kosten der Kapitalerhöhungen in beiden Rechnungslegungsstandards.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der Bilanzverlust verringerte sich durch das positive Jahresergebnis von T€ 4.405 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf T€ -5.262.

### Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in T€	2007	2006
Fremdwährungsanpassungen	-291	715
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-63	-32
<b>Stand zu Beginn der Periode</b>	<b>-354</b>	<b>683</b>
<b>Veränderungen vor Steuern</b>		
Fremdwährungsanpassungen	-1.820	-1.006
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	101	-49
<b>Steuereffekte</b>		
Unrealisierte Verluste aus Wertpapieren	-38	18
<b>Stand am Ende der Periode</b>	<b>-2.111</b>	<b>-354</b>

### Aktionsoptionspläne der SÜSS MicroTec AG

#### Aktionsoptionsplan 1999

In der Hauptversammlung vom 6. April 1999 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 800 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 800.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. März 2004 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von drei Jahren und zu 50 % nach Ablauf einer Wartefrist von fünf Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien des Unternehmens den Bezugspreis bei Ausübung des Bezugsrechts nach drei Jahren um mindestens 50 %, nach vier Jahren um mindestens 75 % bzw. nach fünf Jahren um mindestens 100 % übersteigt. Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. sechs Jahre nach dem Ende der Erwerbsfrist.

In der Hauptversammlung vom 6. Juli 2007 wurde das bedingte Kapital für diesen Optionsplan auf T€ 0 gesenkt. Die Ausgabe von Bezugsrechten auf Basis des Aktienoptionsplans 1999 wurde für die Zukunft aufgehoben.

#### Aktionsoptionsplan 2002

In der Hauptversammlung vom 14. Juni 2002 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 500 durch Ausgabe von insgesamt bis zu 500.000 Aktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften bis zum 31. Dezember 2007 zu erhöhen. Die Bezugsrechte können nach Ablauf einer Wartefrist von zwei Jahren zu 100 % ausgeübt werden.





Der gewichtete durchschnittliche Marktwert der im Jahr 2007 gewährten Optionen in Höhe von € 3,0392 wurde unter Verwendung des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells berechnet. Für die Ermittlung des Marktwerts wurden folgende Parameter verwendet:

	2007	2006
Erwartete durchschnittl. Laufzeit	3,5 Jahre	5 Jahre
Risikofreier Zinssatz	4,36 %	4,04 %
Erwartete Volatilität SÜSS-Aktie	44 %	48 %
Erwartete Dividende	0 %	0 %

Die Berechnung der Volatilität erfolgte unter Berücksichtigung historischer Kursschwankungen der SÜSS MicroTec-Aktie.

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
<b>01.01.2006</b>	<b>673.027</b>	<b>12,42</b>
gewährt 2006	209.500	7,53
ausgeübt 2006	213.958	3,33
verfallen 2006	254.669	18,60
<b>31.12.2006</b>	<b>413.900</b>	<b>10,85</b>
gewährt 2007	350.300	8,39
ausgeübt 2007	12.200	2,58
verfallen 2007	83.050	30,58
<b>31.12.2007</b>	<b>668.950</b>	<b>7,26</b>
noch begebbar	200	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis €	gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit Monate
unter 2,50 €	7.500	1,11	17
2,50 € – 4,99 €	155.150	4,77	33
5,00 € – 7,49 €	0	0,00	0
7,50 € – 9,99 €	506.300	8,12	37
ab 10,00 €	0	0,00	0
	<b>668.950</b>	<b>7,26</b>	<b>36</b>

## (23) Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Inländische Verpflichtungen	1.935	1.995
Ausländische Verpflichtungen	803	601
<b>Gesamt</b>	<b>2.738</b>	<b>2.596</b>

### Leistungsorientierte Pläne („Defined Benefit Plans“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und ab 2007 in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne. Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2007	2006
Abzinsungsfaktor	5,45 % – 5,62 %	4,25 % – 4,50 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,80 % – 5,00 %	4,50 % – 4,75 %
Gehaltssteigerung	0,0 %	0,0 %
Rentensteigerung	1,0 %	1,0 %

Lebenserwartung gemäß Richttafeln Dr. Heubeck 2005

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2007
Abzinsungsfaktor	3,25 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,50 %
Gehaltssteigerung	1,5 %
Rentensteigerung	0,8 %

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2007 und 2006 wie folgt entwickelt:

in T€	2007	2006
<b>Anwartschaftsbarwert am 01.01.</b>	<b>3.986</b>	<b>4.013</b>
Erstmaliger Ansatz Schweiz	320	0
Dienstzeitaufwand	168	225
Zinsaufwand	306	137
Pensionszahlungen	-234	-255
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn/ (+) Verlust	-335	-54
Währungsveränderungen	-37	-80
<b>Anwartschaftsbarwert am 31.12.</b>	<b>4.174</b>	<b>3.986</b>

Der versicherungsmathematische Gewinn des Geschäftsjahres beruht maßgeblich auf dem Anstieg des Zinssatzes.

in T€	2007	2006
<b>Planvermögen am 01.01.</b>	<b>1.281</b>	<b>1.265</b>
Erstmaliger Ansatz Schweiz	320	0
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	59	59
Geleistete Fondsdotierungen	1	-42
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn/(-) Verlust	-21	-1
<b>Planvermögen am 31.12.</b>	<b>1.640</b>	<b>1.281</b>

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in T€	2007	2006
Barwert der Pensionsverpflichtungen	4.174	3.986
Zeitwert des Planvermögens	-1.640	-1.281
<b>Errechnete Pensionsverbindlichkeit</b>	<b>2.534</b>	<b>2.705</b>
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	204	-109
<b>Rückstellung</b>	<b>2.738</b>	<b>2.596</b>

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von T€ 2.303 (2006: T€ 1.861) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in T€	2007	2006
Dienstzeitaufwand	168	225
<b>Personalaufwandskomponente</b>	<b>168</b>	<b>225</b>
Zinsaufwand	306	137
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-59	-59
<b>Zinsaufwandskomponente</b>	<b>247</b>	<b>78</b>

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von T€ 168 (2006: T€ 152) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von T€ 0 (2006: T€ 73) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts, des Planvermögens sowie der versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste unterteilt nach Anwartschaftsbarwert und Planvermögen zeigt folgende Tabelle:

in T€	2007	2006	2005	2004
Anwartschaftsbarwert	4.174	3.986	4.013	3.607
Planvermögen	1.640	1.281	1.265	1.248
<b>Deckungsstatus</b>	<b>2.534</b>	<b>2.705</b>	<b>2.748</b>	<b>2.359</b>

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 Ap waren im Betrachtungszeitraum auf Grund des im Rahmen der Bewertung unveränderten Mengengerüsts nicht notwendig.

Im Geschäftsjahr 2008 werden erwartungsgemäß Beiträge in Höhe von T€ 67 in den Pensionsplan der Süss MicroOptics S.A. eingezahlt.

### Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2007 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den Gewinnbeteiligungsplan T€ 0 (2006: T€ 0) und für den 401 (k) Plan T€ 145 (2006: T€ 309).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von T€ 1.956 (2006: T€ 1.737) abgeführt.

## (24) (Langfristige) Rückstellungen

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2007	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2007
Altersteilzeit	586	-119	-35	305	737

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Süss MicroTec Lithography GmbH, der SÜSS MicroTec AG und der Süss MicroTec Test Systems GmbH, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung/Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeit-Nettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

## (25) Finanzschulden

Die Fälligkeitsstruktur der Anleihen, der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2007 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. Dezember 2007				
in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.624	9.082	0	11.706
Verbindlichkeiten aus Anleihen	355	0	0	355
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	205	173	0	378
<b>Gesamt</b>	<b>3.184</b>	<b>9.255</b>	<b>0</b>	<b>12.439</b>

31. Dezember 2006				
in T€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.860	1.628	401	4.889
Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	335	0	335
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	256	313	0	569
<b>Gesamt</b>	<b>3.116</b>	<b>2.276</b>	<b>401</b>	<b>5.793</b>

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich in Höhe von T€ 1.874 (2006: T€ 1.276) aus der Inanspruchnahme eingeräumter Kreditlinien sowie in Höhe von T€ 9.832 (2006: T€ 3.613) aus langfristigen Darlehensverträgen zusammen.

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2007	2006
Kreditlinie	16.188	16.638
Inanspruchnahme	1.874	1.276
<b>Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>14.314</b>	<b>15.362</b>

Die Verringerung der Kreditlinie im abgelaufenen Geschäftsjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Wegfall einer Kreditlinie in Frankreich in Höhe von T€ 1.000 nach dem Verkauf des Segments Device Bonders. Im Gegenzug konnte eine lokale Kreditlinie in Japan um rund T€ 500 ausgeweitet werden. Der größte Teil der Kreditlinie in Höhe von T€ 12.000 entfällt auf eine inländische Kreditlinie, die von einem Bankenkonsortium bereitgestellt wird. Die Linie ist mit der Verpfändung von Umlaufvermögen der betroffenen Inlandsgesellschaften verbunden. Zum Bilanzstichtag ist diese Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 4,34 % (2006: 4,55 %).

Die Gesellschaft hat im Dezember 2007 unter der Führung der UniCredit (HVB) ein Schuldscheindarlehen in Höhe von brutto insgesamt T€ 9.000 platziert. Das Schuldscheindarlehen besteht aus drei Platzierungen in Höhe von jeweils T€ 3.000, wobei eines mit 6 % verzinst wird und zwei eine variable Verzinsung haben. Das Darlehen hat eine Laufzeit von fünf Jahren und dient der Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten sowie der mittel- bis langfristigen Unternehmens- und Investitionsfinanzierung. Es ist unbesichert und an die Einhaltung verschiedener Financial Covenants gebunden. Zur Vermeidung von Zinsrisiken wurden die beiden variablen Schuldscheine von der Gesellschaft mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert.

Die Finanzverbindlichkeiten der Süss MicroTec S.A.S. waren Gegenstand des Verkaufs des Segments Device Bonder und wurden im Berichtsjahr von der Käuferin übernommen.

Die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres waren wie folgt:

Konzerngesellschaft in T€	2007	2006	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	2.970	0	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.970	0	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.970	0	6,06 %	21.12.2012
Süss MicroTec Test Systems GmbH	318	953	3,25 %	31.03.2008
Süss MicroTec Lithography GmbH	366	814	3,75 %	30.09.2008
Image Technology Inc.	0	107	9,81 %	11.04.2007
Image Technology Inc.	0	25	8,75 %	11.04.2007
Image Technology Inc.	0	82	8,75 %	11.04.2007
Image Technology Inc.	238	332	9,27 %	26.03.2011
Süss MicroTec S.A.S.	0	437	4,21 %	11.03.2014
Süss MicroTec S.A.S.	0	48	4,11 %	20.07.2007
Süss MicroTec S.A.S.	0	399	4,29 %	11.03.2014
Süss MicroTec S.A.S.	0	399	4,42 %	11.03.2014
Sonstige Darlehen < 1 Mio. €	0	17		
<b>Gesamt</b>	<b>9.832</b>	<b>3.613</b>		
davon kurzfristig fällig	750	1.584		
davon langfristig fällig	9.082	2.029		
... fällig in 2008	750			
2009	72			
2010	79			
2011	21			
2012	8.910			
... später	0			
	<b>9.832</b>			

### Verbindlichkeiten aus Anleihen

Nach der am 30. April 2006 geleisteten Rückzahlung in Höhe von T€ 3.622 beläuft sich der offene Gesamtbetrag der im November 2003 begebenen Wandel- und Optionsanleihe zum Bilanzstichtag noch auf T€ 355 und entfällt in voller Höhe auf die Optionsanleihe.

Die Optionsanleihe wird mit 6 % p. a. verzinst und ist – vorbehaltlich der Ausübung von Bezugsrechten auf Aktien – am 31. Oktober 2008 rückzahlbar. Die Optionsanleihe ist mit 373.270 Bezugsrechten auf je eine Aktie der SÜSS MicroTec AG verbunden. Der Bezugspreis je Aktie beträgt € 10,0561. Er ist zahlbar durch Einreichung je einer Teilschuldverschreibung aus der Optionsanleihe zuzüglich Barzahlung von € 9,0561 je Aktie. Die Gesellschaft kann ab dem 4. November 2004 die Ausübung von 33 1/3 % der Bezugsrechte verlangen, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 135 % über dem Bezugspreis liegt. Die komplette Ausübung der Bezugsrechte kann ab dem 4. November 2004 verlangt werden, wenn der Aktienkurs an 20 aufeinander folgenden Handelstagen mehr als 200 % über dem Bezugspreis liegt.

Der Bilanzausweis der Optionsanleihe erfolgt nach Verrechnung mit den über die Laufzeit der Anleihe zu amortisierenden Ausgabekosten.

### Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Die Gesellschaft leaset derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating-Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, Technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance-Lease-Verträge, deren zu Grunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden. Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in T€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahe stehenden Personen
Abschreibungen/Aufwendungen 2007	186	2.769	1.785
Abschreibungen/Aufwendungen 2006	206	2.533	1.663
Künftige Verpflichtungen ... fällig in 2008	249	2.468	1.724
2009	144	1.143	594
2010	18	447	339
2011	18	369	339
2012	1	348	339
... später	0	0	0
<b>Gesamt zukünftig</b>	<b>430</b>	<b>4.775</b>	<b>3.335</b>
Zinsanteil	52		
<b>Verbindlichkeit zum 31.12.2007</b>	<b>378</b>		
davon kurzfristig	205		
davon langfristig	173		



## (26) Sonstige (langfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2007	2006
Darlehen von Mitarbeitern	0	46
Sonstiges	51	149
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>51</b>	<b>195</b>

## (27) (Kurzfristige) Rückstellungen

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Garantierückstellungen	1.838	1.694
Abfindungen	9	456
Übrige Rückstellungen	1.075	2.880
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>2.922</b>	<b>5.030</b>

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2007	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2007
Garantierückstellungen	1.694	-1.592	-147	1.883	1.838
Abfindungen	456	-447	0	0	9
Übrige Rückstellungen	2.880	-2.173	-591	959	1.075
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>5.030</b>	<b>-4.212</b>	<b>-738</b>	<b>2.842</b>	<b>2.922</b>

## (28) Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2007	2006
Prämien und Provisionen	1.116	1.447
Fremdleistungen	1.660	1.195
Aufsichtsratsvergütung	165	164
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	0	16
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	10	0
Sonstiges	1.138	363
<b>Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>4.089</b>	<b>3.185</b>

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisentermingeschäften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften und Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 31 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (29) Sonstige (kurzfristige) Verbindlichkeiten

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2007	2006
Erhaltene Anzahlungen	14.323	20.981
Abgegrenzte Personalkosten	4.914	5.563
Passive Rechnungsabgrenzung	597	275
Umsatzsteuer	183	427
<b>Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>20.017</b>	<b>27.246</b>

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

## (30) Steuerschulden

Die Steuerschulden enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 2.005 (2006: T€ 1.226) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 208 (2006: T€ 112).

## Sonstige Angaben

### (31) Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in T€	2007	2006
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	2	9
Kredite und Forderungen	28.208	23.484
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	397	371
	<b>28.607</b>	<b>23.864</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	10	16
Finanzielle Verbindlichkeiten	25.019	15.006
	<b>25.029</b>	<b>15.022</b>

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in T€	2007		2006	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	20.092	20.092	20.459	20.459
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.582	25.582	23.244	23.244
Sonstige Finanzanlagen	5	5	5	5
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	3.023	3.023	611	611
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	2.626	2.626	240	240
bewertet zum Marktwert	397	397	371	371
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	2	2	9	9
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.828	8.828	6.418	6.418
Finanzschulden	12.439	12.524	5.793	4.565
Optionsanleihe	355	391	335	412
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.706	11.758	4.889	3.593
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	378	375	569	560
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.140	4.140	3.380	3.380
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	4.130	4.130	3.364	3.364
bewertet zum Marktwert	10	10	16	16

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

**Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente:** Die Buchwerte entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

**Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:** Die Buchwerte entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

**Sonstige Finanzanlagen:** Eine zuverlässige Ermittlung des Marktwerts der sonstigen Finanzanlagen ist nicht möglich. Die sonstigen Finanzanlagen sind für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens von untergeordneter Bedeutung.

**Sonstige finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten:** Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen auf Grund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

**Wertpapiere:** Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:** Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt. Bei variabel verzinsten Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte annähernd ihren Marktwerten, da die Zinssätze auf variablen Zinsen basieren, die sich an den Marktsätzen orientieren.

**Optionsanleihe:** Zur Ermittlung des Marktwerts der auf Basis der Optionsanleihe bestehenden Finanzverbindlichkeiten wurde die bestehende Verzinsung mit einem Referenzzinssatz verglichen, den ein Kreditinstitut verwenden würde. Dabei wurden insbesondere die Nachrangigkeit und die fehlende Besicherung der Optionsanleihe berücksichtigt. Ebenso wurden Annahmen für das aktuelle Rating des Konzerns getroffen.

**Verbindlichkeiten aus Finance Lease:** Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2007	2006
Kredite und Forderungen	326	10
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	32	784
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	-108	0

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Die Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte beträgt im Berichtsjahr T€ -7, die auf Grund der nachhaltigen Wertminderung unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst wurde. Darüber hinaus wurden die in Vorjahren im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfassten Marktschwankungen in Höhe von T€ 101 – die auch die im Vorjahr erfasste Marktwertveränderung in Höhe von T€ 49 enthält – ergebniswirksam angepasst.

### Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2007		2006	
	Aktiva	Passiva	Aktiva	Passiva
Devisentermingeschäfte	397	0	371	16
Zinsswaps	0	10	0	0

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrags werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des im Berichtsjahr begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Im Rahmen dieser Kontrakte zahlt das Unternehmen variable Zinsen auf einen bestimmten Kapitalbetrag und erhält im Gegenzug dafür feste Zinsen auf denselben Kapitalbetrag. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zu Grunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Das Unternehmen weist die Zinsswaps zum Marktwert in der Konzernbilanz aus. Da Hedge Accounting nicht angewendet wird, werden die Marktwertschwankungen in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst.

### (32) Nahe stehende Personen

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der Konzern wird im Geschäftsjahr 2007 von den Angabepflichten nach IAS 24 in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu den Mitgliedern des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG und deren nahen Familienangehöriger berührt.

#### Süss Grundstücksverwaltungsgesellschaft GbR und Hunger Mountains

Verschiedene Konzerngesellschaften (Süss MicroTec Lithography GmbH, Süss MicroTec Test Systems GmbH, Süss MicroTec Inc.) mieten ihre Geschäftsräumlichkeiten von der Süss Grundstücksverwaltungs GbR oder der Grundstücksgesellschaft Hunger Mountains, USA. Die daraus resultierenden Mietaufwendungen und die sich aus den Verträgen ergebenden zukünftigen Mindestleasingraten sind unter Textziffer 25 dargestellt.

in T€	2007	2006
Mietaufwendungen	1.785	1.663

### Familie Süss

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Beziehungen zwischen dem Unternehmen und der Familie Süss dar. Die Pensionsansprüche sind unter Textziffer 23 dargestellt.

in T€	2007	2006
Gehälter und Pensionen	415	404

### Peter Heinz

Das Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Peter Heinz, ist seit 2007 Mitglied des Boards der Image Technology Inc., einer 100 %igen Tochtergesellschaft der SÜSS MicroTec AG. Für seine Tätigkeit erhält Herr Heinz eine jährliche Vergütung von T€ 7.

### CMS Hasche Sigle

Herr Dr. Schücking, der Gesellschafter der Rechtsanwaltssozietät CMS Hasche Sigle ist, war bis zum 6. Juli 2007 Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG. Die Gruppe nimmt Rechtsberatung von dieser Sozietät in Anspruch.

in T€	2007	2006
Beratungsaufwendungen	143	23

Hinsichtlich der Vergütungen an den Aufsichtsrat und den Vorstand verweisen wir auf Textziffer 36.

## (33) Finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Bestellobligo	9.142	17.705
Mietverpflichtungen	3.722	5.619
Sonstiges	267	59
<b>Summe</b>	<b>13.131</b>	<b>23.383</b>

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

Die Verpflichtungen aus Mietverträgen beinhalten in Höhe von T€ 3.335 (2006: T€ 5.238) Verpflichtungen gegenüber nahestehenden Unternehmen bzw. Personen.

### (34) Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cash Flow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus laufender Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Teil von T€ 350 (2006: T€ 0) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag, während im Vorjahr Sicherheiten von T€ 200 für Finanztermingeschäfte bei Banken gestellt wurden.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von T€ 2.090 (2006: € 2.400) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte aus konzerninternen Fremdwährungsdarlehen, die von der SÜSS MicroTec AG ausgereicht wurden.

### (35) Segmentberichterstattung

#### Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IAS 14 („Segment Reporting“) nach Produktlinien als primärem Berichtsformat und nach Regionen als sekundärem Berichtsformat abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Test Systeme aufgeteilt. Das im Juli 2007 aufgegebenes Segment Device Bonder wird solange als eigenes Segment dargestellt, bis der zum Übertragungstichtag vorhandene Auftragsbestand abgearbeitet ist. Zudem werden im Segment Sonstige weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment **Lithografie** entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Vaihingen bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment **Substrat Bonder** sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind vor allem am Standort Waterbury, Vermont, in den USA konzentriert. Der Vertrieb ist über Waterbury hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa und in Asien ansässig. Insbesondere der so genannte Bond Cluster, der vakuumfreies Bonden ermöglicht, stellt ein wesentliches Standbein dieses Segments dar. Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.



Das im Berichtsjahr verkaufte Segment **Device Bonder** befasste sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb der Produktlinie Device Bonder. Die Segmentaktivitäten waren in St. Jeoire, Frankreich, ansässig. An diesem Standort befinden sich neben der Entwicklung und Produktion auch wesentliche Teile der Vertriebsorganisation. Auf Grund der technischen Komplexität und der geringen Größe des Marktes waren keine weiteren wesentlichen Vertriebsorganisationen innerhalb des Konzerns für dieses Segment tätig.

Das Segment **Test Systeme** ist in Sacka bei Dresden beheimatet. Entwicklung, Produktion sowie der Vertrieb in Europa sind dort angesiedelt. In den internationalen Vertriebsorganisationen (Nordamerika, Asien) arbeiten nach der Lithografie die meisten Mitarbeiter für dieses Segment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z. B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Test Systeme) bestimmt.

Im Segment **Sonstige** werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

#### Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen.

Die dargestellte Ergebnisgröße stellt den jeweiligen Ergebnisbeitrag der Segmente dar. Das Segmentergebnis entspricht dabei dem Ergebnis vor Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung und aus Anlagenabgängen, vor Zinserträgen und Zinsaufwendungen sowie vor Ertragsteuern.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Weder im abgelaufenen Geschäftsjahr noch im entsprechenden Vorjahreszeitraum wurden Wertminderungen vorgenommen.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standorts der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.



Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

in T€	2007				2006	
	Dr. Stefan Schneidewind	Michael Knopp	Dr. Stefan Reineck	Stephan Schulak	Dr. Stefan Schneidewind	Stephan Schulak
<b>Barvergütung</b>						
Fixum	295	70	200	58	285	717
Erfolgsbezogen	158	33	0	0	92	67
<b>Summe</b>	<b>453</b>	<b>103</b>	<b>200</b>	<b>58</b>	<b>377</b>	<b>784</b>
<b>Aktienoptionen</b>						
Anzahl	70.000	30.000	40.000	0	40.000	0
Ausübungspreis	8,39	8,39	8,39	n/a	7,53	n/a

Weiterhin wurden auf Grund der in 2005, 2006 und 2007 an Vorstände gewährten Optionen T€ 222 (2006: T€ 85) als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von T€ 4 (2006: T€ 5).

### Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Geschäftsjahr 2007:

- Dr. Winfried Süß** München, Geschäftsführer i.R., Aufsichtsratsvorsitzender
- Gerhard Rauter** Dresden, Produktionsvorstand bei der Q-Cells AG in Bitterfeld-Wolfen, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
- weitere Mandate: SOLIBRO GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Calyxo GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Sontor GmbH, Bitterfeld-Wolfen (Mitglied im Beirat)  
 Westsächsische Hochschule Zwickau (Kuratoriumsmitglied)
- Dr. h.c. Horst Görtz** Neu-Anspach, Vorstandsvorsitzender der Ultimaco Safeware AG i.R. (bis 30. September 2007)
- Peter Heinz** Waterbury, Vermont, USA, Geschäftsführer i.R.
- weitere Mandate: H&H Associates Inc., Waterbury, Vermont, USA (Mitglied im Aufsichtsrat)  
 Image Technology Inc., Palo Alto, CA/USA (Mitglied im Board)
- Prof. Dr. Anton Heuberger** München, Professor an der TU CAU Kiel
- weitere Mandate: IZET, Itzehoe (Mitglied im Beirat)  
 Sensor Dynamics, Graz, Österreich (Mitglied im Aufsichtsrat)

- Dr. Christoph Schücking** Frankfurt/Main, Rechtsanwalt und Notar der Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle (bis 6. Juli 2007)
- weitere Mandate: Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt a. M. (Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Gesellschafterausschusses)  
Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG, Frankfurt a. M. (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Kennametal GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Kennametal Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Kennametal Hertel Europe Holding GmbH, Fürth i. B. (Mitglied im Aufsichtsrat)  
Freudenberg & Co., Weinheim/Bergstraße (Mitglied im Gesellschafterausschuss)
- Heinz-Peter Verspay** Köln, Rechtsanwalt in der Kanzlei Hecker, Werner, Himmelreich & Nacken (ab 6. Juli 2007)
- weitere Mandate: Lang Audiovision AG, Lindlar (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Pharma Benchmark AG, Köln (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Dr. Stefan Reineck** Kirchartd, Gesellschafter der Dr. Reineck Management & Consulting GmbH (ab 1. Oktober 2007)
- weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)  
Aleo solar Aktiengesellschaft, Prenzlau (Mitglied im Aufsichtsrat)  
TF Instruments Inc. Monmouth Junction, NJ/USA (Mitglied im Board)  
Phoseon Technology Inc., Hillsboro OR/USA (Mitglied im Board)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung in Höhe von € 15.000 pro Geschäftsjahr. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von € 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält den dreifachen Betrag, sein Stellvertreter den anderthalbfachen Betrag.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Süß hat in voller Höhe auf seine Vergütung verzichtet.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

	Zeitraum der Zugehörigkeit	2007 (Angaben in €)			Gesamt
		Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	
Dr. Winfried Süß	ganzjährig	-	-	0,00	0,00
Gerhard Rauter	ganzjährig	22.500,00	22.500,00	2.684,87	47.684,87
Dr. Stefan Reineck	ab 01.10.2007	3.750,00	1.500,00	997,50	6.247,50
Dr. h.c. Horst Görtz	bis 30.09.2007	11.250,00	19.500,00	9.202,91	39.952,91
Peter Heinz	ganzjährig	15.000,00	13.500,00	9.923,94	38.423,94
Prof. Dr. Anton Heuberger	ganzjährig	15.000,00	10.500,00	7.649,93	33.149,93
Dr. Christoph Schücking	bis 06.07.2007	7.500,00	9.000,00	3.983,38	20.483,38
Heinz-Peter Verspay	ab 06.07.2007	7.500,00	6.000,00	0,00	13.500,00

Im Vorjahr setzten sich die Aufsichtsratsvergütungen wie folgt zusammen:

	Zeitraum der Zugehörigkeit	2006 (Angaben in €)			Gesamt
		Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz und Umsatzsteuer	
Dr. Winfried Süß	ganzjährig	45.000,00	10.500,00	9.344,29	64.844,29
Thomas Schlytter-Henrichsen	bis 20.06.2006	11.250,00	3.000,00	3.109,32	17.359,32
Gerhard Rauter	ab 20.06.2006	11.250,00	6.000,00	961,37	18.211,37
Dr. h.c. Horst Görtz	ganzjährig	15.000,00	10.500,00	7.614,62	33.114,62
Peter Heinz	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	3.759,00	26.259,00
Prof. Dr. Anton Heuberger	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	6.071,96	28.571,96
Dr. Christoph Schücking	ganzjährig	15.000,00	7.500,00	4.027,82	26.527,82

Aus seiner Zeit als Geschäftsführer der heutigen Süss MicroTec Lithography GmbH besteht für Herrn Dr. Süß, dem Aufsichtsratsvorsitzenden, zum Bilanzstichtag eine Pensionsrückstellung in Höhe von T€ 1.871 (2006: T€ 2.126).

#### Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

in T€	2007		2006	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Dr. Stefan Schneidewind	18.278	150.000	13.278	80.000
Michael Knopp	5.000	30.000	–	–
Stephan Schulak	–	–	25.000	0
Dr. Winfried Süß	1.131.000	0	1.131.000	0
Gerhard Rauter	0	0	0	0
Dr. h.c. Horst Görtz (bis 30.09.2007)	17.216	0	17.216	0
Peter Heinz	1.338	0	1.338	0
Dr. Christoph Schücking (bis 06.07.2007)	500	0	500	0
Prof. Dr. Anton Heuberger	0	0	0	0
Heinz-Peter Verspay (ab 06.07.2007)	0	0	–	–
Dr. Stefan Reineck (ab 01.10.2007)	1.600	40.000	–	–

### (37) Mitarbeiter

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 753 Mitarbeiter (2006: 724 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2007	2006
Verwaltung	98	99
Marketing und Vertrieb	283	278
Produktion und Technik	350	383
<b>Summe</b>	<b>731</b>	<b>760</b>

### (38) Honorare des Abschlussprüfers

Der im Geschäftsjahr 2007 für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honoraraufwand nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beträgt T€ 340 (2006: T€ 329) und setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	2007	2006
Abschlussprüfung	297	243
Steuerberatung	2	86
Sonstige Leistungen	41	0
<b>Gesamt</b>	<b>340</b>	<b>329</b>

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften.

In der Position Steuerberatung ist das Honorar für die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen enthalten.

### (39) Corporate Governance

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben die nach §161 AktG vorgeschriebene Entsprechenserklärung zur Beachtung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Fassung vom 17. Juni 2007) im Dezember 2007 abgegeben und im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

## (40) Angabe gemäß § 160 Nr. 8 AktG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Am 5. März 2007 hat Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 5. März 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,91 % beträgt.

Am 5. März 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande an der SÜSS MicroTec AG am 5. März 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,91 % beträgt. 3,91 % der Stimmrechte, die von Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, direkt gehalten werden, werden Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, zugerechnet.

Am 5. März 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management N.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 5. März 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,91 % beträgt. 3,91 % der Stimmrechte, die von Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, direkt gehalten werden, werden über die Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, der Global Opportunities (GO) Capital Asset Management N.V. zugerechnet.

Am 7. März 2007 hat die Sal. Oppenheim jr. & Cie., KG auf Aktien, Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln, der Gesellschaft mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 27. Februar 2007 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und nunmehr 4,3 % beträgt.

Am 4. April 2007 hat Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, an der Süss MicroTec AG am 3. April 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und 5,35 % beträgt.

Am 4. April 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 3. April 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und 5,35 % beträgt. Die Stimmrechte, die von Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande direkt gehalten werden, werden Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Am 4. April 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management N.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 3. April 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und 5,35 % beträgt. 5,35 % der Stimmrechte, die von Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, direkt gehalten werden, werden über die Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, der Global Opportunities (GO) Capital Asset Management N.V. zugerechnet.

Am 11. Mai 2007 hat Absolute Capital Management Holdings Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 7. Mai 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und 5,281 % beträgt. Davon sind der Absolute Capital Management Holdings Limited 5,281 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Die Stimmrechte werden von keinen Gesellschaften gehalten, deren Stimmrechtsanteile an der SÜSS MicroTec AG – unmittelbar oder mittelbar – 3 % oder mehr betragen.

Am 17. August 2007 hat Absolute Activist Value Master Fund Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 10. August 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,016 % beträgt.

Am 17. August 2007 hat Absolute Activist Value Fund Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 10. August 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,016 % beträgt. Davon sind dem Absolute Activist Value Master Fund Limited 3,016 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Am 17. August 2007 hat Absolute Capital Management Holdings Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 16. Juli 2007 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und nunmehr 4,623 % beträgt. Davon sind der Absolute Capital Management Holdings Limited 4,623 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Die Stimmrechte werden von keinen Gesellschaften gehalten, deren Stimmrechtsanteile an der SÜSS MicroTec AG – unmittelbar oder mittelbar – 3 % oder mehr betragen.

Am 25. September 2007 hat Absolute Activist Value Master Fund Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. September 2007 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und nunmehr 2,977 % beträgt.

Am 25. September 2007 hat Absolute Activist Value Fund Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. September 2007 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und nunmehr 2,977 % beträgt. Davon sind dem Absolute Activist Value Fund Limited 2,977 % der Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Die Stimmrechte werden von keinen Gesellschaften gehalten, deren Stimmrechtsanteile an der SÜSS MicroTec AG – unmittelbar oder mittelbar – 3 % oder mehr betragen.

Am 25. September 2007 hat Absolute Capital Management Holdings Limited, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 21. September 2007 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und nunmehr 2,977 % beträgt. Davon sind der Absolute Capital Management Holdings Limited 2,977 % nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Die Stimmrechte werden von keinen Gesellschaften gehalten, deren Stimmrechtsanteile an der SÜSS MicroTec AG – unmittelbar oder mittelbar – 3 % oder mehr betragen.

Am 13. November 2007 hat Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 12. November 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,99 % beträgt.

Am 13. November 2007 hat Herr Tito Tettamanti, Großbritannien, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 12. November 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und 3,99 % beträgt. Davon sind ihm 3,99 % zuzurechnen. Ihm zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands.

Am 20. Dezember 2007 hat Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und nunmehr 8,53 % beträgt.

Am 20. Dezember 2007 hat Herr Tito Tettamanti, Großbritannien, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und 8,53 % beträgt. Davon sind ihm 8,53 % zuzurechnen. Ihm zugerechnete Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 5 % oder mehr beträgt, gehalten: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands.



Am 21. Dezember 2007 hat Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities Fund, Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 21. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % und 3 % unterschritten hat und 0,00 % beträgt.

Am 21. Dezember 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 21. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % und 3 % unterschritten hat und 0,00 % beträgt.

Am 21. Dezember 2007 hat Global Opportunities (GO) Capital Asset Management N.V., Amsterdam, Niederlande, der Gesellschaft mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil der Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V., Amsterdam, Niederlande, an der SÜSS MicroTec AG am 21. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % und 3 % unterschritten hat und 0,00 % beträgt.

Am 22. Februar 2008 hat Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und nunmehr 10,34 % beträgt.

Am 22. Februar 2008 hat Herr Tito Tettamanti, Großbritannien, mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG am 19. Februar 2008 die Schwelle von 10 % überschritten hat und nunmehr 10,34 % beträgt. Davon sind ihm 10,34 % zuzurechnen. Die ihm zugerechneten Stimmrechte werden dabei über folgende von ihm kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG jeweils 3 % oder mehr beträgt, gehalten: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands.

## (41) Freigabe des Abschlusses

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 10. März 2008

Der Vorstand

Dr. Stefan Schneidewind

Michael Knopp



# Bestätigungsvermerk

## des Abschlussprüfers



Wir haben den von der Süss MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, 12. März 2008

KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schumacher  
Wirtschaftsprüfer

Jenuwein  
Wirtschaftsprüfer

# ++ Glossar

## 300mm-Technologie

Wafer sind runde Scheiben aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (mehr als 90 %) der heute verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 200 Millimeter. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können (und je mehr Chips auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelner Chip). Aktuell vollzieht sich der Übergang von 200 mm zu 300 mm Durchmesser der Wafer. Dies erfordert eine Anpassung der Herstellungs- und Prozesstechnologien in der Halbleitertechnik.

## Advanced Packaging

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Bei neueren Chipdesigns ist die Zahl der Anschlusskontakte pro Chip inzwischen auf über 1.000 angestiegen. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im so genannten „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

## Atom

Kleinste stabiles Element, das in der Natur vorkommt. Je nach Größe und Eigenschaft werden Atome in verschiedenen Elementen geordnet (Periodensystem der Elemente).

## Backend

Zweiter (hinterer) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen durchführen lassen (Packaging Foundries).

## Biochip

Kleiner Chip aus Silizium, Glas, Kunststoff oder Papier, der in zahlreiche Mikrostrukturen unterteilt ist, auf denen sich spezielle Sonden aus biologisch aktiven Molekülen befinden.

## Bluetooth

Technologie zur drahtlosen Übermittlung von Sprache und Daten über kurze Distanzen durch kurze Radiowellen. Wird überwiegend zur drahtlosen Kommunikation von verschiedenen elektronischen Geräten untereinander eingesetzt, z. B. Mobiltelefon mit Kopfhörer oder PC mit Drucker etc.

## Bonden

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mithilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Bei einem anschließenden Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

## Bump

(Engl.: Unebenheit); Metallische (Lot, Gold o. Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugeln auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

## Chip

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlusskontakte, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

## Cluster

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen, die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern beschickt wird.

## Compound Semiconductor

Siehe Verbindungshalbleiter.

## Cost of Ownership (CoO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders in Rahmen von Massenproduktionen von größter Bedeutung.

## C4NP

IBM hat in den späten sechziger Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ bedeutet Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation des bewährten C4-Prozesses. „NP“ steht dabei für New Process.

## Die

„Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse eingebaut wurden. Sie entstehen auf dem Wafer, indem der Die die vielen Prozessschritte durchläuft. Die Dies befinden sich also während des gesamten Fertigungsprozesses auf dem Wafer. Erst wenn sie fertig sind, wird der Wafer in die einzelnen ICs zerschnitten und diese werden dann in die Gehäuse gesetzt. Diese gehäuseten Dies werden dann oft Chips genannt. „Die“, „IC“ und „Chip“ werden oft synonym verwendet.

## DRAM

Dynamic Random Access Memory. Weltweit verbreitetster Speicherchip.

## Fab

Fabriken, in denen ICs auf Wafern produziert werden. Die Errichtung einer großen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden Dollar.

## Flip-Chip-Bonding

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h., der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.



**Fotoreisist**

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mithilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese veränderten Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoreisist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

**Foundry**

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für Vertrieb und Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

**Frontend**

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Hier werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

**GaAs**

Galliumarsenid; Halbleiterwerkstoff, der für die Herstellung von Mikrochips für optoelektronische und Hochfrequenz-Anwendungen verwendet wird. Aufgrund der gegenüber Silizium höheren Elektronenmobilität ermöglicht dieser Werkstoff die Realisierung schnellerer Mikrochips und damit leistungstärkerer Geräte.

**Halbleiter**

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

**IC**

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher integrierter Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

**LCD-TFT**

LCD (Liquid Crystal Display). TFT (Thin-Film Transistor). LCDs sind Flüssigkristalldisplays, bestehend aus zwei Glasplatten mit stromführenden Leiterbahnen. Das Flüssigkristall zwischen den Platten lässt normales Licht durch. Wird ein elektrisches Feld in den Glasplatten erzeugt, lassen die Kristalle an dieser Stelle kein Licht mehr durch, es entsteht ein schwarzer Punkt. TFT ist eine spezielle Technologie der elektrischen Ansteuerung der LCDs. Hier ist – anders als bei den alternativen „Passiv Matrix LCD“ – jeder einzelne Bildpunkt (Pixel) über einen Transistor ansteuerbar. Diese sog. aktive Matrix ermöglicht eine bessere Bildqualität als die Passiv Matrix LCDs.

**LED**

Light Emitting Diode; Leuchtdiode. LEDs sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnfach so große Lebensdauer wie eine normale Glühlampe.

**Lithografie**

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoreisist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske entsprechen den Strukturen, die in diesem Schritt auf die ICs gebracht werden sollen. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoreisist auf dem Wafer nicht belichtet, an lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoreisist wird belichtet. Die Belichtung des Fotoreisist führt zu einer chemischen Veränderung, die ein Auflösen des Fotoreisist in einem Entwicklungsbad erlaubt. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoreisist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in der Größenordnung von 0,13 bis 0,6 Mikrometer. Im Backend, beim Advanced Packaging, werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

**Maske**

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs gebraucht werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise. Die Maske wird dann beim Lithografie-Schritt eingesetzt, um bestimmte Bereiche zu belichten und so die zu ätzenden Bereiche zu definieren.

**MEMS**

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektrische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

**Mikrometer/Mikron**

Metrisches Längenmaß. Symbol: µm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 µm.

**Mikrosystem**

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

**Mikrosystemtechnik (MST, MEMS, MOEMS)**

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, er wird zum Auslösen des Airbags eingesetzt, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.



# + Finanzkalender 2008

<b>28. März</b>	Jahresabschluss 2007
<b>06. Mai</b>	Quartalsbericht 2008
<b>07. Mai</b>	DVFA-Analystenkonferenz, Frankfurt am Main
<b>19. Juni</b>	Hauptversammlung
<b>12. August</b>	Halbjahresbericht 2008
<b>05. November</b>	Neunmonatsbericht 2008

## Impressum

**Herausgeber:** SÜSS MicroTec AG  
**Redaktion:** Investor Relations, Finance  
**Wirtschaftsprüfer:** KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Aktiengesellschaft,  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
**Konzept und Gestaltung:** IR-One AG & Co., Hamburg  
**Druck:** Hartung Druck + Medien GmbH, Hamburg

## Kontakt

SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Fon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

## Investor Relations

Fon: +49 (0)89-32007-161  
E-Mail: [ir@suss.com](mailto:ir@suss.com)

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.